



上海南麟电子股份有限公司

Shanghai Natlinear Electronics Co., Ltd

公开转让说明书

主办券商



二零一四年十一月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

(一) 技术研发风险

集成电路设计在国内尚属于成长中的新兴产业，技术创新及终端电子产品日新月异，各类技术更新换代很快，因此 IC 设计公司所需投入于新产品开发的研发费用金额较大。公司新产品的开发风险主要来自以下几个方面：（1）由于新产品的开发周期长，可能耗时半年至数年，在产品规划阶段，存在对市场需求判断失误的风险，可能导致公司产品定位错误；（2）存在对企业自身实力判断失误的风险，主要是技术开发能力的判断错误引起的，可能引发公司项目的突然中断；（3）在新产品上市销售阶段，存在因产品方案不够成熟等引起的市场开拓风险，这种风险可能导致产品销售迟滞，无法有效的回收成本，影响公司的后续开发。

由于电子产品行业的新市场格局变动较大，而公司对新技术新产品的预期又往往着眼于未来两到三年乃至更长期的市场目标，因此对未来市场的准确预测存在一定的局限性，如果公司对相关技术和市场发展趋势判断失误，或新技术的市场接受度未如预期，将让公司面临收益无法达到预期的风险。

(二) 行业周期性风险

半导体行业本身有较大的周期性波动态势，公司的经营业绩及营业效益，可能会因为半导体行业本身周期性波动较大的特性，而产生较大的波动。2008 年至 2013 年我国集成电路行业增长情况如下图。

2008-2013 年我国集成电路行业增长情况



如上图所示, 2009年, 集成电路行业经历了大幅下滑, 下滑幅度 11.1%, 2010年, 行业快速反弹, 同比增长 32.7%, 2011年到 2012年, 行业出现周期性回落, 增速放缓, 2013年行业温和增长, 同比增长 7.9%。

公司的经营业绩及营业效益, 可能会因为半导体行业本身周期性波动较大的特性, 而产生较大的波动。

(三) 供应商风险

公司专注于 IC 设计并自建封装测试线, 将芯片制造、部分封装测试工序外包, 符合 IC 产业垂直分工的特点, 也符合近年来 IC 设计市场规模占 IC 整体产业价值比例逐渐增长的趋势, 有利于公司提高 IC 设计水平、降低产品生产成本和扩大市场占有规模。

无晶圆厂运营模式, 有利于公司提高 IC 设计水平、降低产品生产成本和扩大市场占有规模, 但是无晶圆厂运营模式中, 芯片制造、封装和测试必须依托晶圆代工厂和封装测试厂。同时, 晶圆是公司产品的主要原材料, 由于晶圆加工对技术及资金规模的要求极高, 合适的晶圆代工厂商选择范围有限, 导致公司的晶圆代工厂较为集中。在 IC 生产旺季, 可能会存在晶圆代工厂和封装测试厂产能饱和, 不能保证公司产品及时供应的风险。此外, 晶圆价格的变动对公司利润有一定影响, 未来若晶圆代工和封装、测试费用的价格出现上涨, 将对公司的经营业绩造成不利影响。

(四) 存货跌价风险

公司所属的集成电路行业，各类技术更新换代快，市场竞争激烈，存货存在跌价风险，公司 2012 年末、2013 年末、2014 年 4 月末存货跌价准备余额分别为 302.43 万元、338.95 万元、252.29 万元。若公司的研发不能及时跟上新技术变革的步伐、产品不能适应市场的变化，公司存货将面临跌价风险。

(五) 短期偿债风险

报告期公司因购置封装测试生产线等大额资本性支出，导致资产负债率上升，流动比率及速动比率下降，短期偿债风险加大。报告期公司资产负债率分别为 36.70%、58.39%、53.22%，流动比率分别为 2.11、1.31、1.40，速动比率分别为 1.09、0.71、0.67，若公司主要债权人同时主张债权，公司难以在短时间内筹集资金，将面临短期偿债风险。

(六) 非经常性损益占比较大风险

报告期公司非经常性损益分别为 101.36 万元、119.93 万元、-0.11 万元，其中 2012 年、2013 年非经常性损益占净利润的比例分别为 41.23%、23.54%，非经常性损益对公司净利润影响较大。报告期公司非经常性损益主要包括政府补助等，若公司享受的政府补助项目政策等发生重大变化，将对公司盈利能力产生不利影响。

(七) 关于报告期内实际控制人发生变更的提示

报告期内，公司实际控制人由张燕芳变更为刘桂芝。张燕芳于 2003 年 4 月至 2012 年 12 月一直任南麟实业执行董事兼总经理。南麟实业于 2012 年 9 月退出公司，将全部股权转让给刘桂芝等 13 名自然人并于 2012 年 12 月 20 日被注销。南麟实业 2012 年退出公司的原因系南麟实业与公司管理层对于是否选择自建封装测试线的生产模式存在分歧，且南麟实业认为公司短期内无法实现在 A 股市场上市的投资目标，因此在 2012 年获得 285.2 万元分红后收回投资。

1、实际控制人变更前后，研发和管理团队变化情况

公司主要研发和管理人员刘桂芝、吴国平、吴春达、黄年亚、何云、蒋小强、刘检生均在公司成立之初就在公司工作，负责公司的生产经营活动，实际控制人变更后，研发和管理团队未发生变化，实际控制人的变更不会对公司持续经营造

成重大不利影响。

2、实际控制人变更前后公司业务内容及收入、利润变化情况

实际控制人变更前，公司主要致力于设计领域，晶圆制造及封装测试主要系委外加工。实际控制人变更后，公司业务向产业链下游衍生，购入封装测试生产线，并于2013年6月起逐步投产，逐步减少委外加工比例，以提高产品毛利率、保证产品质量和交货速度。除此之外，公司客户、公司业务的发展方向和具体内容等未发生重大变化。实际控制人变更后，公司收入稳定，由于公司自主封装测试比例提高，主营业务毛利率逐步上升，公司净利润因此增长较快。

综上，实际控制人的变更不会对公司生产经营产生重大不利影响。

目 录

声明	1
重大事项提示	2
释 义	8
第一节 基本情况	11
一、公司基本情况	11
二、股票挂牌情况	12
三、公司的股权结构	13
四、公司股东情况	16
五、公司股本形成及变化	18
六、公司重大资产重组情况	35
七、公司董事、监事、高级管理人员	35
八、最近两年主要财务数据和财务指标	38
九、与本次挂牌有关的机构	39
第二节 公司业务	41
一、公司主要产品情况	41
二、公司主要生产流程及方式	43
三、公司业务相关的关键资源要素	47
四、公司业务经营情况	62
五、公司的商业模式	73
六、公司所处行业概况	76
七、公司面临的主要竞争状况	88
第三节 公司治理	92
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	92
二、股东大会、董事会、监事会及相关人员履行职责的情况	93
三、董事会对公司治理机制执行情况的评估	93
四、公司及其控股股东、实际控制人最近两年的违法违规情况	94
五、公司的独立性	94
六、同业竞争情况	95

七、公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况.....	97
八、公司董事、监事、高级管理人员的相关情况	97
九、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况.....	99
第四节 公司财务	102
一、审计意见	102
二、最近二年及一期财务报表	102
三、财务报表的编制基础	126
四、合并财务报表范围及变化情况	126
五、主要会计政策和会计估计	127
六、经营成果和财务状况分析	143
七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况	176
八、期后事项、或有事项及其他重要事项	181
九、报告期内的资产评估情况	182
十、股利分配政策及最近两年的分配情况	182
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	184
十二、风险因素	194
第五节 定向发行	197
第七节 附件	204

释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、股份公司、本公司、南麟电子	指	上海南麟电子股份有限公司
有限公司	指	上海南麟电子有限公司，上海南麟电子股份有限公司之前身
高级管理人员	指	公司的总经理、销售总监、市场总监、运营总监、行政总监、董事会秘书、财务负责人
南麟实业	指	上海南麟实业投资有限公司
无锡矽林威	指	无锡矽林威电子有限公司
深圳善点	指	深圳市善点微电子有限公司
无锡麟力	指	无锡麟力科技有限公司
矽林（香港）	指	矽林（香港）电子有限公司
长电科技	指	江苏长电科技股份有限公司
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、两年一期	指	2012年度、2013年度及2014年1-4月
广发证券、主办券商	指	广发证券股份有限公司
公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
专业术语		
集成电路（Integrated Circuit，简称“IC”）	指	将一个电路的大量元器件集合于一个单晶片上所制成的器件。集成电路制造商采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构；其中所有元件在结构上已组成一个整体，使电子元件向着微型化、低功耗和高可靠性方面迈进了一大步。
半导体	指	常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。

模拟集成电路 (Analog Integrated Circuit)	指	由电容、电阻、晶体管等集成在同一半导体芯片上用来处理模拟信号的集成电路。
数模混合集成电路 (SOC)	指	一种高度集成化，固件化的系统集成技术。把整个应用电子系统全部集成在一个芯片中。
晶体管	指	一种固体半导体器件，具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种功能。晶体管作为一种可变电流开关，能够基于输入电压控制输出电流。
DC/DC	指	把某种规格的直流电转变成另一种规格的直流电。即可代指转变的过程，也可指能够实现这种功能的电路。
AC/DC	指	把交流电转变成直流电。即可代指这种转变的过程，也可指能够实现这种功能的电子电路和设备。
LDO	指	一种线性稳压器，使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET，从应用的输入电压中减去超额的电压，产生经过调节的输出电压。
MOSFET	指	金属-氧化层 半导体场效晶体管，简称金氧半场效晶体管 (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, MOSFET) 是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管 (field-effect transistor)。
LED 背光	指	指用 LED (发光二极管) 来作为液晶显示屏的背光源，和传统的 CCFL (冷阴极管) 背光源相比，LED 具有低功耗、低发热量、亮度高、寿命长等特点。
HALL 传感器	指	即霍尔器件，根据霍尔效应做成的霍尔器件，就是以磁场为工作媒体，将物体的运动参量转变为数字电压的形式输出，使之具备传感和开关的功能。
CMOS	指	中文为“互补金属氧化物半导体”，即由 PMOS 和 NMOS 晶体管组合而成的半导体电路，因其低功耗和集成度高，成为当今主流的集成电路构成方式，其制造工艺被称为 CMOS 工艺。
GND	指	英文 Ground 的缩写，在电路图或电路板上代表地线或 0 线。
场效应管	指	利用控制输入回路的电场效应来控制输出回路电流的一种

		半导体器件。
晶圆	指	硅半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形状为圆形，故称为晶圆；在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构，而成为有特定电性功能之 IC 产品。
封装测试	指	把已制造完成的半导体元件进行结构及电气功能的确认，以保证半导体元件符合系统的需求的过程称为封装后测试。
SOT	指	英文 Small Out-Line Transistor 的缩写，中文名称为小外形晶体管。一种表面贴装的封装形式，一般引脚小于等于 5 个。根据表面宽度的不同分为两种，一种宽度为 1.3mm，一种宽度为 1.6mm。
SOP	指	英文 Small Outline Package 的缩写，中文名称小外形封装，是一种很常见的表面贴装型元器件封装形式，引脚从封装两侧引出呈海鸥翼状(L 字形)。材料有塑料和陶瓷两种。
Fabless 模式	指	即无生产线设计公司模式，采用该模式的 IC 设计公司自身不具备晶圆制造和封装生产线，专注于技术和工艺研发，将生产环节全部外包。
BOM	指	英文 Bill Of Material 的缩写，中文名称为物料清单。本说明书指用于电子整机产品组装生产的全部电子元器件、结构件的清单。
SMD	指	表面贴装器件，它是 SMT(Surface Mount Technology 中文：表面黏著技术) 元器件中的一种。
PCB	指	英文 Printed Circuit Board 的缩写，中文名称为印制电路板，又称印刷电路板、印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的提供者。

注：本转让说明书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 基本情况

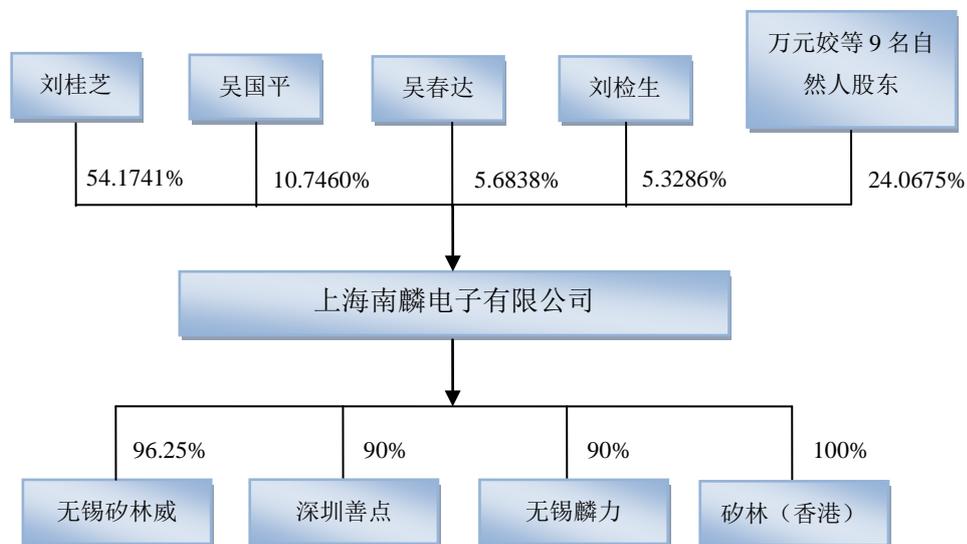
一、公司基本情况

1. 中文名称：上海南麟电子股份有限公司
2. 英文名称：Shanghai Natlinear Electronics Co., Ltd
3. 法定代表人：刘桂芝
4. 设立日期：2004年4月16日
5. 股份公司设立日期：2014年7月15日
6. 注册资本：定向发行前为11,260,000元，定向发行后为12,675,900元
(有关本次挂牌同时定向发行情况详见“第六节 定向发行”)
7. 住所：上海市张江高科技园区蔡伦路103号1幢3楼A室
8. 信息披露事务负责人：何云
9. 电子邮件：heyun@ln-ic.com
10. 电话：021-50275851
11. 传真：021-50275852
12. 互联网网址：<http://www.natlinear.com/>
13. 所属行业：根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)，公司属于单片集成电路、混合式集成电路的制造业(C3963)；根据中国证监会《行业分类指引》(2012年修订)，公司属于C39计算机、通信和其他电子设备制造业。
14. 主营业务：模拟与数模混合类集成电路的设计与研究，为客户提供高效、稳定的集成电路产品。
15. 组织机构代码：76119999-0

二、股票挂牌情况

股票代码	831394
股票简称	南麟电子
股票种类	人民币普通股
每股面值	人民币 1.00 元
股票总量	定向发行前为 11,260,000 股，定向发行后为 12,675,900 股
挂牌日期	【】年【】月【】日
转让方式	协议转让
本次公开转让股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺	<p>公司董事、监事、高级管理人员刘桂芝、吴国平、吴春达、黄年亚、何云、蒋小强、班福奎、张丽佳、刘检生承诺：在本人担任南麟电子董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。</p> <p>股份公司于 2014 年 7 月 15 日成立，截至本说明书签署日，公司设立未满一年，根据相关法律法规及公司法相关规定，公司 13 名发起人股东所持的发起人股 11,260,000 股均不能在股份公司设立满一年之前转让。公司拟在挂牌同时定向发行股份 1,415,900 股，均为非限售股。</p> <p>公司本次可进入全国中小企业股份转让系统转让的股份数量为 1,415,900 股。</p>
主办券商	广发证券股份有限公司

三、公司的股权结构



公司的股东中，刘桂芝与万元姣系夫妻关系；周尧与崔凤敏系夫妻关系；刘桂芝与刘检生系堂兄弟关系。除此之外，公司各股东之间不存在关联关系。

南麟电子存在四家控股子公司：无锡矽林威电子有限公司、深圳市善点微电子有限公司、无锡麟力科技有限公司、矽林（香港）电子有限公司。

1) 无锡矽林威电子有限公司

无锡矽林威电子有限公司成立于 2010 年 10 月，住所为无锡新区长江路 21 号信息产业科技园 F 座一楼，法定代表人刘桂芝，注册资本为 800 万元，实收资本为 800 万元，经营范围包括“集成电路、机械设备的设计、制造（限分支机构）、销售、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（上述经营范围涉及行政许可的，经许可后方可经营；涉及专项审批的，经批准后方可经营）”。公司目前的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	出资比例	出资方式
1	南麟电子	7,700,000	7,700,000	96.25%	货币
2	刘桂芝	300,000	300,000	3.75%	货币
合计		8,000,000	8,000,000	100.00%	-

2014年8月15日，无锡矽林威召开股东会，同意刘桂芝将其持有的无锡矽林威3.75%股权转让给南麟电子，股权转让的价格为每1元出资额作价1元，目前工商变更登记正在办理中。

此次股权转让完成后，无锡矽林威的股权结构：

序号	股东姓名	出资额（元）	持股比例
1	南麟电子	8,000,000	100.00%
合计		8,000,000	100.00%

2) 深圳市善点微电子有限公司

深圳市善点微电子有限公司成立于2010年7月，住所为深圳市南山区科兴路11号深南花园裙楼B区五层512室，法定代表人刘桂芝，注册资本为200万元，实收资本为200万元，经营范围包括“集成电路及其应用产品的设计、制造、销售以及相关技术咨询”。公司目前的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	出资比例	出资方式
1	南麟电子	1,800,000	1,800,000	90.00%	货币
2	吴国平	100,000	100,000	5.00%	货币
3	刘桂芝	100,000	100,000	5.00%	货币
合计		2,000,000	2,000,000	100.00%	-

2014年8月15日，深圳善点召开股东会，同意刘桂芝将其持有的深圳善点5%股权转让给南麟电子，同意吴国平将其持有的深圳善点5%股权转让给南麟电子，股权转让的价格为每1元出资额作价1元，目前工商变更登记正在办理中。

此次股权转让完成后，深圳善点股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（元）	持股比例
1	南麟电子	2,000,000	100.00%
合计		2,000,000	100.00%

3) 无锡麟力科技有限公司

无锡麟力科技有限公司成立于2013年3月，住所为无锡市锡山经济技术开

发区芙蓉中三路 99 号瑞云 3 座，法定代表人刘桂芝，注册资本为 1,000 万元，实收资本为 1,000 万元，经营范围包括“集成电路及机电产品的设计、制造、销售、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。公司目前的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	出资比例	出资方式
1	南麟电子	9,000,000	9,000,000	90.00%	货币
2	吴国平	1,000,000	1,000,000	10.00%	货币
合计		10,000,000	10,000,000	100.00%	-

2014 年 8 月 15 日，无锡麟力召开股东会，同意吴国平将其持有的无锡麟力 10%股权转让给南麟电子，股权转让的价格为每 1 元出资额作价 1 元，目前工商变更登记正在办理中。

此次股权转让后，无锡麟力股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（元）	持股比例
1	南麟电子	10,000,000	100.00%
合计		10,000,000	100.00%

4) 矽林（香港）电子有限公司

矽林（香港）电子有限公司成立于 2009 年 11 月，系南麟电子在香港设立的有限公司，取得了 1390915 号《公司注册证书》，注册资本为 1 万港元。公司目前的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例	出资方式
1	南麟电子	10,000 港元	10,000 港元	100.00%	货币
合计		10,000 港元	10,000 港元	100.00%	-

四、公司股东情况

（一）公司股东基本情况

截至本说明书签署之日，公司共有 13 名股东，其持股情况如下：

序号	股东名称	持股股数（股）	出资方式	持股比例
1	刘桂芝	6,100,000	净资产	54.1741%
2	吴国平	1,210,000	净资产	10.7460%
3	吴春达	640,000	净资产	5.6838%
4	刘检生	600,000	净资产	5.3286%
5	万元姣	500,000	净资产	4.4405%
6	黄年亚	400,000	净资产	3.5524%
7	蒋小强	400,000	净资产	3.5524%
8	何云	340,000	净资产	3.0195%
9	班福奎	340,000	净资产	3.0195%
10	王冬峰	290,000	净资产	2.5755%
11	周尧	200,000	净资产	1.7762%
12	崔凤敏	140,000	净资产	1.2433%
13	王艳	100,000	净资产	0.8882%
	合计	11,260,000	净资产	100.0000%

公司的股东中，刘桂芝与万元姣系夫妻关系；周尧与崔凤敏系夫妻关系；刘桂芝与刘检生系堂兄弟关系。除此之外，公司各股东之间不存在关联关系。

（二）控股股东及实际控制人的基本情况

1. 控股股东及实际控制人

截至本公开转让说明书签署之日，公司的实际控制人为刘桂芝，持有公司 54.1741%的股权。

刘桂芝：1966 年生，身份证号：43040319660224****，中国国籍，无境外永

久居住权，硕士。1988年7月至1997年10月任衡阳晶体管厂主任工程师；1997年10月至2001年2月任衡阳科晶微电子有限公司副总经理；2001年2月至2002年9月任华越微电子有限公司主任工程师；2002年9月至2004年4月任南京微盟电子有限公司设计二部经理；2004年4月至2014年7月任上海南麟电子有限公司董事长、总经理；2013年3月至今任无锡麟力科技有限公司董事长、总经理。2014年7月3日被股份公司第一届董事会选举为董事长，任期三年。

报告期内，公司实际控制人由张燕芳变更为刘桂芝。张燕芳于2003年4月至2012年12月一直任南麟实业执行董事兼总经理。

上海南麟实业投资有限公司成立于2003年4月28日，法定代表人张燕芳；注册资本3000万元；住所为“浦东昌里路335号532室”；经营范围为“实业投资，项目投资及管理，资产委托管理（非金融业务），企业管理咨询，投资咨询，商务咨询，财务咨询，化工原料及产品（除危险品）、机电设备、金属材料、纺织品、办公用品的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）”。股权结构如下：

序号	股 东	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	实缴出资占 注册资本比例	出资方式
1	张燕芳	21,000,000	21,000,000	70.00%	货币
2	李惠良	9,000,000	9,000,000	30.00%	货币
合计		30,000,000	30,000,000	100.00%	-

南麟实业于2012年9月退出公司，将全部股权转让给刘桂芝等13名自然人并于2012年12月20日注销。南麟实业2012年退出公司的原因系南麟实业与公司管理层对于是否选择自建封装测试线的生产模式存在分歧，且南麟实业认为公司短期内无法实现在A股市场上市的投资目标，因此在2012年获得285.2万元分红后收回投资，后南麟实业于2012年12月被注销。

由于刘桂芝、吴国平等高级管理人员、核心技术人员自公司成立以来一直在公司工作，且刘桂芝一直担任公司总经理，负责公司的生产经营。报告期内实际控制人的变更不会对公司生产经营产生重大不利影响。

公司主要管理人员刘桂芝、吴国平、吴春达、黄年亚、何云、蒋小强、刘检

生均在公司成立之初就在公司工作，负责公司的研发和生产经营活动。实际控制人变更后，研发和管理团队未发生变化，实际控制人的变更不会对公司持续经营造成重大不利影响。

实际控制人变更前，公司主要致力于设计领域，晶圆制造及封装测试主要系委外加工。实际控制人变更后，公司业务向产业链下游衍生，购入封装测试生产线，并于2013年6月起逐步投产，逐步减少委外加工比例，以提高产品毛利率、保证产品质量和交货速度。除此之外，公司客户、公司业务的发展方向和具体内容等未发生重大变化。实际控制人变更后，公司收入稳定，由于公司自主封装测试比例提高，主营业务毛利率逐步上升，公司净利润因此增长较快。

综上，实际控制人的变更不会对公司生产经营产生重大不利影响。

五、公司股本形成及变化

（一）有限公司的设立

上海南麟电子有限公司于2004年4月16日在上海市工商行政管理局浦东新区分局登记设立，取得注册号为3101152017945的《企业法人营业执照》。公司系由上海南麟实业投资有限公司与自然人王丹凤共同投资设立，注册资本500万元，实收资本500万元，住所地为上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼667-02室，经营范围包括“集成电路及其应用产品的设计、销售，相关领域的技术咨询（涉及行政许可经营的凭许可证经营）”。

有限公司设立时各股东实缴出资额500万元，占注册资本的100%。其中，上海南麟实业投资有限公司实缴出资450万元；王丹凤实缴出资50万元。该等出资业经上海中佳永信会计师事务所有限公司于2004年4月8日出具的上佳信会验（2004）第22022号《验资报告》验证。

公司设立时的股权结构如下：

序号	股 东	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	实缴出资占注册资本比例	出资方式
1	上海南麟实业	450.00	450.00	90.00%	货币

	投资有限公司				
2	王丹凤	50.00	50.00	10.00%	货币
	合计	500.00	500.00	100.00%	

（二）南麟电子的历次变更

1、2006年3月，第一次增资至510万元

2006年2月20日，南麟电子召开股东会，同意增加新股东刘桂芝，公司注册资本、实收资本由500万元增至510万元，刘桂芝以货币增资10万元，其他股东放弃优先购买权。该等出资业经上海诚汇会计师事务所有限公司于2006年3月9日出具的诚汇会验字（2006）第0105号《验资报告》验证。

公司于2006年3月办理了本次增资的工商变更登记，并取得了上海市工商行政管理局浦东新区分局换发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，南麟电子的股权结构如下：

序号	股 东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	实缴出资额占 注册资本比例	出资方式
1	上海南麟实业 投资有限公司	450.00	450.0	88.20%	货币
2	王丹凤	50.00	50.00	9.84%	货币
3	刘桂芝	10.00	10.00	1.96%	货币
	合计	510.00	510.00	100.00%	

2、2006年8月，第二次增资至1,076万元

2006年7月25日，南麟电子召开股东会，同意公司注册资本由510万元增至1,076万元。增资部分由南麟实业以货币增资500万元；刘桂芝以货币增资28.8万元；新股东吴国平以货币增资14.4万元；新股东蒋小强、黄年亚、周小燕分别以货币增资3.6万元；新股东周尧、黄伟烽、崔凤敏、刘检生、吴春达分别以货币增资2.4万元。该等出资业经上海诚汇会计师事务所有限公司于2006年8月17日出具的诚汇会验字（2006）第0309号《验资报告》验证。

公司于 2006 年 8 月 22 日办理了本次增资的工商变更登记,并取得了上海市工商行政管理局浦东新区分局换发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让及实收资本变更完成后,南麟电子的股权结构如下:

序号	股 东	认缴出资额(万 元)	实缴出资额(万 元)	实缴出资占 注册资本比例	出资方式
1	上海南麟实业 投资有限公司	950.00	950.00	88.2900%	货币
2	王丹凤	50.00	50.00	4.6468%	货币
3	刘桂芝	38.80	38.80	3.6059%	货币
4	吴国平	14.40	14.40	1.3383%	货币
5	蒋小强	3.60	3.60	0.3346%	货币
6	黄年亚	3.60	3.60	0.3346%	货币
7	周小燕	3.60	3.60	0.3346%	货币
8	周 尧	2.40	2.40	0.2230%	货币
9	黄伟烽	2.40	2.40	0.2230%	货币
10	崔凤敏	2.40	2.40	0.2230%	货币
11	刘检生	2.40	2.40	0.2230%	货币
12	吴春达	2.40	2.40	0.2230%	货币
合计		1,076.00	1,076.00	100.00%	

3、2009 年 6 月,第一次股权转让

2009 年 5 月 31 日,南麟电子召开股东会,股东王丹凤与王冬峰、周小燕等 18 名自然人签订了《股权转让协议》,王丹凤将其持有南麟电子 4.65%的股权(对应出资额 50 万元)转让给王冬峰、周小燕等 18 名自然人(转让价格为每 1 元出资额作价 2 元),其他股东放弃优先购买权。具体股权转让情况如下:

转让方	转让股权比例	受让方	受让股权 比例	受让价格 (万元)
王丹凤	4.6468%	乔俊娥	0.70%	15
		张丽佳	0.64%	13.75

		周小燕	0.56%	12
		余萍	0.56%	12
		王艳	0.46%	10
		唐振莉	0.37%	8
		孙晶	0.34%	7.25
		吴春达	0.23%	5
		吴杰	0.23%	5
		何娟	0.09%	2
		张瑞芳	0.09%	2
		王冬峰	0.08%	1.8
		何云	0.08%	1.8
		杨漪雯	0.05%	1
		韩方栋	0.05%	1
		马丙乾	0.05%	1
		曹磊	0.05%	1
		赵寿全	0.02%	0.4
合计	4.6468%	-	4.6468%	100.00

公司于2009年6月16日办理了本次增资的工商变更登记,并取得了上海市工商行政管理局浦东新区分局换发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后,南麟电子的股权结构如下:

序号	股东	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	实缴出资额占注册资本比例	出资方式
1	上海南麟实业投资有限公司	950.00	950.00	88.29%	货币
2	刘桂芝	38.80	38.80	3.61%	货币
3	吴国平	14.40	14.40	1.34%	货币
4	周小燕	9.60	9.60	0.89%	货币
5	乔俊娥	7.50	7.50	0.70%	货币

6	张丽佳	6.875	6.875	0.64%	货币
7	余萍	6.00	6.00	0.56%	货币
8	王艳	5.00	5.00	0.46%	货币
9	吴春达	4.90	4.90	0.46%	货币
10	唐振莉	4.00	4.00	0.37%	货币
11	孙晶	3.625	3.625	0.34%	货币
12	蒋小强	3.60	3.60	0.33%	货币
13	黄年亚	3.60	3.60	0.33%	货币
14	吴杰	2.50	2.50	0.23%	货币
15	周尧	2.40	2.40	0.22%	货币
16	黄伟烽	2.40	2.40	0.22%	货币
17	崔凤敏	2.40	2.40	0.22%	货币
18	刘检生	2.40	2.40	0.22%	货币
19	何娟	1.00	1.00	0.09%	货币
20	张瑞芳	1.00	1.00	0.09%	货币
21	王冬峰	0.90	0.90	0.08%	货币
22	何云	0.90	0.90	0.08%	货币
23	杨漪雯	0.50	0.50	0.05%	货币
24	韩方栋	0.50	0.50	0.05%	货币
25	马丙乾	0.50	0.50	0.05%	货币
26	曹磊	0.50	0.50	0.05%	货币
27	赵寿全	0.20	0.20	0.02%	货币
合计		1,076.00	1,076.00	100.00%	

4、2009年6月，第二次股权转让、第三次增资至1,126万元

2009年6月15日，南麟电子召开股东会，做出决议：

1) 同意股东上海南麟实业投资有限公司将其持有南麟电子22.0260%的股权转让给刘桂芝、吴国平等13名自然人，转让价格为每1元出资额作价0.05元，其他股东放弃优先购买权。具体股权转让情况如下：

转让方	转让股权比例	受让方	受让股权比例	受让价格 (万元)
上海南麟实业 投资有限公司	22.0260%	刘桂芝	8.9219%	4.80
		吴国平	4.4610%	2.40
		蒋小强	1.1152%	0.60
		黄年亚	1.1152%	0.60
		周小燕	1.1152%	0.60
		周尧	0.7435%	0.40
		黄伟烽	0.7435%	0.40
		崔凤敏	0.7435%	0.40
		刘检生	0.7435%	0.40
		吴春达	0.7435%	0.40
		王冬峰	0.6413%	0.345
		何云	0.6413%	0.345
		赵寿全	0.2974%	0.16
合计	22.0260%	-	22.0260%	11.85

2) 同意公司注册资本由 1,076 万元增至 1,126 万元。王新潮向公司增资 100 万元，其中 50 万元计入注册资本、50 万元计入资本公积（即，每一元出资额作价 2 元）。此次增资业经立信会计师事务所有限公司于 2009 年 6 月 23 日出具的信会师报字（2009）第 23825 号《验资报告》验证。

上述股权转让价格差异较大的原因系股权转让的对象不同导致的。南麟实业在公司成立时承诺赠送给技术人员部分股权。2009 年，其兑现承诺，按每股 0.05 元的价格进行了股权转让，低于截至 2009 年 12 月 31 日的公司每股净资产为 2.81 元。由于当时公司尚未选择执行《企业会计准则》，上述股权转让未作股份支付处理；新股东王新潮系财务投资者，并非公司员工，因此以 2 元/股的价格增资。上述股权转让系股东真实意思表示，不存在不当利益输送、纠纷或潜在纠纷。因公司该时尚未执行《企业会计准则》，上述股权转让未作股份支付处理。

公司于 2009 年 6 月办理了本次增资的工商变更登记，并取得了上海市工商行政管理局浦东新区分局换发的《企业法人营业执照》。

本次注册资本及实收资本变更完成后，南麟电子股权结构如下：

序号	股 东	认缴出资额(万 元)	实缴出资额(万 元)	实缴出资占 注册资本比例	出资方式
1	上海南麟实业 投资有限公司	713.00	713.00	63.32%	货币
2	刘桂芝	134.80	134.80	11.97%	货币
3	吴国平	62.40	62.40	5.54%	货币
4	王新潮	50.00	50.00	4.44%	货币
5	周小燕	21.60	21.60	1.92%	货币
6	蒋小强	15.60	15.60	1.39%	货币
7	黄年亚	15.60	15.60	1.39%	货币
8	吴春达	12.90	12.90	1.15%	货币
9	周 尧	10.40	10.40	0.92%	货币
10	黄伟烽	10.40	10.40	0.92%	货币
11	崔凤敏	10.40	10.40	0.92%	货币
12	刘检生	10.40	10.40	0.92%	货币
13	王冬峰	7.80	7.80	0.69%	货币
14	何 云	7.80	7.80	0.69%	货币
15	乔俊娥	7.50	7.50	0.67%	货币
16	张丽佳	6.875	6.875	0.61%	货币
17	余 萍	6.00	6.00	0.53%	货币
18	王 艳	5.00	5.00	0.44%	货币
19	唐振莉	4.00	4.00	0.36%	货币
20	孙 晶	3.625	3.625	0.32%	货币
21	赵寿全	3.40	3.40	0.30%	货币
22	吴 杰	2.50	2.50	0.22%	货币
23	何 娟	1.00	1.00	0.09%	货币
24	张瑞芳	1.00	1.00	0.09%	货币
25	杨漪雯	0.50	0.50	0.04%	货币

26	韩方栋	0.50	0.50	0.04%	货币
27	马丙乾	0.50	0.50	0.04%	货币
28	曹磊	0.50	0.50	0.04%	货币
合计		1,126.00	1,126.00	100.00%	

5、2009年12月，第三次股权转让

2009年11月26日，南麟电子召开股东会，同意股东杨漪雯将所持0.0444%股权（对应出资额5,000元）按15,912元的价格（即，每1元出资额作价3.18元）全部转让给股东刘桂芝，其他股东放弃优先购买权。本次股权转让价格系双方在每股净资产的基础上协商确定，系股东真实意思表示，不存在不当利益输送、纠纷或潜在纠纷。

本次股权转让完成后，南麟电子股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	实缴出资额占注册资本比例	出资方式
1	上海南麟实业投资有限公司	713.00	713.00	63.32%	货币
2	刘桂芝	135.30	135.30	12.02%	货币
3	吴国平	62.40	62.40	5.54%	货币
4	王新潮	50.00	50.00	4.44%	货币
5	周小燕	21.60	21.60	1.92%	货币
6	蒋小强	15.60	15.60	1.38%	货币
7	黄年亚	15.60	15.60	1.38%	货币
8	吴春达	12.90	12.90	1.15%	货币
9	周尧	10.40	10.40	0.92%	货币
10	黄伟烽	10.40	10.40	0.92%	货币
11	崔凤敏	10.40	10.40	0.92%	货币
12	刘检生	10.40	10.40	0.92%	货币
13	王冬峰	7.80	7.80	0.69%	货币
14	何云	7.80	7.80	0.69%	货币

15	乔俊娥	7.50	7.50	0.67%	货币
16	张丽佳	6.875	6.875	0.61%	货币
17	余萍	6.00	6.00	0.53%	货币
18	王艳	5.00	5.00	0.44%	货币
19	唐振莉	4.00	4.00	0.36%	货币
20	孙晶	3.625	3.625	0.32%	货币
21	赵寿全	3.40	3.40	0.30%	货币
22	吴杰	2.50	2.50	0.22%	货币
23	何娟	1.00	1.00	0.09%	货币
24	张瑞芳	1.00	1.00	0.09%	货币
25	韩方栋	0.50	0.50	0.04%	货币
26	马丙乾	0.50	0.50	0.04%	货币
27	曹磊	0.50	0.50	0.04%	货币
合计		1,126.00	1,126.00	100.00%	

公司于2009年12月办理了本次股权转让及增资的工商变更登记,并取得了上海市工商行政管理局浦东新区分局换发的《企业法人营业执照》。

6、2010年7月,第四次股权转让

2010年4月3日,南麟电子召开股东会,同意股东何娟将所持0.0888%股权(对应出资额10,000元)以28,117元(即,每1元出资额作价2.81元)全部转让给蒋小强,其他股东放弃优先购买权。本次股权转让价格系双方在每股净资产的基础上协商确定,系股东真实意思表示,不存在不当利益输送、纠纷或潜在纠纷。

本次股权转让完成之后,南麟电子的股权结构变更为:

序号	股东	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	实缴出资占注册资本比例	出资方式
1	上海南麟实业投资有限公司	713.00	713.00	63.32%	货币
2	刘桂芝	135.30	135.30	12.02%	货币

3	吴国平	62.40	62.40	5.54%	货币
4	王新潮	50.00	50.00	4.44%	货币
5	周小燕	21.60	21.60	1.92%	货币
6	蒋小强	16.60	16.60	1.47%	货币
7	黄年亚	15.60	15.60	1.38%	货币
8	吴春达	12.90	12.90	1.15%	货币
9	周尧	10.40	10.40	0.92%	货币
10	黄伟烽	10.40	10.40	0.92%	货币
11	崔凤敏	10.40	10.40	0.92%	货币
12	刘检生	10.40	10.40	0.92%	货币
13	王冬峰	7.80	7.80	0.69%	货币
14	何云	7.80	7.80	0.69%	货币
15	乔俊娥	7.50	7.50	0.67%	货币
16	张丽佳	6.875	6.875	0.61%	货币
17	余萍	6.00	6.00	0.53%	货币
18	王艳	5.00	5.00	0.44%	货币
19	唐振莉	4.00	4.00	0.36%	货币
20	孙晶	3.625	3.625	0.32%	货币
21	赵寿全	3.40	3.40	0.30%	货币
22	吴杰	2.50	2.50	0.22%	货币
23	张瑞芳	1.00	1.00	0.09%	货币
24	韩方栋	0.50	0.50	0.04%	货币
25	马丙乾	0.50	0.50	0.04%	货币
26	曹磊	0.50	0.50	0.04%	货币
合计		1,126.00	1,126.00	100.00%	

公司于2010年7月办理了本次股权转让及增资的工商变更登记，并取得了上海市工商行政管理局浦东新区分局换发的《企业法人营业执照》。

7、2010年9月，第五次股权转让

2010年6月30日，南麟电子召开股东会，同意股东唐振莉将所持南麟电子0.3552%股权(对应出资额40,000元)以其在2009年入股时的原价80,000元(即，每1元出资额作价2元)全部转让给股东刘桂芝，其他股东放弃优先购买权。本次股权系股东真实意思表示，不存在不当利益输送、纠纷或潜在纠纷。

本次股权转让完成之后，南麟电子的股权结构变更为：

序号	股 东	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	实缴出资占注册资本比例	出资方式
1	上海南麟实业投资有限公司	713.00	713.00	63.32%	货币
2	刘桂芝	139.30	139.30	12.37%	货币
3	吴国平	62.40	62.40	5.54%	货币
4	王新潮	50.00	50.00	4.44%	货币
5	周小燕	21.60	21.60	1.92%	货币
6	蒋小强	16.60	16.60	1.47%	货币
7	黄年亚	15.60	15.60	1.38%	货币
8	吴春达	12.90	12.90	1.15%	货币
9	周 尧	10.40	10.40	0.92%	货币
10	黄伟烽	10.40	10.40	0.92%	货币
11	崔凤敏	10.40	10.40	0.92%	货币
12	刘检生	10.40	10.40	0.92%	货币
13	王冬峰	7.80	7.80	0.69%	货币
14	何 云	7.80	7.80	0.69%	货币
15	乔俊娥	7.50	7.50	0.67%	货币
16	张丽佳	6.875	6.875	0.61%	货币
17	余 萍	6.00	6.00	0.53%	货币
18	王 艳	5.00	5.00	0.44%	货币
19	孙 晶	3.625	3.625	0.32%	货币
20	赵寿全	3.40	3.40	0.30%	货币

21	吴杰	2.50	2.50	0.22%	货币
22	张瑞芳	1.00	1.00	0.09%	货币
23	韩方栋	0.50	0.50	0.04%	货币
24	马丙乾	0.50	0.50	0.04%	货币
25	曹磊	0.50	0.50	0.04%	货币
合计		1,126.00	1,126.00	100.00%	

公司于2010年9月办理了本次股权转让及增资的工商变更登记，并取得了上海市工商行政管理局浦东新区分局换发的《企业法人营业执照》。

8、2011年10月，第六次股权转让

2011年10月19日，南麟电子召开股东会，同意股东乔俊娥、张瑞芳、吴杰、孙晶、曹磊将其持有南麟电子的股权全部转让给刘桂芝（转让价格为每1元出资额作价1.5元）；同意股东黄伟烽将其持有南麟电子的股权全部转让给刘桂芝（转让价格为每1元出资额作价1.3元）；同意股东赵寿全将其持有南麟电子的股权全部转让给刘桂芝（转让价格为每1元出资额作价0.5元），其他股东放弃优先购买权。本次股权转让价格系在上述自然人股东入股价格、扣除各股东在2009年取得分红的基础上，平等协商确定，系股东真实意思表示，不存在不当利益输送、纠纷或潜在纠纷。具体股权转让情况如下：

转让方	转让股权比例	受让方	受让股权比例	受让价格 (万元)
黄伟烽	0.92%	刘桂芝	2.5688%	13.52
乔俊娥	0.67%			11.25
孙晶	0.32%			5.4375
赵寿全	0.30%			3.75
吴杰	0.22%			1.70
张瑞芳	0.09%			1.50
曹磊	0.04%			0.75

合 计	2.5688%	-	2.5688%	37.9075
-----	---------	---	---------	---------

本次股权转让完成之后，南麟电子的股权结构变更为：

序号	股 东	认缴出资额(万 元)	实缴出资额(万 元)	实缴出资占 注册资本比例	出资方式
1	上海南麟实业 投资有限公司	713.00	713.00	63.32%	货币
2	刘桂芝	168.225	168.225	14.94%	货币
3	吴国平	62.40	62.40	5.54%	货币
4	王新潮	50.00	50.00	4.44%	货币
5	周小燕	21.60	21.60	1.92%	货币
6	蒋小强	16.60	16.60	1.47%	货币
7	黄年亚	15.60	15.60	1.38%	货币
8	吴春达	12.90	12.90	1.15%	货币
9	周 尧	10.40	10.40	0.92%	货币
10	崔凤敏	10.40	10.40	0.92%	货币
11	刘检生	10.40	10.40	0.92%	货币
12	王冬峰	7.80	7.80	0.69%	货币
13	何 云	7.80	7.80	0.69%	货币
14	张丽佳	6.875	6.875	0.61%	货币
15	余 萍	6.00	6.00	0.53%	货币
16	王 艳	5.00	5.00	0.44%	货币
17	韩方栋	0.50	0.50	0.04%	货币
18	马丙乾	0.50	0.50	0.04%	货币
合计		1,126.00	1,126.00	100.00%	

公司于2011年10月办理了本次股权转让及增资的工商变更登记，并取得了上海市工商行政管理局浦东新区分局换发的《企业法人营业执照》。

9、2012年8月，第七次股权转让

2012年8月29日，南麟电子召开股东会，同意股东王新潮、周小燕、张丽佳、余萍、马丙乾、韩方栋将其持有南麟电子的股权全部按其入股时的原价转让给刘桂芝（转让价格为每1元出资额作价2元），其他股东放弃优先购买权。本次股权转让系股东真实意思表示，不存在不当利益输送、纠纷或潜在纠纷。具体股权转让情况如下：

转让方	转让股权比例	受让方	受让股权比例	受让价格 (万元)
王新潮	4.4405%	刘桂芝	7.5911%	100.00
周小燕	1.9183%			43.20
张丽佳	0.6106%			13.75
余萍	0.5329%			12.00
马丙乾	0.0444%			1.00
韩方栋	0.0444%			1.00
合计	7.5911%	-	7.5911%	170.95

本次股权转让完成之后，南麟电子的股权结构变更为：

序号	股东	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	实缴出资额占注册资本比例	出资方式
1	上海南麟实业投资有限公司	713.00	713.00	63.3215%	货币
2	刘桂芝	253.70	253.70	22.5312%	货币
3	吴国平	62.40	62.40	5.5417%	货币
4	蒋小强	16.60	16.60	1.4742%	货币
5	黄年亚	15.60	15.60	1.3845%	货币
6	吴春达	12.90	12.90	1.1456%	货币
7	周尧	10.40	10.40	0.9236%	货币
8	崔凤敏	10.40	10.40	0.9236%	货币
9	刘检生	10.40	10.40	0.9236%	货币

10	王冬峰	7.80	7.80	0.6927%	货币
11	何云	7.80	7.80	0.6927%	货币
12	王艳	5.00	5.00	0.4440%	货币
合计		1,126.00	1,126.00	100.00%	

公司于2012年8月办理了本次股权转让及增资的工商变更登记，并取得了上海市工商行政管理局浦东新区分局换发的《企业法人营业执照》。

10、2012年9月，第八次股权转让

2012年9月17日，南麟电子召开股东会，同意股东上海南麟实业投资有限公司将其持有公司63.3215%的股权（对应出资额713万元）按实缴出资额713万元的价格分别转让给刘桂芝、周尧等13名自然人（转让价格为每1元出资额作价1元），其他股东放弃优先购买权。南麟实业以1元出资额作价1元转让股权的原因系其在2012年已获得285.2万元分红，因此股权转让价格较低。本次股权转让系股东真实意思表示，不存在不当利益输送、纠纷或潜在纠纷。具体股权转让情况如下：

转让方	转让股权比例	受让方	受让股权比例	受让价格 (万元)
上海南麟实业 投资有限公司	63.3215%	刘桂芝	31.64%	356.30
		吴国平	5.20%	58.60
		吴春达	4.54%	51.10
		万元姣	4.44%	50.00
		刘检生	4.41%	49.60
		班福奎	3.02%	34.00
		何云	2.33%	26.20
		黄年亚	2.17%	24.40
		蒋小强	2.08%	23.40
		王冬峰	1.88%	21.20
		周尧	0.85%	9.60
		王艳	0.44%	5.00

		崔凤敏	0.32%	3.60
合 计	63.3215%	-	63.3215%	713.00

本次股权转让完成之后，南麟电子的股权结构变更为：

序号	股 东	认缴出资额(万 元)	实缴出资额(万 元)	实缴出资额占 注册资本比例	出资方式
1	刘桂芝	610.00	610.00	54.1741%	货币
2	吴国平	121.00	121.00	10.7460%	货币
3	吴春达	64.00	64.00	5.6838%	货币
4	刘检生	60.00	60.00	5.3286%	货币
5	万元姣	50.00	50.00	4.4405%	货币
6	黄年亚	40.00	40.00	3.5524%	货币
7	蒋小强	40.00	40.00	3.5524%	货币
8	何 云	34.00	34.00	3.0195%	货币
9	班福奎	34.00	34.00	3.0195%	货币
10	王冬峰	29.00	29.00	2.5755%	货币
11	周 尧	20.00	20.00	1.7762%	货币
12	崔凤敏	14.00	14.00	1.2433%	货币
13	王 艳	10.00	10.00	0.8882%	货币
合计		1,126.00	1,126.00	100.00%	

公司于 2012 年 9 月办理了本次股权转让及增资的工商变更登记，并取得了上海市工商行政管理局浦东新区分局换发的《企业法人营业执照》。

11、2014 年 7 月，有限公司整体变更为上海南麟电子股份有限公司

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 5 月 31 日出具的致同审字（2014）第 310FB0352 号审计报告，截至 2014 年 4 月 30 日，上海南麟电子有限公司经审计的账面净资产值为 32,867,650.84 元。整体变更股份公司后，注册资本 11,260,000 元，余额部分计入资本公积。

上海东洲资产评估有限公司于 2014 年于 6 月 16 日出具了沪东洲资评报字

【2014】第 0471257 号资产评估报告书，评估确认截至 2014 年 4 月 30 日，公司经评估净资产为 60,082,606.24 元。

2014 年 7 月 2 日，公司全体发起人股东签订了《发起人协议》，约定以有限公司截至 2014 年 4 月 30 日经审计的净资产 32,867,650.84 元按照 1:1 的比例折为股份公司股本 11,260,000 元，每股面值为人民币 1 元，余额部分计入资本公积；同时明确了各发起人在股份公司设立过程中的权利和义务。

2014 年 7 月 3 日，股份公司召开创立大会，选举董事：刘桂芝、吴国平、吴春达、黄年亚、何云五人为股份公司第一届董事会成员；选举蒋小强、班福奎为股份公司第一届监事会非职工代表监事。同日，股份公司召开职工代表大会，选举张丽佳为股份公司第一届监事会职工代表监事。

2014 年 7 月 3 日，股份公司召开第一届董事会作出决议，选举刘桂芝为公司董事长；经董事长提名，聘任吴国平为公司总经理，聘任刘检生为公司销售总监、吴春达为公司市场总监、黄年亚为公司运营总监，聘任何云为公司行政总监、财务总监、董事会秘书。

本次整体变更后的股权结构为：

序号	股东名称	持股股数（股）	出资方式	持股比例
1	刘桂芝	6,100,000	净资产	54.1741%
2	吴国平	1,210,000	净资产	10.7460%
3	吴春达	640,000	净资产	5.6838%
4	刘检生	600,000	净资产	5.3286%
5	万元姣	500,000	净资产	4.4405%
6	黄年亚	400,000	净资产	3.5524%
7	蒋小强	400,000	净资产	3.5524%
8	何云	340,000	净资产	3.0195%
9	班福奎	340,000	净资产	3.0195%
10	王冬峰	290,000	净资产	2.5755%
11	周尧	200,000	净资产	1.7762%
12	崔凤敏	140,000	净资产	1.2433%

13	王 艳	100,000	净资产	0.8882%
合 计		11,260,000	净资产	100.00%

2014年7月15日,公司完成了本次整体变更的工商登记并取得变更后的《企业法人营业执照》。

六、公司重大资产重组情况

公司自设立至今,尚未进行过重大资产重组。

七、公司董事、监事、高级管理人员

(一) 董事

公司共有董事5名,任期3年,任期届满可连选连任:

序号	姓名	职位	任期
1	刘桂芝	董事长	3年
2	吴国平	董 事	3年
3	吴春达	董 事	3年
4	黄年亚	董 事	3年
5	何 云	董 事	3年

刘桂芝先生: 公司董事长, (简历见上文“控股股东、实际控制人简介”部分)。

吴国平先生: 1974年生,身份证号:34262219740923****,中国国籍,无境外永久居住权,硕士。1997年7月至1999年10月任南京电子设备研究所电子工程师;1999年10月至2001年3月任江苏信腾高科技有限公司设计部经理;2001年3月至2004年4月任南京微盟电子有限公司项目经理;2004年4月至2013年3月任上海南麟电子有限公司设计总监;2013年3月至今任无锡麟力科技有限公司研发总监;2014年7月3日被股份公司创立大会选举为董事,任期三年。

吴春达先生: 1981年生,身份证号:32022219810601****,中国国籍,无

境外永久居住权，大学本科。2004年6月至2006年3月任无锡泰斯特测试有限公司测试工程师；2006年3月至今任上海南麟电子有限公司测试工程师；2014年7月3日被股份公司创立大会选举为董事，任期三年。

黄年亚先生：1979年生，身份证号：32092319790914****，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2001年9月至2004年4月任南京微盟电子有限公司电路设计工程师；2004年4月至2013年3月任上海南麟电子有限公司项目经理；2013年3月至今任无锡麟力科技有限公司项目经理；2014年7月3日被股份公司创立大会选举为董事，任期三年。

何云先生：1984年生，身份证号：32108119840119****，中国国籍，无境外永久居住权，硕士。2005年9月至今历任上海南麟电子有限公司版图工程师、工艺部经理、运营总监兼行政总监；2014年7月3日被股份公司创立大会选举为董事，任期三年。

（二）监事

公司共有监事3名，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期3年，任期届满可连选连任：

序号	姓名	职位	任期
1	蒋小强	监事会主席	3年
2	班福奎	监事	3年
3	张丽佳	职工代表监事	3年

蒋小强先生：1979年生，身份证号：33068219790920****，中国国籍，无境外永久居住权，硕士。2002年7月至2004年7月任南京微盟电子有限公司电路设计工程师；2004年7月至今任上海南麟电子有限公司项目经理；2014年7月3日被股份公司创立大会选举为监事，任期三年。

班福奎先生：1978年生，身份证号：52273119781028****，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科。2000年7月至2002年8月历任成都华微电子有限公司电路设计工程师；2002年8月至2004年5月任成都天锐微电子有限公司电路设计工程师；2004年5月至2009年9月任ACTIVE-SEMI INC 电路设计工程师；

2009年9月至2013年3月任上海南麟电子有限公司电路设计工程师；2013年3月至今任无锡麟力科技有限公司电路设计工程师；2014年7月3日被股份公司创立大会选举为监事，任期三年。

张丽佳女士：1981年生，身份证号：31010919810518****，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科。2005年8月至2006年10月任上海锦盟国际贸易有限公司外贸专员；2006年10月至今任上海南麟电子有限公司行政经理；2014年7月3日被职工代表大会选举为职工代表监事，任期三年。

（三）高级管理人员

公司共有高级管理人员5名，基本情况如下：

序号	姓名	职位	任期
1	吴国平	总经理	3年
2	刘检生	销售总监	3年
3	吴春达	市场总监	3年
4	黄年亚	运营总监	3年
5	何云	财务负责人、董事会秘书、行政总监	3年

吴国平先生：公司总经理、核心技术人员（简历见上文“（1）股份公司第一届董事简介”部分）。

刘检生先生：营销总监。1977年生，身份证号：43042219771129****，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2002年7月至2005年6月任绍兴华越微电子有限公司设备技术员；2005年6月至今任上海南麟电子有限公司销售总监。

吴春达先生：市场总监（简历见上文“（1）股份公司第一届董事简介”部分）。

黄年亚先生：运营总监、核心技术人员（简历见上文“（1）股份公司第一届董事简介”部分）。

何云先生：董事会秘书、财务负责人、行政总监（简历见上文“（1）股份公司第一届董事简介”部分）。

八、最近两年主要财务数据和财务指标

公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-4 月财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具致同审字（2014）第 310FB0315 号标准无保留意见的《审计报告》。公司主要财务数据及财务指标如下（单位：元）：

注：公司于 2014 年 7 月整体变更为股份公司，报告期公司每股净资产、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产、基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额等财务指标系按照假设报告期初已完成整体变更的模拟股本计算。

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	7,477.07	7,948.45	5,249.87
股东权益合计（万元）	3,729.91	3,699.16	3,100.55
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	3,554.68	3,520.67	3,037.47
每股净资产（元）	3.31	3.29	2.75
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.16	3.13	2.70
资产负债率（母公司）	53.22%	58.39%	36.70%
流动比率（倍）	1.40	1.31	2.11
速动比率（倍）	0.67	0.71	1.09
项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	1,197.74	5,645.35	5,286.74
净利润（万元）	26.97	509.51	245.83
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	30.24	483.37	222.26
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	27.08	389.58	144.48

归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	30.33	367.36	121.68
毛利率	45.06%	40.93%	34.09%
净资产收益率	0.86%	14.74%	6.93%
扣除非经常性损益后净资产收益率	0.86%	11.20%	3.80%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.43	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.43	0.20
应收帐款周转率（次）	3.35	5.11	4.71
存货周转率（次）	0.88	1.88	2.53
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-240.63	1,911.53	-411.87
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.21	1.70	-0.37

九、与本次挂牌有关的机构

1	主办券商：	广发证券股份有限公司
	法定代表人：	孙树明
	住所：	广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房)
	联系电话：	020-87555888
	传真：	020-87555888
	项目负责人：	颜礼银
	项目小组成员：	颜礼银、郁颖、李国毅、张飞、陈昕
2	律师事务所：	北京大成（上海）律师事务所
	单位负责人：	王汉齐
	住所：	上海市浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行大厦 3、30 楼
	联系电话：	021-58785888
	传真：	021-58787650

	经办律师:	汪海飞、林兢、何玉平
3	会计师事务所:	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
	单位负责人:	徐华
	住所:	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
	联系电话:	010-85665588
	传真:	010-85665120
	签字注册会计师:	王龙旷、黄蓉
4	评估师事务所:	上海东洲资产评估有限公司
	法定代表人:	王小敏
	住所:	上海市奉贤区化学工业区奉贤分区目华路 8 号 401 室
	联系电话:	021-52402166
	传真:	021-62252086
	签字注册评估师:	朱卫明、朱淋云
5	证券登记结算机构:	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
	法定代表人:	戴文华
	地址:	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
	联系电话:	010-58598980
	传真:	010-58598977
6	证券交易场所:	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
	法定代表人:	杨晓嘉
	地址:	北京市西城区金融大街丁 26 号
	联系电话:	010-63889512
	邮编:	100033

第二节 公司业务

一、公司主要产品情况

(一) 主营业务

上海南麟电子股份有限公司注册于上海张江高科技园区，是一家专注于模拟与数模混合类集成电路的设计与研究，为客户提供高效，稳定的集成电路产品的高新技术企业。公司产品已涵盖了霍尔器件、充电管理、音频功放、DC/DC、AC/DC、白光 LED 驱动、电压检测、超低功耗 LDO、高速 LDO、双路 LDO、MOSFET 等诸多门类。自公司成立以来，先后通过了信息产业部集成电路设计企业认证、高新技术企业认定，并被上海市科学技术委员会、上海市经济信息化委员会评为“上海市科技小巨人培育企业”。

公司具有较高的技术水平，自主研发并在产品中应用了超低功耗超低工作电压基准、芯片防反接技术及对应的 ESD 结构、低压工艺开发高压产品、一种初级控制恒流恒压变化器技术、自动调零等技术。公司产品广泛应用于移动电源、教育电子、智能电视、手机、平板电脑、安防监控、玩具和医疗电子等领域。

公司主营业务突出，2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-4 月，公司主营业务收入分别为 5,286.74 万元、5,645.35 万元和 1,197.74 万元。

(二) 主要产品

1、集成电路产品

(1) 电池充电管理系列芯片

电池充电管理系列主要包括单/双节锂电池、磷酸铁锂动力电池、铅酸电池、镍氢、镍铬、镍锌等电池的充电管理。在充电管理芯片中，公司拥有一系列独特的技术满足客户的特殊特性要求，如电池防反接技术、输出防反灌技术、USB 自动侦测技术、自动功率调节技术等。根据充电管理芯片的工作机理，公司的充电

管理又分为开关型的充电管理和线性的充电管理，线性的特点是整体 BOM 成本低，外围器件少，适合于不超过 1A 的充电场合；开关型的充电管理主要特点是效率高，充电电流大，可以满足对温度、效率和快速充电有着特殊要求的高端应用场合。产品序列包括 LN205X、XT205X、LN950X、XT206X 等。

(2) 电压稳压器 (LDO)

公司的电压稳压器的门类齐全，包括高压 LDO、低压 LDO、低功耗，高纹波抑制，低噪声，超低压差等。这个门类产品采用 CMOS 工艺实现，具有完备的过热保护、过流保护和负载短路保护等，同时这类 IC 的外围简单，采用超小型的 SMD 封装，有效节省 PCB 空间及 BOM 成本，满足各种应用场合的要求。产品序列包括：LN62XX、LN11XX、LN64XX 等。

(3) 开关型 DC/DC 转换器

开关型 DC/DC 转换器包括了 BUCK、BOOST、BUCK-BOOST 等类型产品，具有体积小、输出电流大、纹波低、效率高、待机功耗低等特点，能最大限度地提高电池的续航能力。这类产品应用场合包括 3G/4G 智能手机、平板电脑、安防监控等。产品序列包括 LN22XX、LN235X、LN24XX、XT171X、XT186X 等。

(4) LED 背光驱动 IC

公司的 LED 驱动分为三类：线性恒流驱动、升压型恒流驱动、降压型恒流驱动。它们都采用 CMOS 工艺实现，具有电流精度高，温度特性好等特点。主要应用于智能手机、平板电脑、数码相机、车载 GPS、安防监控、警用/军用 LED 手电、户外 LED 屏等场合。产品序列包括 LN21XX、LN502X、LN59XX、LN936X 等。

(5) LED 照明驱动 IC

LED 照明驱动芯片是采用低压 CMOS 工艺实现高压产品的典型代表。它的工作电压范围广，恒流驱动精度高。且支持可调光。公司可为室内/室外照明灯具、新能源汽车灯具提供 1-100W 隔离/非隔离的完成解决方案。产品序列为 LN25XX。

(6) 霍尔式 (HALL) 传感器

作为物联网重要的组成部分，传感器是非常重要的一个环节，公司自主研发的 HALL 传感器被广泛使用于智能设备，安防监控，电流测量等领域。产品序列为 LN491X。

2、功率晶体管产品

除集成电路产品外，公司目前仍生产少量功率晶体管产品，功率晶体管在电子系统中作为信号放大或大功率的半导体开关，是一类通用型的半导体器件。产品包括各类场效应管，产品序列为 LN23XX。该类产品竞争激烈，技术门槛相对要低。

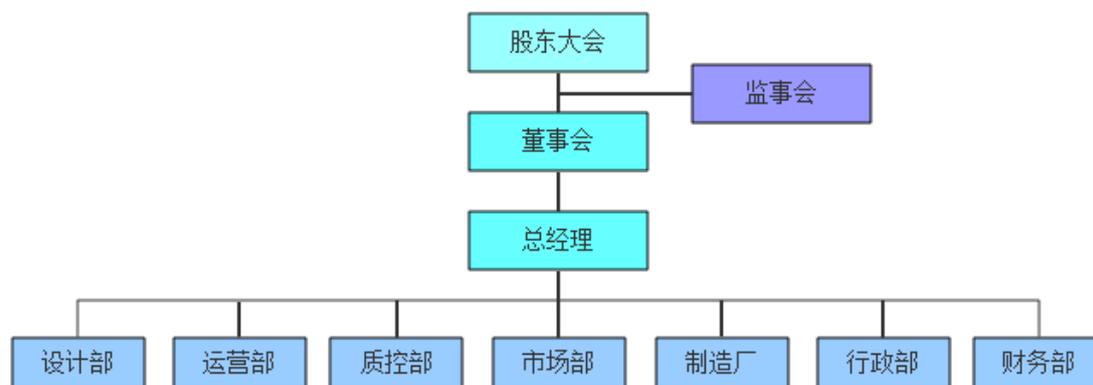
（三）主要产品应用领域



二、公司主要生产流程及方式

（一）公司内部组织结构图

公司设立股东大会、董事会和监事会，董事会人数 5 人、监事会人数 3 人（其中包括一名职工代表监事）。公司主要职能部门包括设计部、运营部、质控部、市场部、制造厂、行政部、财务部。



(二) 公司与业务活动相关的主要职能部门

公司实行董事会领导下的总经理负责制。在董事会的领导下，由总经理负责公司日常经营与管理。各职能部门的主要职能是如下表所示：

序号	部门名称	部门职能
1	设计部	负责研发项目的电路和系统设计，并依据工艺规则设计版图。
2	运营部	制定公司市场计划，制定采购计划，确定产品芯片工艺及封测工艺，组织公司产品物流及仓库管理。
3	质控部	负责公司质量体系管理，负责来料检测，工序检测，成品检测，不合格品检测。
4	市场部	下设销售部，负责公司产品的销售；下设市场部，负责公司产品的市场开拓，收集市场信息。
5	制造厂	负责子公司无锡麟力封装厂的前道车间、后道车间的日常运营，封装流水线的生产调度。
6	行政部	负责公司后勤服务、公共关系、人员招聘、绩效考核、员工培训、人员薪酬方案、员工后续管理等。
7	财务部	负责公司会计核算、收支控制、公司各项资产管理、会计档案管理等。

(三) 公司主要生产和服务流程及方式

1、公司的生产流程

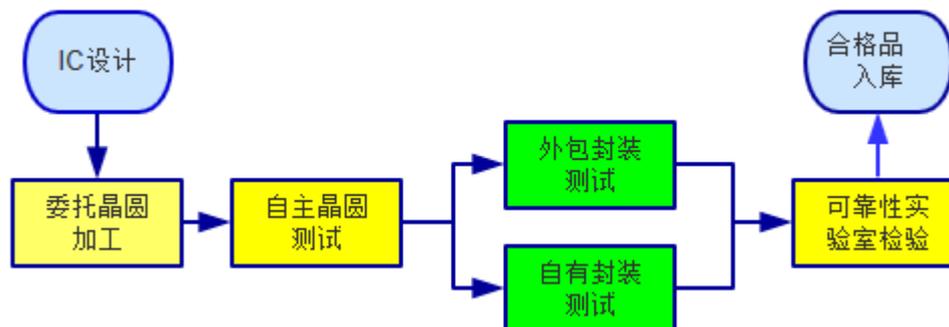
IC 设计制造可以进一步分为 IC 设计、晶圆代工、封装测试三个生产环节。

三者之间的生产环节关系表现为：晶圆代工指根据委托企业的 IC 设计，将设计数据分次刻录在晶圆上，收取代工费。封装测试企业将制作好的晶圆进行切割并封装形成最终 IC 产品，经过测试后将合格品交付设计企业，并收取相应加工费用。

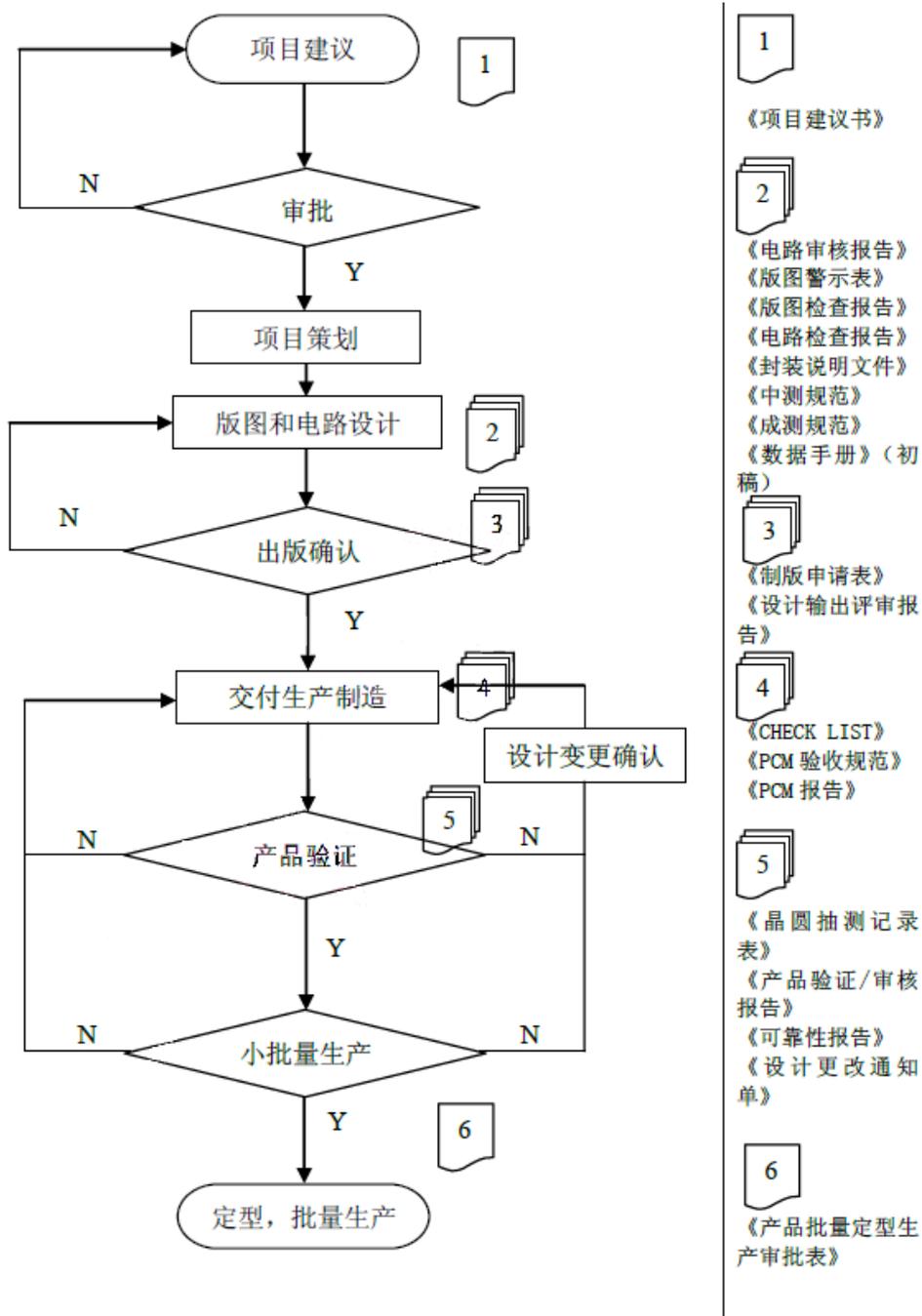
目前国内大部分中小集成电路设计企业均采用上述的 Fabless 模式（无工厂生产模式）进行。公司的部分业务也采用 Fabless 模式，将部分资本设备投入较大、公司暂时无相应封装模具的封装测试业务外包给专门的封装测试厂商并支付加工费。

针对中小 IC 设计公司在实际生产过程中普遍遇到的封装测试时间及质量无法得到大厂保证的状况，公司在 2013 年下半年投入资金自建了封装测试流水线，将小外形晶体管（SOT23-3L、SOT23-5L、SOT23-6L）和小外形封装（SOP8）四种封装测试工作自主完成，同时自建了可靠性试验室进行产品检测。

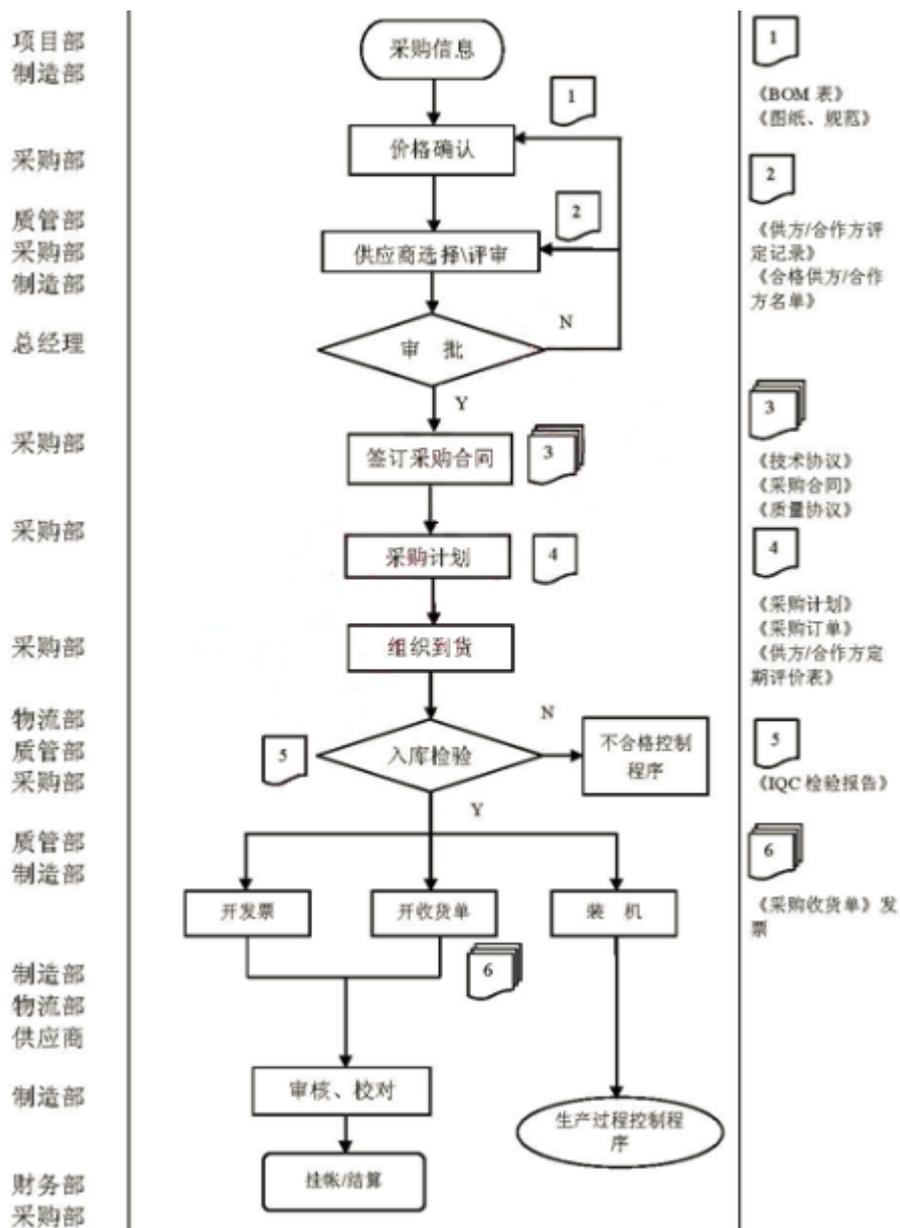
目前，公司的生产流程简要概括如下图所示：



2、公司的研发流程



3、公司的采购流程



三、公司业务相关的关键资源要素

(一) 产品所使用的主要技术情况

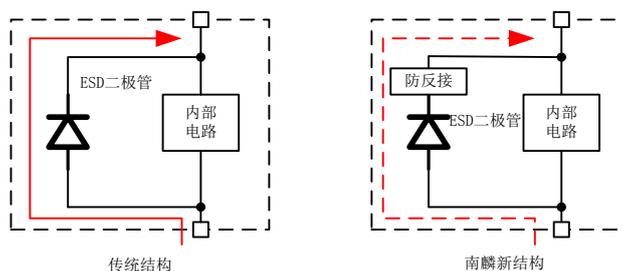
1、超低功耗超低工作电压基准

本技术应用于使用干电池及需要超长待机的电源产品，如 LDO、电压检测及 DC/DC 等。通常的基准电路的最小工作电压都需要在 1.5V 以上，这样在单节干电池供电时，就无法满足稳定输出的要求。在采用该结构电路后，最小工作电压

可以降低到 0.9V，基准输出电压最低可以达到 0.4V，从而满足单节电池供电要求。同时由于该基准总功耗为 400nA，对节能要求高的场合具有很大的竞争优势。

2、芯片的防反接技术及对应的 ESD 结构

该技术目前大量使用在公司的充电管理 IC 中。目前的 IC 由于 ESD 二极管的存在，电源发生反接时，会导致 IC 烧毁等不良。但当芯片采用了公司的防反接技术后，能极大限度地解决电源反接导致的质量事故。该技术的与传统的对比如下图所示：



该技术的核心在于只有当电源与 GND 之间电压高到一定程度后 ESD 二极管才打开泄流，否则 ESD 泄流通路被断开，从而起到保护芯片电源端口的目的。该技术的使用，大大降低了客户生产的不良率。

3、使用低压工艺开发高压产品的技术

该技术被使用在公司的高压 AC/DC 控制器中。目前市场的主流都是采用高压工艺去实现高压产品。高压工艺为了使器件能耐高压，通常都会增加很多层光刻版去实现。因此高压工艺的产品的成本都居高不下。针对这个问题，公司独创性地只在低压工艺的基础上增加一层版，直接提高器件的 VDS 的耐压到 36V。采用该技术后，晶圆的成本降低 50%以上，极大地提高了产品的竞争力。

传统的高压工艺和公司独创的高压工艺对比：

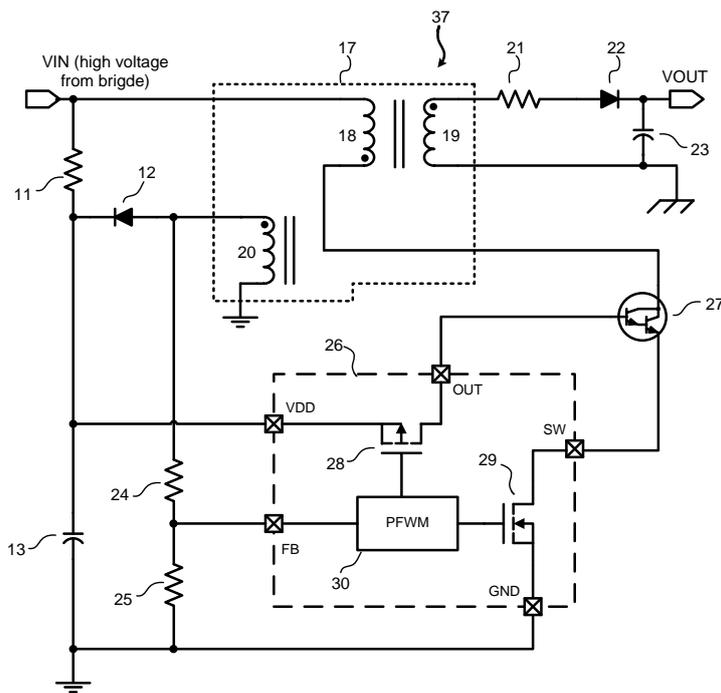
	公司独创工艺	传统高压工艺
版层 (2P2M)	13	大于 18
VDS 耐压	36V	可调节，最高能到 60V

开启电压	NMOS: 0.9V, PMOS:1.1V	1.5V-2.5V 之间
导通内阻	小	大

目前该技术应用于公司专利产品初级控制恒流恒压变换器中，且申请了集成电路布图设计登记证书，设计名称 NL0156，布图设计登记号：BS.105005223。

4、一种初级控制恒流恒压变化器技术

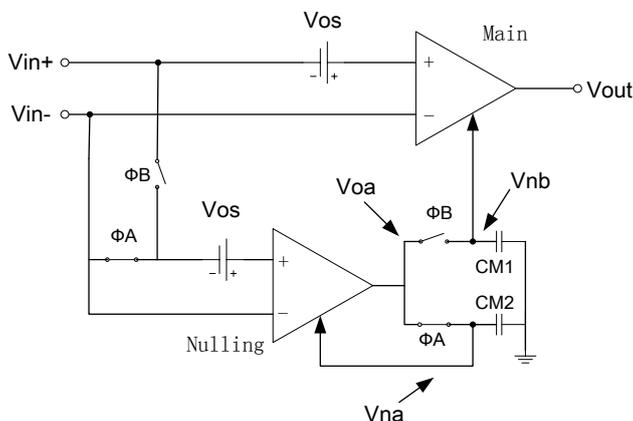
本技术属于微电子设计技术领域，涉及一种恒流恒压变换器，尤其涉及一种初级控制恒流恒压变换器。多年来，各种反激式开关电源的控制集成电路已经得到发展和应用，人们越来越追求芯片工作的高效率和低成本。该技术的原理框图如下图，本技术揭示了一种初级控制恒流恒压变换器，所述变换器包括变压器，初级高压隔离及驱动单元，采用峰值电流模式 PFWM 的控制芯片；控制芯片包括第一晶体管、第二晶体管、PFWM 控制单元；所述第一晶体管的漏极通过控制芯片的端口 OUT 连接所述初级高压隔离及驱动单元，源极连接到端口 VDD，栅极由 PFWM 控制单元控制；所述第二晶体管的漏极连接到控制芯片的端口 GND，源极通过端口 SW 连接所述初级高压隔离及驱动单元，栅极由 PFWM 控制单元控制。本发明提出的初级控制恒流恒压变换器，只需较小的基极驱动电流便可实现反激变换器恒流恒压输出控制，较小的基极驱动电流需求使得在基极驱动电路中可减小产生基极驱动电流的驱动管的面积。可用于 NPN 管发射极驱动或基极驱动，并可降低芯片及应用的成本，显著提高公司产品的竞争力。



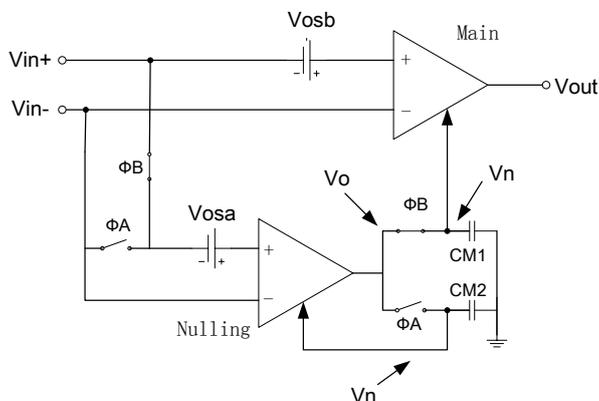
5、自动调零技术

该技术被使用于公司的高性能运放和 HALL 芯片中。自动调零（或自动稳零）是一种动态地抵消失调电压和失调电压漂移的技术，它能将相对输入端的失调电压降低到 μV 级，将失调电压温度漂移降低到 $nV/^\circ C$ 级。动态抵消失调的另一优点是可降低低频噪声，特别是 $1/f$ 噪声。

自动调零技术由主运放和调零运放组成。调零放大器通过将输入端短路并对其自身的调零引脚施加校正信号来校正其自身的失调误差，随后监视并校正主放大器的失调。通常分两个时钟阶段校正输入失调：在时钟阶段 A 中，开关 ϕA 闭合，开关 ϕB 断开，如下图所示。调零放大器的失调电压经过测量后，储存在电容 CM1 上。



在时钟阶段 B 中，开关 ϕB 闭合，开关 ϕA 断开，如下图所示。主放大器的失调电压经过测量后，储存在电容 CM2 上，同时，储存在电容 CM1 中的电压调节指零放大器的失调。进而，在处理输入信号时将总失调电压施加到主放大器上。



采样保持功能会将自稳零型放大器变为采样数据系统，使其容易发生混叠和折回效应。低频时，噪声变化缓慢，因此两个连续噪声采样相减可实现真正的抵消。高频时，这种相关性减弱，相减误差导致宽带成分折回基带。因此，自稳零型放大器的带内噪声高于标准运算放大器。为了减少低频噪声，必须提高采样频率，但这会引入额外的电荷注入。信号路径仅包括主放大器，因而可以获得相对较大的单位增益带宽。

使用了该技术的产品一直安防、医疗电子、工业控制等市场使用，产品质量稳定，客户上机不良率显著降低。

（二）产品的可替代性

电源管理类 IC 是所有电子产品的动力来源，是整机中必不可少的基础性元件，具有生命周期长，用量稳定的特点。公司的具体产品在功能上是具有可替代性的，但这种替代是公司通过工艺改进，不断创新等方式进行技术升级和主动替代的行为。

公司通过整合优化集成电路设计生产各环节的资源，提高产品的性价比和质量稳定性，以满足客户不断增长的需求，扩大公司产品在市场的占有率。同时公司利用自己的管理优势，建立了自己的战略性客户，通过与客户的不断交流互动，

以最快的速度获得准确的客户需求和未来产品发展方向,为公司的新产品快速跟进市场提供有力保障。

(三) 研发机制

1、研发机构

公司重视研发工作,成立设计部专门负责公司现有产品升级和新产品开发工作。截止2014年4月末,公司研发部门有41人,占公司员工人数的47.67%。其中,核心技术人员4人,占员工总人数的1.14%。公司董事长、核心技术人员刘桂芝具有25年的行业经验,研发总监吴国平具有15年的研发经验,其余主要研发人员大部分具有8-10年的研发经验。

研发部下设版图部和项目部。为配合其开展工作,另在运营部下设工艺部,在质控部下设质管部和质保部,协同完成产品研发工作。各部门分工架构为:项目部完成项目的电路和系统设计,工艺部负责工艺接口设计,版图部依据工艺规则设计版图,完成版图绘制。质控部负责产品加工过程的监管和产品的生产测试程序设计。

2、报告期公司的研发费用投入情况

单位:元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
研发费用	2,495,277.51	9,749,493.81	4,898,330.90
主营业务收入	11,977,404.88	56,453,532.94	52,867,427.48
研发费用/主营业务收入	20.83%	17.27%	9.27%

(1) 报告期公司研发支出成本构成情况如下:

单位:元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
人工费	1,351,783.32	4,406,090.36	2,740,172.92
材料费	672,876.91	4,809,807.63	1,532,653.09

加工费	402,925.93	315,153.58	183,828.80
折旧费	20,521.54	144,977.60	358,076.79
无形资产摊销	47,169.81	57,294.81	63,499.98
其他		16,169.83	20,099.32
合计	2,495,277.51	9,749,493.81	4,898,330.90

报告期公司研发支出主要包括研发人员薪酬及产品试制测试的材料费。公司2013年大幅加强研发投入，研发人员人数及研发项目均有所增加，故2013年人工费较2012年增长60.80%。同时2013年研发项目中，部分项目采用工艺更为先进，用于研发投入的材料品质要求提高，导致研发材料费投入较大，2013年材料费较2012年增长213.82%。

(2) 报告期公司研发支出项目构成及进度情况如下：

项目	项目进度	2014年1-4月	2013年度	2012年度
移动电源项目	已完成，未量产			979,666.18
2ADC-DC 模式充电电路	已完成			489,833.09
零漂移运算放大器	已完成			979,666.18
单级 APFC	项目取消			783,732.95
一线调光 LED 驱动	已完成			440,849.78
非隔离式恒流恒压控制芯片	工程批			734,749.64
模拟电源开关	已完成			195,933.23
大电流异步升压 DC-DC	已完成			293,899.85
单节锂电池保护电路	工程批	54,896.10	292,484.81	
低压霍尔 1.8V	工程批	234,556.08	779,959.51	
8*8 LED 驱动	工程批	336,862.46	487,474.69	
可编程 LDO	已完成		682,464.57	
DCDC 降压芯片缩版	已完成	192,136.38	682,464.57	
耳机功放	已完成		2,047,393.70	
DDR 内存供电 LDO	项目取消		487,474.69	
异步 DCDC 升压缩版	已完成	276,975.81	779,959.51	

3A DCDC 降压	工程批	286,956.91	1,364,929.13	
2A 同步 DCDC 升压	工程批	286,956.91	974,949.38	
电源管理单元	项目取消		1,169,939.25	
超低功耗 LDO, 1uA	工程批	47,410.27		
36V led 控制器	工程批	334,367.18		
非隔离 LED 驱动芯片 201 升级版	工程批	39,924.43		
车充	工程批	62,381.94		
RGB 单线三通道 256 级灰度 LED 驱动器	工程批	209,603.31		
自行车灯/LED 手电驱动	产品设计	54,896.10		
1.2A 同步升压	产品设计	39,924.43		
40V, 1A 同步 Buck	产品设计	17,466.94		
1A/1A 二合一移动电源芯片	产品设计	19,962.26		
合计		2,495,277.51	9,749,493.81	4,898,330.90

集成电路设计在国内尚属于成长中的新兴产业，技术创新及终端电子产品日新月异，各类技术更新换代很快，故公司研发项目较多，研发支出金额较大。公司 2013 年项目数量增加，同时如耳机功放项目因系统架构要求自己产生正压和负压，系统复杂、技术难度大、采用工艺先进，投入人力及后期材料费投入大，项目总投入较大。

(3) 报告期公司已完成研发项目收入情况如下：

项目	项目进度	2014 年 1-4 月	2013 年度	2012 年度
移动电源项目	已完成，未量产			
2ADC-DC 模式充电电路	已完成	43,017.40		
零漂移运算放大器	已完成	70,371.81	15,941.04	22,005.13
一线调光 LED 驱动	已完成	456,345.76	6,636,097.18	4,049,902.92
模拟电源开关	已完成	9,230.76	368,074.33	345,541.74
大电流异步升压 DC-DC	已完成		21,210.00	

可编程 LDO	已完成	1,685,667.89	9,873,803.24	
DCDC 降压芯片缩版	已完成	557,926.31	1,855,738.24	
耳机功放	已完成	402,365.71	1,959,834.18	
异步 DCDC 升压缩版	已完成	647,047.35	5,182,333.14	
合计		3,871,972.99	25,913,031.35	4,417,449.79

公司研发项目主要分为产品定义、产品设计、工程批生产等三个阶段, 公司研发项目立项时通常需对市场进行预判, 因公司所处行业产品及技术更新换代较快, 项目启动后存在因终端产品变化、技术工艺难度大、市场开拓不利等因素出现项目被取消或未量产的情况。

公司研发费用金额较大, 同时研发项目数量较多, 若公司研发项目出现大量被迫取消或未量产的情况, 将对公司业绩造成不利影响。

3、自主技术占核心技术的比重

公司拥有自己的研发部门、完善的研发组织及经验丰富的研发人员, 公司产品所采用的核心技术均为自主研发。

(四) 知识产权及无形资产情况

截至本说明书签署之日, 公司拥有的知识产权及无形资产情况如下:

1、已授权专利

序号	公司名称	专利名称	专利申请号	类型	申请日	授权公告日
1	上海南麟	消除直流偏差的电路及方法、射频接收芯片	ZL201010564595.5	发明	2010.11.15	2013.11.20
2	上海南麟	初级控制恒流恒压变换器	ZL201110058656.5	发明	2011.3.11	2013.9.25

2、集成电路布图设计专有权

公司及子公司拥有的集成电路布图设计专有权共 33 项, 如下表所示:

序号	公司名称	设计名称	登记证书号	申请日	授权日期	布图设计登记号
1	上海南麟	NL0015	第843号	2005. 11. 15	2005. 12. 30	BS. 05500235. 8
2	上海南麟	NL0030	第1174号	2006. 09. 15	2006. 12. 7	BS. 06500270. 9
3	上海南麟	NL0020	第1172号	2006. 09. 15	2006. 12. 7	BS. 06500268. 7
4	上海南麟	NL0036	第1173号	2006. 09. 15	2006. 12. 7	BS. 06500269. 5
5	上海南麟	NL0035	第1594号	2007. 9. 7	2008. 1. 11	BS. 07500314. 7
6	上海南麟	NL0058	第1588号	2007. 9. 7	2008. 1. 11	BS. 07500331. 7
7	上海南麟	NL0039	第1593号	2007. 9. 7	2008. 1. 11	BS. 07500315. 5
8	上海南麟	NL0089	第2165号	2008. 8. 4	2008. 11. 27	BS. 08500427. 8
9	上海南麟	NL0050	第2162号	2008. 8. 4	2008. 11. 27	BS. 08500424. 3
10	上海南麟	NL0049	第2161号	2008. 8. 4	2008. 11. 27	BS. 08500374. 3
11	上海南麟	NL0057	第2163号	2008. 8. 4	2008. 11. 27	BS. 08500425. 1
12	上海南麟	NL0088	第2164号	2008. 8. 4	2008. 11. 27	BS. 08500426. X
13	上海南麟	NL0126	第3099号	2009. 8. 22	2010. 3. 16	BS. 09500716. 4
14	上海南麟	NL0128	第3100号	2009. 8. 22	2010. 3. 16	BS. 09500717. 2
15	上海南麟	NL0130	第3102号	2009. 8. 22	2010. 3. 16	BS. 09500719. 9
16	上海南麟	NL0129	第3101号	2009. 8. 22	2010. 3. 16	BS. 09500718. 0
17	上海南麟	NL0122	第3098号	2009. 8. 22	2010. 3. 16	BS. 09500715. 6
18	上海南麟	NL0160	第3733号	2010. 8. 18	2010. 11. 17	BS. 10500519. 3
19	上海南麟	NL0156	第3756号	2010. 8. 18	2010. 11. 18	BS. 10500522. 3
20	上海南麟	NL0153	第3755号	2010. 8. 18	2010. 11. 18	BS. 10500521. 5
21	上海南麟	NL0133	第3761号	2010. 8. 18	2010. 11. 18	BS. 10500520. 7

22	上海南麟	NL0080	第3757号	2010. 8. 18	2010. 11. 18	BS. 10500523. 1
23	上海南麟	NL0170	第4901号	2011. 7. 13	2011. 9. 21	BS. 11500703. 2
24	上海南麟	NL0161	第4900号	2011. 7. 13	2011. 9. 21	BS. 11500702. 4
25	上海南麟	NL0190	第4903号	2011. 7. 13	2011. 9. 21	BS. 11500705. 9
26	上海南麟	NL0180	第4902号	2011. 7. 13	2011. 9. 21	BS. 11500704. 0
27	上海南麟	NL0200	第6907号	2012. 9. 14	2012. 12. 11	BS. 12501370. 1
28	上海南麟	NL0199	第6906号	2012. 9. 14	2012. 12. 11	BS. 12501369. 8
29	上海南麟	NL0201	第6908号	2012. 9. 14	2012. 12. 11	BS. 12501371. X
30	上海南麟	NL0216	第8416号	2013. 9. 25	2013. 11. 8	BS. 13501167. 1
31	上海南麟	NL0205	第8413号	2013. 9. 25	2013. 11. 8	BS. 13501164. 7
32	上海南麟	NL0211	第8415号	2013. 9. 25	2013. 11. 8	BS. 13501166. 3
33	上海南麟	NL0209	第8414号	2013. 9. 25	2013. 11. 8	BS. 13501165. 5

根据集成电路布图设计保护条例第十二条规定，布图设计专有权的保护期为10年，自布图设计登记申请之日或在世界任何地方首次投入商业利用之日起计算，以较前日期为准。但无论是否登记或投入商业利用，布图设计自创作完成之日起15年后，不再受该条例保护。

3、商标

公司及子公司拥有的商标共1项，如下表所示：

商标	有效期截止日	注册号	商品类别
	2017年11月6日	4331222	9

4、核心技术的保护措施

公司注重对核心技术的保护，对研发成熟的技术申请了知识产权保护，截至本说明书签署之日，公司已有商标 1 项、布图设计 33 项、专利 2 项。公司已与核心技术人员签订了相关保密协议。

（五）取得的业务许可资格和资质情况

1、资质及荣誉

A、集成电路设计企业认定证书

公司具备信息产业部颁发的集成电路设计企业认定证书资质，证书编号信认 0081-2005S，截止目前正常年审。

B、高新技术企业证书

2011 年 12 月 6 日，上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合批准公司成为高新技术企业，并颁发《高新技术企业证书》，证书编号：GF201131000351，有效期三年，公司目前正在履行复审程序。

C、上海市科技小巨人（培育）企业证书

2009 年，公司被上海市科学技术委员会、上海市经济和信息化委员会评为上海市科技小巨人（培育）企业。

D、中华人民共和国海关报关单位注册登记证书

2014 年 9 月，股份公司取得了换发后的《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》，海关注册编码：3122264325；注册登记日期：2012 年 3 月 6 日；企业经营类别：进出口货物收发货人；有效期为长期。

2013 年 5 月，无锡麒力科技有限公司取得了《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》，海关注册编码：3202969228；注册登记日期：2013 年 5 月 10 日；有效期至 2016 年 5 月 10 日。

E、对外贸易经营者备案登记表

2014年9月，股份公司取得了换发后的《对外贸易经营者备案登记表》，进出口企业代码：3100761199990；备案登记表编号：01798260。

2013年5月，无锡麒力科技有限公司取得了《对外贸易经营者备案登记表》，进出口企业代码：3200063267159；备案登记表编号：01370116。

2、市场准入

公司所处的行业无市场准入资质要求。

（六）提供产品时使用的主要设备和固定资产

截止2014年4月30日，公司的主要固定资产情况如下：

单位：万元

项 目	使用年限	账面原值合计	累计折旧	账面价值	成新率
机器设备	10年	1,140.54	158.77	981.77	86.08%
工具器具	5年	261.89	40.14	221.75	84.67%
运输工具	4-8年	281.39	210.52	70.87	25.19%
电子设备	3-5年	1,446.80	690.45	756.35	52.28%
办公设备	5年	15.98	13.66	2.32	14.52%
合计		3,146.60	1,113.53	2,033.06	64.61%

与大部分IC设计公司不同，公司自建有封装测试线，固定资产主要为机器设备、电子设备、运输工具等，与公司的经营活动相匹配，并且在公司的日常经营中正常使用，状态良好。公司固定资产成新率为64.61%，暂无面临淘汰、更新、大修等情况。

（七）公司的房屋租赁情况

1、2011年9月，上海南麟电子有限公司和上海环绿实业有限公司签订《房屋租赁合同》，上海环绿实业有限公司将坐落于上海市浦东新区蔡伦路103号1幢3楼A座场地出租给上海南麟电子有限公司作为办公使用，租赁面积为208平方米，租赁期限为2011年9月20日起至2014年9月19日止。

2014年7月，双方签署新的《房屋租赁合同》，将上述办公场地租赁期延长至2017年9月19日止。

2、2014年1月，子公司无锡麟力科技有限公司和无锡锡山科技园有限公司签订《房屋租赁合同》，无锡锡山科技园有限公司将坐落于创业园瑞云3座101,102,103,105,201,202,203,205室出租给无锡麟力科技有限公司作为科技项目的研究开发，中试和产业化生产使用，租赁面积为3212平方米，租赁期限为2014年1月28日起至2017年1月27日止。

3、2014年10月，子公司无锡矽林威电子有限公司和无锡国家集成电路设计基地有限公司签订《办公房租赁合同》，无锡国家集成电路设计基地有限公司将坐落于无锡新区长江路21号信息产业园F座1楼场地出租给无锡矽林威电子有限公司作为办公用房，租赁面积为445平方米，租赁期限为2015年1月1日起至2015年12月31日止。

4、2013年8月，子公司深圳善点微电子有限公司和永利泰投资有限公司签订《房屋租赁合同》，永利泰投资有限公司将坐落于深圳市南山区科兴路11号深南花园裙楼B区五层512室场地出租给深圳善点微电子有限公司作为办公用房，租赁面积为285.22平方米，租赁期限为2013年8月1日起至2015年7月31日止。

5、2013年3月，子公司矽林（香港）电子有限公司和信达公司（Xin Da Company）签订《标准租约》，信达公司（Xin Da Company）将坐落于火炭坳背湾街30-32号华耀工业中心15楼04室场地出租给矽林（香港）电子有限公司作为办公用房，租赁期限为2014年3月1日起至2016年2月28日止。

经核查，上述物业的租赁方均拥有合法的产权手续。

（八）员工及核心技术人员情况

1、员工情况

截至2014年4月30日，南麟电子员工共计86人，具体情况如下：

（1）按年龄划分

序号	年龄段	人数	占比 (%)
1	30 岁及以下	66	76.74
2	31-40 岁	19	22.09
3	41-50 岁	1	1.16
合计		86	100.00

(2) 按教育程度划分

序号	教育程度	人数	占比 (%)
1	硕士及以上	6	6.98
2	本科	47	54.65
3	专科	13	15.11
4	高中及以下	20	23.26
合计		86	100.00

(3) 按职能划分

序号	具体职能	人数	占比 (%)
1	管理人员	21	24.42
2	研发人员	41	47.67
3	销售人员	10	11.63
4	生产人员	14	16.28
合计		86	100.00

2、核心技术人员

(1) 核心技术人员概况

刘桂芝先生：详见第一节基本情况之“四、股东情况”之“控股股东及实际控制人的基本情况”。

吴国平先生：详见第一节基本情况之“七、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事”。

黄年亚先生：详见第一节基本情况之“七、公司董事、监事、高级管理人员”

之“（一）董事”。

蒋小强先生：详见第一节基本情况之“七、公司董事、监事、高级管理人员”之“（二）监事”。

（2）核心技术人员持股情况

序号	核心技术人员	职务	持股数量（万股）	持股比例
1	刘桂芝	董事长、核心技术人员	610.00	54.1741%
2	吴国平	董事、总经理、核心技术人员	121.00	10.7460%
3	黄年亚	董事、运营总监、核心技术人员	40.00	3.5524%
4	蒋小强	监事、核心技术人员	40.00	3.5524%

四、公司业务经营情况

（一）报告期业务收入的主要构成

单位：元

项目	2014年1-4月		2013年		2012年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
集成电路	11,414,206.78	95.30%	54,652,552.80	96.81%	50,913,395.56	96.30%
功率晶体管	563,198.10	4.70%	1,800,980.14	3.19%	1,954,031.92	3.70%
合计	11,977,404.88	100.00%	56,453,532.94	100.00%	52,867,427.48	100.00%

（二）公司报告期内客户情况

序号	2014年1-4月公司前五大客户	销售额（元）	占比（%）
1	深圳市汤诚科技有限公司	1,303,685.53	10.88
2	深圳市艾美科技有限公司	1,151,709.43	9.62
3	深圳市福光泰电子科技有限公司	1,121,356.20	9.36

4	深圳市祺浩达科技有限公司	864,515.42	7.22
5	泰州人峰微电子有限公司	498,763.26	4.16
合计		4,940,029.84	41.24

续上表

序号	2013年度公司前五大客户	销售额(元)	占比(%)
1	深圳市汤诚科技有限公司	12,977,077.69	22.99
2	香港立天捷运	4,091,969.21	7.25
3	深圳市福光泰电子科技有限公司	3,170,211.49	5.62
4	深圳市祺浩达科技有限公司	3,163,062.75	5.60
5	深圳市艾美科技有限公司	2,926,768.12	5.18
合计		26,329,089.26	46.64

续上表

序号	2012年度公司前五大客户	销售额(元)	占比(%)
1	深圳市汤诚科技有限公司	8,862,124.71	16.76
2	香港立天捷运	5,543,927.03	10.49
3	深圳市友骏科技有限公司	4,072,048.21	7.70
4	深圳市艾美科技有限公司	2,609,485.35	4.94
5	深圳特利丰科技有限公司	2,256,754.11	4.27
合计		23,344,339.41	44.16

深圳市汤诚科技有限公司，设立于2008年12月8日，注册资本300万元，公司经营范围为：电子软硬件、电子集成系统的技术开发（不含生产加工）；电脑、电子元器件及配件的销售；国内商业、物资供销业。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。

深圳市艾美科技有限公司，设立于2001年9月3日，注册资本250万元，公司经营范围为：MP3、MP4、数码相框、U盘、录音王、数码产品的软件与硬件的技术开发及销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

深圳市福光泰电子科技有限公司，设立于2008年9月9日日，注册资本30

万元，公司经营范围为：变压器、电源、电子配件生产、销售、技术开发；普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2015 年 8 月 14 日）；国内商业、物资供销业、货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。

深圳市祺浩达科技有限公司，设立于 2010 年 9 月 9 日，注册资本 50 万元，公司经营范围为：集成电路、电子产品、电子元器件、电路板的技术开发与销售，计算机周边产品的销售，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

深圳市友骏科技有限公司，设立于 2007 年 9 月 4 日日，注册资本 200 万元，公司经营范围为：电子元器件、电子产品的技术开发与销售（不含限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

报告期，公司的前五大客户销售合计占总销售收入中的比例分别为 44.16%、46.64%、41.24%，总体比较稳定。

报告期内前，公司的前五大客户均为经销商，经销商均向公司采购集成电路产品。公司的产品主要通过经销商销售，属于行业的普遍特征。通过经销商销售的模式既可充分利用经销商经过多年经营积累的销售渠道，又转移了电子制造业市场离散度较高的终端用户应收账款坏账风险。

公司主要客户变动的的原因：①下游市场容量大，集中度较低。集成电路行业产品数量巨大，型号众多，市场变化迅速，一家 IC 设计企业往往接触大量经销企业，行业内各企业市场占有率普遍不高，因此，公司的客户群体较大，范围较广；②为适应终端客户数量多、分布广的特点，公司采取“经销与直销相结合、经销为主”的销售模式，经营商数量多且分散，公司根据每年产品类型、业务发展方向、结算条件、渠道能力等选择不同的经销商；经销商亦根据市场需求决定是否采购公司相应产品，双向选择是造成客户变动的原因之一；报告期内，除第一大客户外，公司对其他客户销售金额差距不大，每年根据实际销售情况出现排

名上的小幅波动，排名下滑的客户大多数仍系公司经销商。

报告期除第一大客户外，其余客户销售额占比基本都在 10%以下，显示公司销售分散，销售集中度不高。

（三）公司报告期内成本构成及供应商情况

1、报告期公司成本构成情况

业务成本构成	2014 年 1-4 月		2013 年		2012 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
晶圆代工	2,515,563.56	38.23%	8,664,663.15	25.98%	8,501,350.86	24.40%
其他直接材料	980,351.79	14.90%	1,453,047.77	4.36%		
人工及制造费用	1,271,700.55	19.33%	5,936,321.52	17.80%	2,541,905.74	7.30%
委托封测费	1,143,170.02	17.37%	17,291,842.10	51.86%	23,801,062.72	68.31%
合计	6,580,272.52	100.00%	33,345,874.54	100.00%	34,844,319.32	100.00%

报告期公司成本主要包括晶圆代工成本、其他材料、人工及制造费用、委托封测费。公司报告期晶圆代工成本占生产成本的比重分别为 24.40%、25.98%、38.23%，逐步上升，主要系因公司逐步由委外封装转为自主封装后，生产成本总额逐步下降，故在公司晶圆代工成本未发生重大变化的情况下，晶圆代工成本占生产成本的比重逐步上升。公司报告期委托封测费占生产成本的比重分别为 68.31%、51.86%、17.37%，快速下降，主要系公司 2013 年 6 月封装生产线投产，逐步由委外封装转为自主封装。公司其他材料系封装过程中除晶圆外的其他直接材料，因公司 2012 年系全部委外封装，故无其他直接材料投入，2013 年、2014 年 1-4 月随着自主封装比例的提升，公司其他直接材料占成本的比重分别上升至 4.36%、14.90%。公司人工及制造费用主要系封装及测试过程中发生，2013 年 6 月公司封测生产线投产前，公司封装系全部委外，测试系部分委外，2012 年公司人工及制造费用主要系测试过程中投入。2013 年 6 月后，随着公司由委外封装逐步转为自主封装，相应人工及制造费用逐步增加。

2、报告期公司供应商情况

2014 年 1-4 月、2013 年、2012 年公司前五名供应商分别如下：

序号	2014年1-4月供应商名称	采购内容	采购额(元)	占比(%)
1	江苏长电科技股份有限公司	封装测试服务	1,937,454.06	30.18
2	无锡华润上华科技有限公司	晶圆	1,249,411.95	19.46
3	无锡华润上华半导体有限公司	晶圆	1,116,341.58	17.39
4	进峰贸易(深圳)有限公司	IC封装框架	714,167.62	11.12
5	江阴市州禾电子科技有限公司	封装测试服务	340,978.38	5.31
合计			5,358,353.59	83.46

续上表

序号	2013年度供应商名称	采购内容	采购额(元)	占比(%)
1	江苏长电科技股份有限公司	封装测试服务	21,717,599.16	46.16
2	无锡华润上华科技有限公司	晶圆	8,788,106.62	18.68
3	无锡华润上华半导体有限公司	晶圆	4,908,432.01	10.43
4	上海光刻电子科技有限公司	制版	2,514,769.63	5.35
5	江阴市州禾电子科技有限公司	封装测试服务	1,237,941.20	2.63
合计			39,166,848.62	83.25

续上表

序号	2012年度供应商名称	采购内容	采购额(元)	占比(%)
1	江苏长电科技股份有限公司	封装测试服务	19,788,835.56	52.67
2	无锡华润上华科技有限公司	晶圆	6,771,251.17	18.02
3	无锡华润上华半导体有限公司	晶圆	6,195,077.83	16.49
4	上海光刻电子科技有限公司	制版	1,558,628.21	4.15
5	无锡红光微电子股份有限公司	封装测试服务	839,697.14	2.23
合计			35,153,489.91	93.56

江苏长电科技股份有限公司(股票代码:600584),于1998年11月6日成立,注册资本85,313.361万元,公司经营范围为:研制、开发、生产、销售半导体、电子元件、专用电子电气装置,销售本企业自产机电产品及成套设备,自

营和代理各类商品及技术的进出口业务，开展本企业进料加工和“三来一补”业务。

无锡华润上华科技有限公司，于 2002 年 7 月 16 日成立，注册资本 50000 万美元，公司经营范围为：研究开发设计制造集成电路（包括集成电路测试与封装、光罩制作）、电路模块、微处理机、微处理器、半导体记忆体记忆零组件、新型电子元器件、新型平板显示器件；半导体元器件专用材料的开发生产。

无锡华润上华半导体有限公司，于 1999 年 7 月 21 日成立，注册资本 16801.147 万美元，公司经营范围为：研究开发设计制造集成电路（包括集成电路测试与封装、光罩制作）、电路模块、微处理机、微处理器、半导体记忆体记忆零组件、新型电子元器件、新型平板显示器件。

晶圆代工、封装测试是 IC 成品制造的重要环节，IC 设计公司可将上述环节由专业公司代工，属于该产业链高度成熟的协作模式。

作为 IC 设计公司，公司主要是向晶圆代工企业采购晶圆以及向封装测试企业委托封装测试服务。报告期，公司对对前五大供应商采购金额合计占总采购中的比例分别为 93.56%、83.25%和 83.46%，存在一定的依赖性，这主要由公司的业务模式所决定。晶圆是公司产品的主要原材料，由于晶圆加工对技术及资金规模的要求极高，合适的晶圆代工厂商选择范围有限，导致公司的晶圆代工厂较为集中。全球前 4 名代工厂的市场份额达 80%以上，市场集中度非常高。公司晶圆的主要供应商为无锡华润上华科技有限公司、无锡华润上华半导体有限公司，2012 年、2013 年、2014 年 1-4 月，公司对两者的采购金额占公司总采购金额的比例分别为 34.51%，29.11%，36.85%，总体保持稳定。

对于封装测试，据统计，2010 年底，国内有一定规模的 IC 封装测试企业有 79 家，由于 IC 设计企业销售规模不大，有较多 IC 封装测试企业能够满足公司的要求，通常为了建立长期的合作关系，增加供应渠道的稳定性，一般选择 3-5 家封装测试企业合作。由于国内封装测试企业数量较多、市场充分竞争，公司产品在封装和测试企业的技术磨合期较短，公司对这类供应商不存在重大依赖关系。报告期内，公司第一大供应商江苏长电科技股份有限公司为公司产品的主要封装测试外包厂商。公司向其支付的封装测试费用占公司总采购金额的比例分别

为 52.76%，46.16%，30.18%，呈逐步下降的趋势，主要原因是考虑到在 IC 生产旺季，可能会存在封装测试厂产能饱和，不能保证公司产品及时供应的风险，因此 2013 年下半年始公司自建封装测试线和可靠性实验室，降低对供应商的依赖。

综上所述，在 IC 行业中，由于晶圆代工所需投资的金额较大，规模效应显著，晶圆代工业务基本集中于占据行业前几位的企业，且 IC 设计企业为了增加供应渠道的稳定性，一般选择 3-5 家封装测试企业进行合作，导致 IC 设计公司的供应商也较为集中。这一特点也体现在国内其他 IC 设计公司中。2013 年，同行业部分公司向前五名供应商采购的金额占总采购金额的情况如下表示：

公司名称	向前五名供应商采购占比 (%)
国民技术	46.40%
北京君正	95.53%
欧比特	70.73%
中颖电子	91.80%
芯朋微	90.95%

注：芯朋微因未披露 2013 年向前五名供应商采购占比，故采取 2012 年数据。

公司采用无晶圆厂运营模式，有效降低了公司的运营成本，提高了公司的资金使用效益。公司专注于 IC 设计，而将芯片制造、封装测试工序外包，符合 IC 产业垂直分工的特点，也符合近年来 IC 设计市场规模占 IC 整体产业价值比例逐渐增长的趋势，有利于公司提高 IC 设计水平、降低产品生产成本和扩大市场占有率，不会对公司的持续经营造成重大不利影响。

（四）公司与前五大供应商、前五大客户的关联情况

公司供应商江苏长电科技股份有限公司实际控制人、董事长王新潮在 2009 年 6 月至 2012 年 8 月期间曾持有公司 4.44% 股份，并担任公司董事。此后，王新潮未持有公司股份，亦未在公司任职。

除上述事项外，报告期内公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持有公司 5% 以上股份的股东均不在主要客户及供应商中任职或拥有权益。

（五）公司报告期外协情况

IC 设计制造可以进一步分为 IC 设计、晶圆代工、封装测试三个生产环节。三者之间的生产环节关系表现为：晶圆代工指根据委托企业的 IC 设计，将设计数据分次刻录在晶圆上，收取代工费。封装测试企业将制作好的晶圆进行切割并封装形成最终 IC 产品，经过测试后将合格品交付设计企业，并收取相应加工费用。公司专注于 IC 设计并自建封装测试线，将晶圆代工、部分封装测试工序委托给外协厂商，符合当前 IC 产业垂直分工的特点。

公司属于中小 IC 设计公司，属于智力密集型产业，高度依赖智力成果，业务发展的关键要素为 1) 优秀成熟的研发人员；2) 敏锐的市场判断能力；3) 市场销售能力。而晶圆代工、封装测试属于资本密集型和技术密集型产业，以晶圆代工为例，晶圆加工对技术及资金规模的要求极高，全球前 4 名晶圆代工厂的市场份额达 80%以上，市场集中度非常高。因此，本公司与外协厂商属于行业上下游关系，共同构成 IC 设计制造完整的产业链。”

本公司外协生产的主要内容为晶圆代工和部分封装测试。晶圆代工厂指专业的 IC 制造公司，其业务主要是将委托代工的 IC 设计，用极精密的设备、按照严格的生产流程，刻录在晶圆上，收取代工费。封装测试，是将制作好的晶圆进行切割，并封装成为最终的 IC 产品。

晶圆代工、封装测试是 IC 成品制造的重要环节，IC 设计公司将上述环节由专业公司代工，属于该产业链高度成熟的协作模式。目前，国内大部分 IC 设计企业只从事 IC 设计、销售业务，将芯片制造和封装测试工序外包，属于无生产线的 IC 设计公司（简称为“Fabless 厂商”），如 A 股上市公司的北京君正（300223）、中颖电子（300327）、挂牌公司的无锡芯朋微（430521）均为此种模式。其原因及必要性如下：1) 在 IC 制造领域，全世界仅有少数企业集芯片设计、制造、封装、测试和销售等各个环节或其中两、三个环节为一体，通常规模较大，综合实力较强，如英特尔(Intel)、德州仪器(TI)、意法半导体(ST)和瑞萨电子(Renesas)等，业内称为 IDM(Integrated Device Manufacturer)；2) 晶圆代工厂属于资本密集且技术密集的行业，行业进入的技术障碍和资本门槛较高。台积电、联电、中芯国际等为典型的晶圆代工厂；3) 对于封装测试，据

统计，2010 年底，国内有一定规模的 IC 封装测试企业有 79 家。长电科技、华天科技、南通富士通和华润安盛是中国本土专业封装测试厂商中的知名公司，其中长电科技系上市公司，且为公司的主要供应商。

公司的前五大外协厂商及外协内容见下表：

序号	供应商名称	外协内容
1	江苏长电科技股份有限公司	封装测试服务
2	无锡华润上华科技有限公司	晶圆代工
3	无锡华润上华半导体有限公司	晶圆代工
4	江阴市州禾电子科技有限公司	封装测试服务
5	无锡红光微电子股份有限公司	封装测试服务

公司同封装测试厂的合作模式为：公司向封装厂提供合格芯片及所需产品的封装测试技术参数，并下达加工订单；双方确定每批产品的具体单价后，封装厂按照相应封装工艺完成产品封装并测试。

公司同晶圆代工企业的合作模式为：公司根据产品设计要求向晶圆代工厂下达订单，双方确定价格后，晶圆代工厂对晶圆圆片进行工艺加工，生产出公司所需半导体部件的圆片。

公司与外协厂商的定价采取市场化原则，价格由双方谈判，随行就市，价格公允，不存在利益输送。如晶圆代工厂商一般在综合采购量、晶圆制程、大小、质量、市场供求等因素后向公司提供报价单。外包封装测试服务方面，公司与长电科技等厂商的定价机制为双方签订长期供应协议，长电科技等厂商根据各类产品的技术难度、采购量等因素综合考虑后，向公司提交报价单，若某类产品的市场因素发生较大变化，双方再就特定产品重新协商定价，其他产品的定价则一直予以保持，双方系按市场价定价，价格公允。

报告期公司生产成本中外协成本构成变动情况如下：

成本项目	2014 年 1-4 月		2013 年		2012 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
晶圆代工	2,515,563.56	38.23%	8,664,663.15	25.98%	8,501,350.86	24.40%

封测费	1,143,170.02	17.37%	17,291,842.10	51.86%	23,801,062.72	68.31%
合计	3,658,733.58	55.60%	25,956,505.25	77.84%	32,302,413.58	92.70%

公司外协成本主要为晶圆代工成本及封测费，报告期占生产成本的比重分别为 92.70%、77.84%、55.60%，系公司生产成本主要构成。公司报告期封测费占生产成本的比重分别为 68.31%、51.86%、17.37%，快速下降，主要系公司 2013 年 6 月封装生产线投产，逐步由委外封装转为自主封装。公司报告期晶圆代工成本占生产成本的比重分别为 24.40%、25.98%、38.23%，逐步上升，主要系因公司逐步由委外封装转为自主封装后，生产成本总额逐步下降，故在公司晶圆代工成本未发生重大变化的情况下，晶圆代工成本占生产成本的比重逐步上升。

从国内 IC 制造业的总体产业结构来看，由于国内封装测试企业数量较多、市场充分竞争，公司产品在封装和测试企业的技术磨合期较短，公司对这类供应商不存在重大依赖关系。

集成电路设计与圆片加工企业的工艺参数关联度较高，电路设计须依据工艺参数和工艺线特征，因而达到稳定生产的周期较长，更换代工企业的成本相对较高，对已选定的圆片代工企业存在一定的依赖度，这是行业的普遍特征。降低这一依存度的主要方式为：设计企业须不断提升技术水准，缩短与新工艺线的磨合时间；其次，增加新的备选圆片加工企业。公司在这两方面均已取得进展，已尝试与新的圆片加工厂完成一些产品的设计，未来计划增加数家新的圆片加工供应商，逐步降低对少数晶圆代工商的依赖。

公司设专门质量部门对代工厂进行定期稽核；公司同主要外协厂商签订长期合作协议时都附带有签署《封装加工技术协议》及《圆片加工质量协议》，明确质量标准及双方权利义务，确保品质问题；公司建立质量控制实验室，对外协产品加强抽检检验；公司已开始逐步推行 ISO/TS16949 质量管理体系，对公司内部和外协的所有过程进行系统管理，对过程指标实行目标管理，减少变异及浪费，降低成本，提升效益。该体系的认证工作正在推进中。

公司外协厂商江苏长电科技股份有限公司实际控制人、董事长王新潮在 2009 年 6 月至 2012 年 8 月期间曾持有公司 4.44% 股份，并担任公司董事。此后，

王新潮未持有公司股份，亦未在公司任职。公司外协厂商无锡新洁能功率半导体有限公司的控股股东、实际控制人张燕芳自公司成立至 2012 年 9 月为公司实际控制人。除此之外，外协厂商与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

公司在与主要外协厂签订的合作协议中涉及公司核心技术部分均加入知识产权保护条款，条款涉及双方的专利，商标，工业设计，版权，专有技术等方面，明确双方法律权利与义务，防止公司核心技术外泄。

（六）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同及订单情况如下：

1、销售合同及订单

订单日期	客户	客户订单号	订单金额	完成金额	执行比例
2012年度					
2012. 10. 15	深圳汤诚	P02012100032	387, 847. 50	387, 847. 50	100%
2012. 10. 22	深圳汤诚	P020121022005	243, 600. 00	243, 600. 00	100%
2012. 10. 25	深圳汤诚	P0201210251008	666, 510. 00	666, 510. 00	100%
2012. 12. 11	深圳汤诚	P020121211123	521, 040. 00	521, 040. 00	100%
2012. 12. 3	深圳福光泰	2012120300015	298, 553. 00	298, 553. 00	100%
2012. 9. 10	深圳艾美	NLYHW201209010	366, 729. 96	366, 729. 96	100%
2012. 8. 25	深圳友骏	P01208252840	21, 000. 00	21, 000. 00	100%
2013年度					
2013. 2. 25	深圳汤诚	P020130225003	1, 511, 040. 00	1, 511, 040. 00	100%
2013. 3. 5	深圳汤诚	P020130305003	259, 200. 00	259, 200. 00	100%
2013. 3. 16	深圳汤诚	P020130316009	672, 000. 00	672, 000. 00	100%
2013. 10. 26	深圳汤诚	P020131026002	1, 728, 000. 00	1, 728, 000. 00	100%
2013. 11. 15	深圳福光泰	201311150006	415, 590. 50	415, 590. 50	100%
2013. 7. 12	深圳福光泰	201307120006	332, 128. 74	332, 128. 74	100%
2013. 12. 31	深圳艾美	NLYHW201301231	569, 403. 20	569, 403. 20	100%

2013. 6. 27	深圳祺浩达	CH20130627-001	72, 746. 00	72, 746. 00	100%
2014年1-4月					
2014. 3. 21	深圳汤诚	PO20140321004	220, 440. 00	220, 440. 00	100%
2014. 4. 11	深圳汤诚	PO20140414003	225, 450. 00	225, 450. 00	100%
2014. 2. 15	深圳福光泰	201402150006	247, 630. 00	247, 630. 00	100%
2014. 3. 16	深圳福光泰	201403160008	487, 985. 00	487, 985. 00	100%
2014. 4. 1	深圳艾美	NLYHW20140401-1	387, 687. 04	387, 687. 04	100%
2014. 1. 1	泰州人峰	20140101	402, 756. 00	402, 756. 00	100%
2014. 2. 26	深圳祺浩达	CH20140226-001	67, 870. 00	67, 870. 00	100%

结合客户的重要性及公司日常的订单履行期限短、合同金额小、订单次数频繁的特点，上述重大销售合同主要系前五大客户的对公司经营有重大影响的订单。

2、采购合同及订单

签订日期	供应商	采购内容	实际履行含税金额(元)
2012年度			
2010. 11. 25	无锡华润上华科技有限公司	圆片加工	7, 922, 363. 87
2012. 3. 12	无锡华润上华半导体有限公司	圆片加工	7, 248, 241. 06
2012. 4. 9	江苏长电科技股份有限公司	封装加工	23, 152, 937. 60
2013年度			
2010. 11. 25	无锡华润上华科技有限公司	圆片加工	10, 282, 084. 74
2012. 3. 12	无锡华润上华半导体有限公司	圆片加工	5, 742, 865. 45
2012. 4. 9	江苏长电科技股份有限公司	封装加工	25, 409, 591. 02
2014年1-4月			
2013. 11. 14	无锡华润上华科技有限公司	圆片加工	1, 461, 811. 98
2012. 3. 12	无锡华润上华半导体有限公司	圆片加工	1, 306, 119. 65
2014. 4. 9	江苏长电科技股份有限公司	封装加工	2, 266, 821. 25

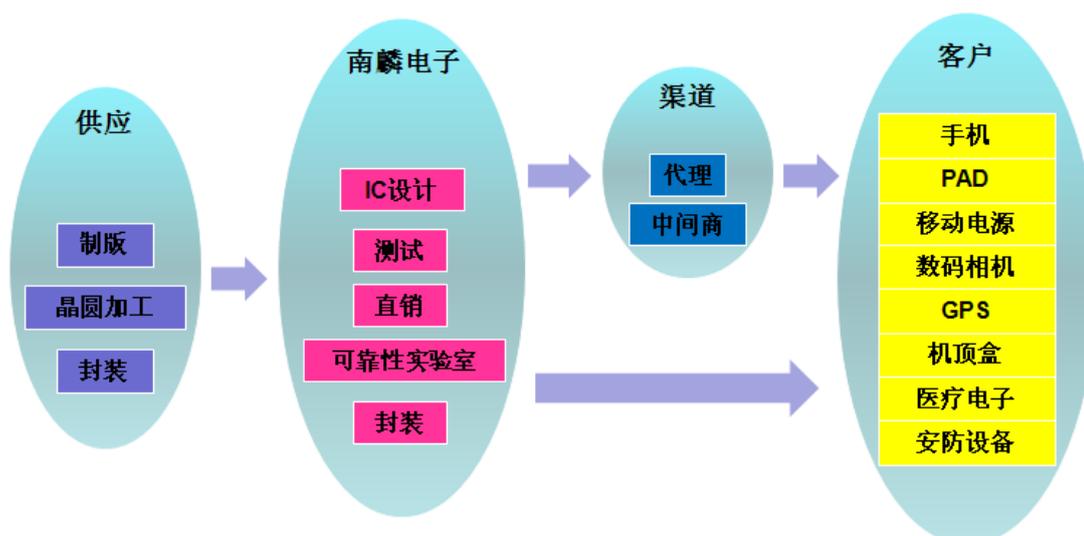
结合公司主要成本系晶圆代工、委托封测费的特点，且与主要供应商签订长期合作协议的特点，上述重大采购合同主要系公司与晶圆代工供应商及封测供应

商的采购合同及订单。

五、公司的商业模式

公司具有典型的“轻资产”特征，销售收入增长不与固定资产投资成线性比例，其盈利核心要素是通过将知识、技术、人力资本创新性地转化为符合各类市场需求的电源管理集成电路，通过外包或自主加工的方式，获得所需的成品电路；同时，以自行设计的集成电路为核心，向客户提供合适的电源解决方案，取得客户系统方案的认可，从而实现向客户销售成品集成电路，并通过销售收入与成本总和之差，实现公司盈利与资金回笼。

公司的商业模式如图所示：



(一) 生产模式

公司作为 IC 设计公司，主要负责芯片产品的定义和方案数据设计。根据产品的情况，确定选择外包封装和自主封装两种模式。

在外包封装模式中，公司完成产品设计后，交付各类代工厂（晶圆代工厂、封装厂、测试厂等）完成指定工艺要求的加工制作，然后再回到公司，由公司自行销售或通过代理商销售给客户。

公司一般将价格竞争激烈、通过自主封装可获得成本优势的产品自主封装。

在自主封装模式中，公司完成产品设计后，首先采购晶圆，同时委托晶圆厂根据公司设计要求进行切割加工，之后由公司自主进行封装测试，并对产品进行可靠性试验，最后公司自行或通过代理商销售给下游客户获取收益。

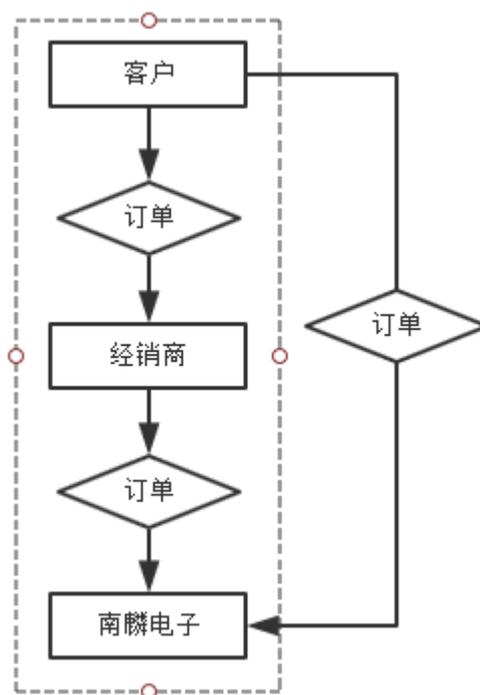
（二）采购模式

公司对外采购的原材料主要有辅材和晶圆。辅材（例如塑封料和框架、金丝、装片胶等）通过经销商采购，为保证成品质量，公司所采购的辅材均为国际知名厂商生产的材料；晶圆直接向无锡华润上华采购。为保证采购的性价比，公司董事长直接参与晶圆和重要辅材采购的谈判。

（三）销售模式

IC 产品的终端客户企业数量庞大，处于高度分散的状态，公司销售模式与行业内的其他公司一样，采取以通过经销商销售为主，直销为辅的销售模式，不存在对经销商的重大依赖。公司与主要客户保持了稳定的销售关系，客户名单相对变动较小，除第一大客户外，其余客户销售额占比基本都在 10%以下，显示公司销售分散，销售集中度不高。公司与主要经销商之间实行在销售代理协议框架基础上的订单销售。此外，还有部分的销售通过公司直销，公司直销模式主要目的是为公司市场部和设计部提供第一手的市场信息。

公司的销售模式如下图所示：



注：虚框内为经销模式下订单的取得流程，虚框外为直销的取得流程。

报告期公司直销和代销收入及占比情况如下：

项目	2014年1-4月		2013年度		2012年度	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例	金额（元）	比例
经销	8,477,607.17	70.78%	48,583,910.45	86.06%	44,561,954.62	84.29%
直销	3,499,797.71	29.22%	7,869,622.49	13.94%	8,305,472.86	15.71%
合计	11,977,404.88	100.00%	56,453,532.94	100.00%	52,867,427.48	100.00%

公司直销的产品主要以 LED 驱动系列产品为主，2014 年以来该系列产品销量增长迅速，导致了公司 2014 年 1-4 月直销收入占比有大幅上升。

由于 IC 产品型号众多、应用行业广泛，经销商会代理或销售多个品牌、多种型号，以满足各类客户的需求。公司一般选择行业中与公司市场地位相当，资金实力，渠道能力较强的经销商为公司的客户，主要考察经销商回款时间的长短，其下游厂家的产品需求是否与公司的产品结构及产能相互匹配。公司不定期地对部分终端客户进行拜访，了解客户对产品的使用情况及对经销商服务的满意度。公司对经销商给予一定的宽限账期和信用额度，结算政策以 1-2 月为主，对个别长期合作客户的结算周期可以适当延长。经销商根据订单约定的价格从公司购进

产品，公司应保证产品的及时供应；对于未按时支付货款的经销商，公司将给予暂停供货并作其他相应处理。公司对经销商具有较强的议价能力，价格方面以公司定价为主，公司根据经销商反馈一些市场上其他定价情况，灵活调整产品销售价格。

六、公司所处行业概况

（一）所处行业概况

1、所属行业

公司主要从事电子元器件、集成电路及产品的研发、设计、生产、销售及相关技术服务。根据上市公司行业分类指引（2012年修订）公司属于C39计算机、通信和其他电子设备制造业；根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）公司属于C3963单片集成电路、混合式集成电路的制造业。

2、产业政策

集成电路（Integrated Circuit, 简称IC）作为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会发展的战略性产业，国家给予了高度重视和大力支持，出台了一系列鼓励扶持政策，为集成电路产业建立了优良的政策环境。

时间	内容
2000年	《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》 《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》 （财税[2000]25号）
2002年	《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知》
2005年	《集成电路产业研究与开发专项资金管理暂行办法》 《国家鼓励的集成电路企业认定管理办法（试行）》
2006年	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》 《2006-2020年国家信息化发展战略》

2008年	《集成电路产业“十一五”专项规划》
2009年	《电子信息产业调整和振兴规划》
2010年	《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》
2011年	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》 《集成电路产业“十一五”发展规划》
2014年	《国家集成电路产业发展推进纲要》

2000年6月，国务院发布《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号），该政策作为集成电路产业发展的核心政策在税收优惠、生产性原材料进口、集成电路技术和成套生产设备进口、设备折旧、知识产权保护等方面对集成电路产业进行大力扶持。

2000年9月，财政部、国家税务总局、海关总署发布《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号），制定了鼓励集成电路产业发展的若干税收政策。

2002年10月，财政部、国家税务总局发布了《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知》（财税[2002]70号），出台了针对集成电路产业更多的税收优惠政策。

2005年3月，财政部、信息产业部、国家发改委发布《集成电路产业研究与开发专项资金管理暂行办法》（财建[2005]132号），由国家设立集成电路产业研究与开发专项资金，鼓励集成电路企业加强研究与开发活动。

2005年10月，国家发改委、信息产业部、税务总局、海关总署发布《国家鼓励的集成电路企业认定管理办法（试行）》（发改高技[2005]2136号），规范国家鼓励的集成电路企业认定工作，进一步贯彻落实国务院有关政策及其配套优惠政策。

2006年2月，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，纲要提出发展信息产业和现代服务业是推进新型工业化的关键，同时纲要将“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件”（01专项）、极大规模集成电

路制造技术及成套工艺（02专项）作为16个重大专项的前两位，并在科技投入、税收优惠、金融支持、知识产权保护等方面提出了政策和措施。

2006年5月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《2006-2020年国家信息化发展战略》，提出了提高信息产业竞争力，加强政府引导，突破集成电路、软件、关键电子元器件、关键工艺装备等基础产业的发展瓶颈，提高在全球产业链中的地位，逐步形成技术领先、基础雄厚、自主发展能力强的信息产业。

2008年1月，原信息产业部编制并颁布了《集成电路产业“十一五”专项规划》，制定了“十一五”期间集成电路产业的发展思路与目标、重点任务以及相应的政策措施。

2009年4月，国务院通过《电子信息产业调整和振兴规划》，提出了“突破集成电路、新型显示器件、软件等核心产业的关键技术”的任务目标，并在集成电路产业的产业体系完善、自主创新、产业升级等方面提出优惠措施，加大投入力度及鼓励软件和集成电路产业发展政策的实施力度。

2010年10月，国务院发布了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号），提出了“着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业”，集成电路产业作为新一代信息技术产业的重要组成部分，是国家未来重点发展的战略新兴产业。

2011年2月，国务院发布的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4号，以下简称4号文件）从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等七方面为集成电路产业发展提供了更多的优惠政策。4号文件明确提出，“继续实施国发18号文件明确的政策，相关政策与本政策不一致的，以本政策为准”，其中对集成电路产业的支持更由设计企业与生产企业延伸至封装、测试、设备、材料等产业链上下游企业，可见2011年4号文件是18号文件的拓展与延伸。由此可见，国家对集成电路产业的政策扶持力度更进一步增强。

2011年12月，工信部发布《集成电路产业“十二五”发展规划》，作为行业发展的指导性文件，对于促进集成电路产业全面、协调、可持续发展具有重要意义。

2014年6月，工信部发布《国家集成电路产业发展推进纲要》，《纲要》表示集成电路产业是信息技术产业的核心，计划到2015年，全行业销售收入超过3,500亿元。首次提出设立国家产业投资基金。《纲要》提出了行业发展的主要任务和发展重点，即着力发展集成电路设计业，加速发展集成电路制造业，提升先进封装测试业发展水平，突破集成电路关键装备和材料。

3、公司所处的行业分析

(1) 行业基本情况

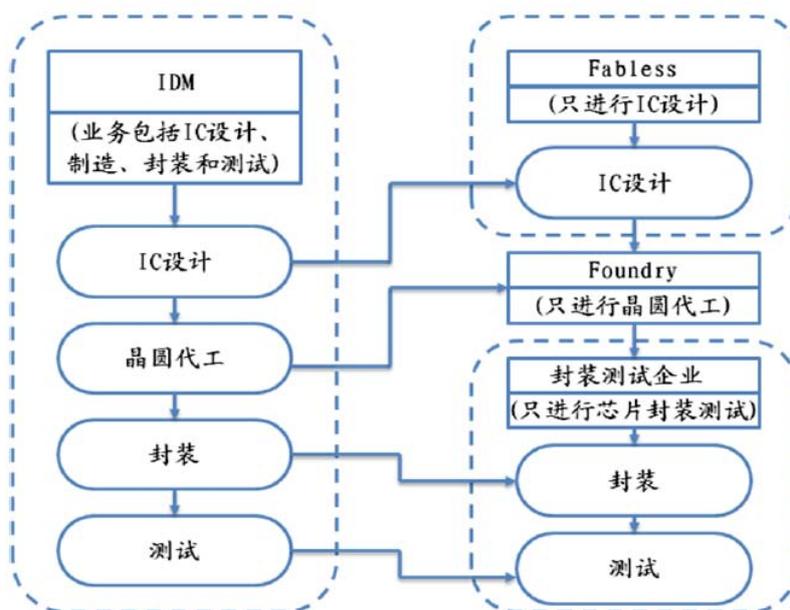
集成电路是一种把半导体设备和其他被动组件制造在硅晶圆表面上的技术，最早在20世纪50年代末由美国的德州仪器和仙童半导体发明并申请专利。

集成电路按其功能、结构的不同，可以分为模拟集成电路、数字集成电路和数/模混合集成电路三大类；集成电路也可以按集成度高低的的不同分为小规模集成电路、中规模集成电路、大规模集成电路、超大规模集成电路、特大规模集成电路以及极大规模集成电路等；此外，集成电路还可以按照制作工艺、导电类型、用途、应用领域及外形分为不同的种类。

集成电路行业属于典型的资本密集型、技术密集型和人才密集型产业，并且规模经济特征明显。集成电路行业是需要不断投入巨额资金、大量人力的产业，设备费用和研发费用都非常大。

(2) 所处行业涉及的市场主体

从集成电路产业链分工的角度而言，公司属于IC设计行业，位于产业链上游。IC产业链由IC设计制造、经销商分销及终端电子产品生产制造三个环节构成。从IC设计制造的产业模式来看，该领域的企业由IDM、Fabless、Foundry以及封装、测试厂商组成。



在 IC 制造领域，全世界仅有少数企业集芯片设计、制造、封装、测试和销售等各个环节或其中两、三个环节为一体，通常规模较大，综合实力较强，如英特尔(Intel)、德州仪器(TI)、意法半导体(ST)和瑞萨电子(Renesas)等，业内称为 IDM(Integrated Device Manufacturer)。

晶圆代工厂指专业的 IC 制造公司，其业务主要是将委托代工的 IC 设计，用极精密的设备、按照严格的生产流程，刻录在晶圆上，收取代工费。晶圆代工厂属于资本密集且技术密集的行业，行业进入的技术障碍和资本门槛较高。台积电、联电、中芯国际等为典型的晶圆代工厂。

封装测试，是将制作好的晶圆进行切割，并封装成为最终的 IC 产品。长电科技、华天科技、南通富士通和华润安盛是中国本土专业封装测试厂商中的知名公司，其中前三家企业是上市公司。

目前，国内大部分 IC 设计企业只从事 IC 设计、销售业务，将芯片制造和封装测试工序外包，属于无生产线的 IC 设计公司（简称为“Fabless 厂商”）。

表 全球集成电路产业上市公司一览

产业链定位	公司名称
芯片设计	大唐电信、同方国芯、国民技术、上海贝岭、北京君正、中颖电子、复旦微电子、ARM、联发科、高通、NVIDIA（英伟达）、博通、恩智浦、英特尔、展讯、瑞迪科

封装测试	长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技、日月光、矽品、Amkor（安靠）
芯片制造	中芯国际、台积电、联电

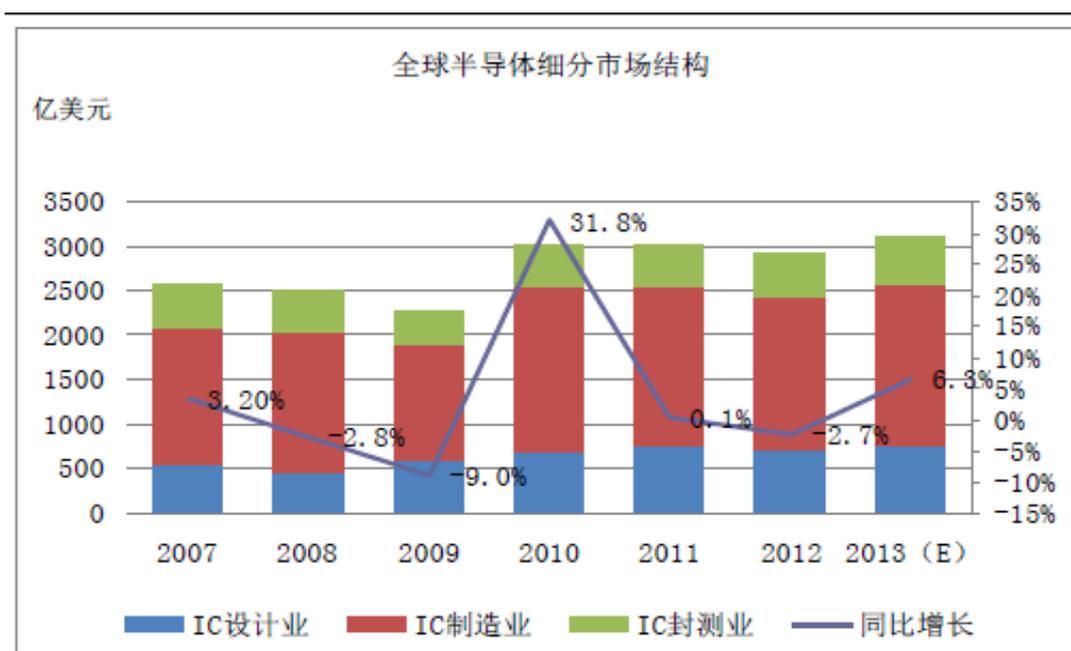
从终端客户来看，中国 IC 应用市场的基本结构为“3C+A+M+I”。其中，3C 是指计算机(Computer)、通讯(Communication)、消费电子产品(Consumer Electronics)，A 是指汽车电子产品(Automobile)，M 是指手机(Mobile Phone)，I 是指工业控制产品(Industry)。

（二）市场规模

1、市场容量

（1）全球市场相关情况

2013 年全球集成电路产业总产值超过 3,000 亿美元，其中 IC 制造、设计、封装的金额占比分别是 58%、24%、17%，制造类占比过半；除了金融危机前后造成的大幅波动外，每年增速变化都在个位数以内；IC 制造由于资本投入大，生产周期长，波动性最大，封测行业由于生产周期短，库存低，波动性最低；轻资产属性的 IC 设计贴近终端消费市场，直接受益于创新产品的拉动，景气领先于制造和封装。

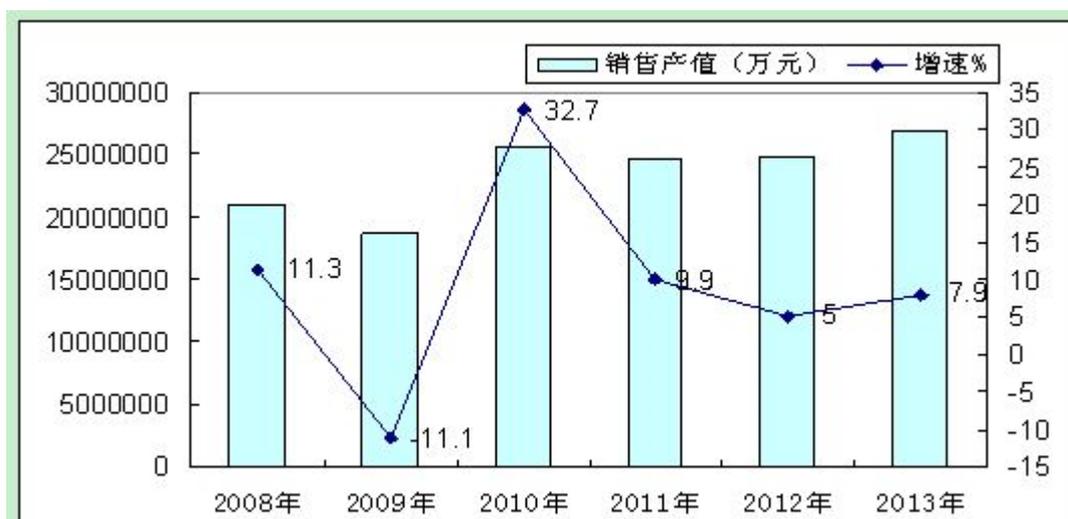


资料来源：wind

(2) 中国市场相关情况

全球半导体市场经历 2012 年的衰退后，在智能手机、平板电脑、机顶盒及汽车电子产品等市场强劲需求的推动下，2013 年恢复增长。我国集成电路行业抓住市场契机，在国家加快推动集成电路产业发展相关政策的支持下，全年完成销售产值 2693 亿元，同比增长 7.9%，增幅高于上年 2.9 个百分点；累计生产集成电路 866.5 亿块，同比增长 5.3%。

2008-2013 年我国集成电路行业增长情况



数据来源：工信部

受芯片发展规律的影响，IC 行业具有技术呈周期性发展和市场呈周期性波动的特点。

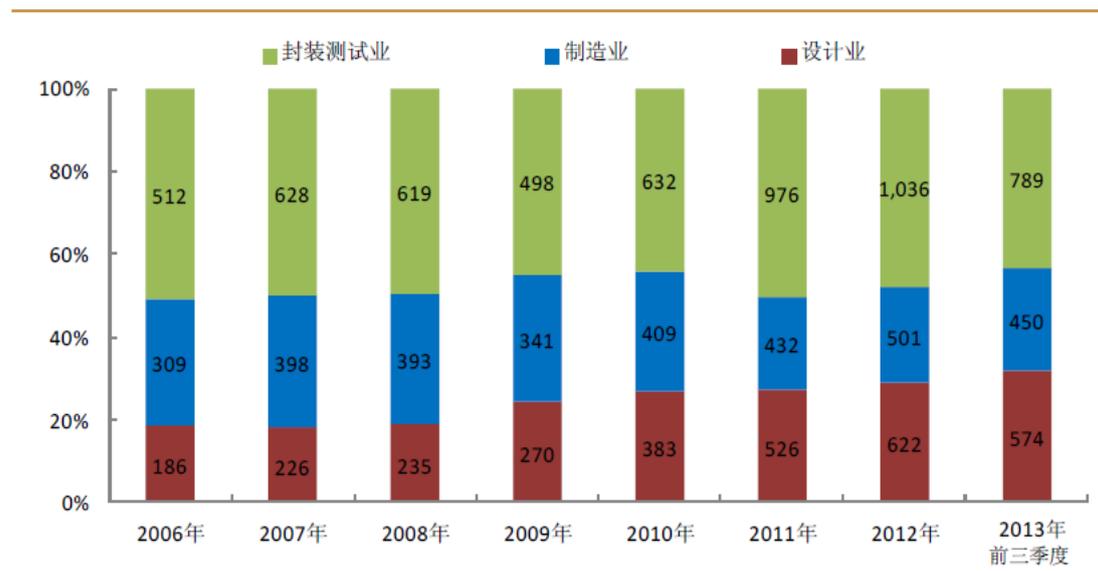
半导体产品主要应用于各类电子终端产品，如 PC、手机、平板、移动电源等，这类产品大部分属于可选消费品，消费需求弹性较大。因此，半导体产业也随着宏观经济的波动而波动，且波动幅度要大很多。

半导体行业本身有较大的周期性波动态势，公司的经营业绩会因为整体半导体市场的周期性波动，而产生一定的影响。

如上图所示，2009 年，集成电路行业经历了大幅下滑，下滑幅度 11.1%，2010 年，行业快速反弹，同比增长 32.7%，2011 年到 2012 年，行业出现周期性回落，增速放缓，2013 年行业温和增长，同比增长 7.9%。经过长时间的高速增长以后，增速趋缓属于行业的正常调整。

随着国内集成电路产业的发展，IC 设计、IC 制造以及 IC 封装测试三业的格局正在不断优化。总体来看，IC 设计业所占比重呈现逐年增长的趋势，IC 制造业近两年占比也有所提升，IC 封装测试业所占比重稳步下降。2013 年前三季度，IC 设计业实现销售额 574 亿元，同比增长 31.8%；IC 制造业实现销售额 450 亿元，同比增长 16.1%；IC 封测业实现销售额 789 亿元，同比增长 6.0%。2013 年前三季度，中国 IC 设计、IC 制造以及 IC 封装测试三业所占比重分别为 31.7%、24.8%和 43.5%。

中国集成电路各子行业销售情况



资料来源：wind

在智能手机、IC 卡等国内需求市场快速增长的带动下，国内 IC 设计业销售收入持续保持较高增速。随着集成电路设计业的快速发展，其在国内集成电路产业中所占的份额也不断提升。2012 年，集成电路设计业在整个产业中所占的份额为 28.8%，2013 年前三季度进一步上升至 31.7%。同时，中国集成电路设计业的发展速度也大大高于全球集成电路设计业的整体成长水平，2012 年中国在全球集成电路设计业中所占的比重突破 10%大关至 12.8%。（资料来源：CSIA《中国半导体产业发展 2013》）

2、行业竞争程度

同国际上比较，与封装业和制造业主要被外资企业主导不同，我国大陆设计行业的前十名企业均为本土企业。这与芯片设计产业的知识技术密集型特点有较

大关系。

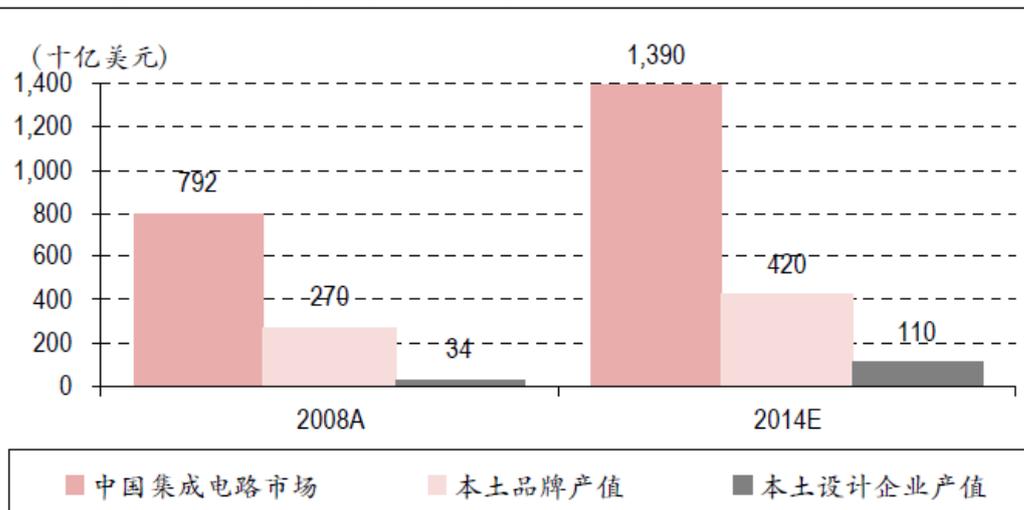
2013 年中国大陆前 10 大芯片设计企业

排名	企业名称	销售额 (亿人民币)
1	华为海思	130.4
2	展讯通信	62.3
3	锐迪科微电子	28
4	大唐半导体	24
5	南瑞智芯微电子	21.5
6	士兰微电子	18
7	中国华大	17.9
8	格科微	16.9
9	中星微电子	15.4
10	中电华大	10.5

资料来源：wind

从国内来看，我国 IC 设计产业市场集中度相对较低，中国前十大 IC 设计企业 2012 年的市场份额仅为 36%，而在全球市场，前十大 IC 设计企业市场份额高达 69%。从业态来看，IC 设计产业具有技术密集和资本密集的属性，行业发展趋势有利于强者恒强。中国大陆地区 IC 设计行业市场集中度偏低的情况反映出国内 IC 设计企业的力量弱小，缺乏能够独立做大做强的领军企业。

中国集成电路市场中本土品牌和本土设计公司份额



资料来源：CSIA，中银国际研究

目前，IC 设计产业呈现由发达国家向中国产业转移的格局，中国的 IC 设计产业正处于上升期。2012 年，中国大陆地区 IC 销售额占到全球 IC 整体销售额的 51%，而国内 IC 供应商只能满足其中约 20% 的需求，2012 年中国大陆地区 IC

净进口额高达 9,000 亿元人民币。从进口 IC 的产品结构来看, 每年进口的 IC 中有相当一部分属于中低端产品。国内 IC 设计企业有相当大的替代市场空间可以去挖掘。

目前我国 IC 设计企业技术水平整体仍较落后于国际先进水平, 尤其是核心芯片产品设计及高端芯片产品设计与国际市场有着较大技术水平差距。因此欧美、日本等半导体厂商仍占据高端市场的主力地位。台湾厂商和本土厂商在中低端应用市场具有一定价格优势, 但由于国内 IC 设计行业大多规模较小, 同质化严重, 创新意识不足, 因此在中低端市场内竞争较为激烈。

3、行业壁垒

集成电路设计行业整体属于技术密集型及资本密集型相结合的行业, 研发能力带来的新产品持续开发能力是一个 IC 企业的核心竞争力, 因此存在着一定的进入壁垒, 具体如下:

(1) 技术壁垒

IC 设计行业对企业技术水平有相当高的要求, 企业必须保证产品的可靠性及加工工艺的稳定性, 并且具有独特的技术优势, 才能市场中立足。同时又要求企业针对变化的市场需求, 具备快速的技术革新, 创新能力, 这就对企业的技术储备, 技术研发能力提出了较高的要求, 使得不具备专业技术的企业难以进入市场。

(2) 资本壁垒

IC 设计行业研发投入较大, 且研发风险, 不确定性较高, 因此对公司的资本投入有一定要求。行业竞争激烈, 产品, 技术更新换代较快, 对企业连续的资本投入能力有较高要求, 只有资本实力较为雄厚的企业才能抵御相关风险。

(3) 人才和经验壁垒

IC 设计作为技术密集型行业, 技术的储备来源于人才的储备, 公司研发团队的实力很大程度上决定了公司的实力。高素质人才培养, 除了需要保持大量具有较高专业技术水平的人才外, 还需要长时间实践和经验积累基础上产生的高素质综合能力的人才。高素质人才培养对于行业潜在进入者具有一定

阻碍。

（三）行业基本风险特征

1、行业竞争激烈，新产品研发压力大

国内 IC 设计行业大多规模较小，同质化严重，多从事低端市场产品的开发，经常在低端市场形成激烈竞争。大量企业缺乏核心竞争力，缺乏准确的细分市场定位。集成电路技术发展升级较快，但中小企业研发周期又相对较长，导致中小企业研发压力较大。经常出现产品研发成功后市场机会已经错失，造成研发资金浪费，同时使后续新产品研发陷入困境。

2、本土企业整体技术落后，高端人才缺乏

在 IC 设计领域，业界国际知名企业重点从事高端产品的生产和销售，本土企业则主要生产、出口、销售市场需求量较大的中低端产品。尽管过去十余年间，我国集成电路设计产业取得了较大的发展，在手机、IC 卡、数字电视、通信专用和多媒体芯片方面取得较大技术突破，但产业规模和技术水平仍难以满足国内市场的需求，还存在多处技术空白。

IC 设计行业作为知识密集型行业，对比发达国家和地区，国内有经验的 IC 设计人才相对稀缺，这是造成国内 IC 设计业整体技术基础较弱、水平较低的主要原因，高端人才短缺，已成为集成电路企业特别是设计企业的发展瓶颈，高端技术人才不足影响到新产品推出进度。

3、制造及封装外包制约产能扩张

国内 IC 设计行业大部分采取 Fabless 方式，即仅从事 IC 产品的设计、销售业务，将芯片制造及封装测试工序外包。风险点在于业务外包后晶圆生产、芯片封测需要依赖上游企业，由于晶圆加工属于资金及技术高度密集型产业，合适的晶圆代工厂商较少，集中度较高，在长期的业务循环中，变更代工企业，则设计企业和新代工企业面临至少半年的磨合期。因此，一旦公司未来产能需求迅速扩张，代工企业产能无法达到公司要求，会直接影响公司产品生产。另一方面，外包模式导致产品的质量，交付用户时间很大程度上受制于封装测试厂商。

七、公司面临的主要竞争状况

（一）公司在行业中的竞争地位

目前，国内从事模拟类集成电路设计和功率类集成电路设计的企业总计约 130 家，2012 年销售总额为 60 多亿元，平均销售收入接近 5,000 万元，而公司销售额为 5,600 元，处于行业平均水平（数据来源：中国半导体行业协会集成电路设计分会）；而与全国排名前十的集成电路设计企业 10 亿数量级的销售规模相比，由于在资本投入等方面的不足，公司仍属于规模较小的集成电路 IC 设计企业，与行业龙头公司的差距主要体现在公司规模、资金投入、技术工艺和生产设备等方面。随着 IC 设计行业逐步由发达国家向中国本土转移，中国 IC 产业正处于上升期，在中低端的领域，国内企业有相当大的替代市场空间可以挖掘。公司瞄准这一机遇，战略定位清晰，将公司有限资源投入到研发及生产上，自建了封装测试流水线，自建可靠性实验室。以高质量的设计和研发水平、有保障的产品质量逐步确立了自身在行业内的可靠形象和地位，整体业务调整磨合完成后，将逐步打开公司业务发展空间。

衡量 IC 设计的关键指标分为两类，一类是产品的功能和性能。根据客户需求和产品性能各有标准，无法定量评判。另外一类是集成电路生产过程中的工艺指标，如产品封装良率，工艺节点等。目前公司自主封装的产品良率达到平均 92.7%。

（二）公司在行业中的竞争优势

公司仍属于规模较小的集成电路 IC 设计企业，竞争优势主要体现为长期独立面向市场运营中，逐步积累的综合比较优势。

1、人才和技术优势

IC 设计行业是知识密集型行业，企业发展的最关键因素是人才。公司管理团队拥有丰富的研发、生产、销售及管理经验。同时，经过多年的发展形成了一支专业的研发人才队伍，公司董事长、核心技术人员刘桂芝具有 25 年的行业经验，研发总监吴国平具有 15 年的研发经验，其他核心骨干均为拥有多年实践经

验的专业人员，核心研发人员基本都在公司持有股份，队伍稳定。优秀的专业人才为公司未来发展奠定了坚实的基础。公司主要产品所采用的核心技术均为自主研发，现有 2 项发明专利和 33 项集成电路布图设计专有权，并应用于公司现有的产品。

2、自建封装测试线的生产模式

相对于其他 IC 设计公司将封装测试工序完全外包的生产模式，公司近年打造了自有的封装测试生产线，将部分销量较大但利润较低的产品自行封装测试。通过这一生产方式，保证了产品工艺的稳定性和高良率，为公司产品的稳定生产和及时供货提供了保障，在和同类公司的产品竞争时获得了竞争优势。

3、严格的质量管控体系

与行业中同类规模的 IC 设计公司不同，公司自主建立了可靠性实验室，通过例行试验管控、工程批产品管控、量产产品管控、库存品管控等一系列质量管控体系，配合公司研发和销售流程，提高公司产品质量，提升生产效率，提升产品的成本优势。

公司有完善的质量成本控制体系，财务部负责制定年度质量成本计划及考核办法并分解落实到各职能部门。每月做一份关于质量成本的分析报告。质量部负责质量体系咨询费、审核费；收集工废、料废、返工/返修工时、复检费用、鉴定、计量、预防等发生的数量信息数据定期反馈给财务部。销售部负责收集记录产品出厂后所发生的索赔、包换、包退等三包损失费用的凭据和发生的质量情报费用。制造部负责统计停工损失工时、工序质量评审、产品质量评审、试验费的数据。行政部负责文件报表印刷费、培训费用的统计和管理。项目部负责统计研发失败、产品改版、设计更改造造成损失的统计和管理。采购部负责对供方质量保证能力调查研究费的统计和管理。

（三）公司的竞争劣势

1、销售渠道有待完善

目前公司产品主要依靠各级代理商销售，较强的代理商可以预付或垫付销售

资金，因此行业中代理商资金实力的强弱，将会影响公司资金的回收速度。目前与公司合作的代理商数量众多，但缺乏实力较强的代理商销售公司产品，导致公司应收账款周转较慢，不利于公司发展。

2、资本实力不足

公司主要从事 IC 研发和设计，在产品研发阶段，包括研发初期及试产阶段，需要耗费较大的基础研究及投片费用，随着公司销售规模的扩大，公司的研发投入和产品备货所需的营运资金数量也大幅增加，这些都需要资金支持。

公司近年开始逐步涉入封装和测试领域，前期投入较大，目前主要依靠主要股东资本投入以及经营盈利来满足公司快速发展需要，面临较大的资金压力。

（四）公司采取的未来竞争策略和应对措施

伴随中国集成电路行业的逐步崛起，IC 设计产业未来面临诸多机遇和挑战。面对激烈的市场竞争，公司将牢固树立创新意识，加强市场调研，完善质量控制，专注于细分市场及产品创新。

IC 设计行业具有周期性波动的特点，公司的经营业绩会随着市场的整体波动而波动。一段时期高速增长后，业绩趋于平缓或下滑是行业正常调整导致。

目前，众多与公司业务体量相当的中小 IC 设计公司在低端集成电路领域展开激烈竞争，盈利能力逐步下滑，但随着国外 IC 设计产业向中国转移，相当部分的中低端产品的设计业务将转向国内，市场空间逐步打开。

面对行业变局，公司迅速做出战略调整，打破行业固有的生产格局，自建封装测试流水线，相关产品良率已达到国内先进水平，在交付时间上也得到保证，从而将目前业务的成本进一步降低，提升盈利能力。同时随着自主质量检测实验室的建立，不断提升产品的质量，工艺水平，未来产品线逐步向中高端延伸，抓住 IC 业务转向国内的机遇，打开公司未来成长空间。

公司将继续提高和完善自主封装测试水平，加大资本投入。目前自主封装的产品主要是低利润率的成本竞争型产品，公司将逐步通过研发升级，开发高附加值，精细化的 IC 产品，并充分发挥自主封装的时间及质量控制优势，逐步将自

主封装线用于生产高利润率的产品，提升公司竞争力。

公司将继续完善和升级可靠性实验室，提高对试验品、批量品、量产产品、库存品的质量管控水平，逐步取得国家级、国际级的各项资质。通过提升质量管控水平，带动公司研发，生产，销售等条线的提升，降低成本，增加利润。

公司将在创新研发中高端产品的基础上，继续完善代理销售渠道，加大与行业中具有较强实力的代理商的合作，缩短公司账期，提高资金周转率。

在未来发展上，目前，可穿戴产品呈现出逐步快速增长的趋势，其应用产品将体现出小批量、多样化的特点。这就要求对应的芯片产品更加微型化、轻薄化、柔性化和高度集成化。公司认为这对于设计企业既是机遇也是挑战。公司针对这一情况，展开战略布局，提出建立符合可穿戴产业发展方向的“快速反应模式”，摆脱中小设计企业普遍面临的封装外包所导致的产品质量不可控，交期不可控的问题，通过自主晶圆测试，自主封装测试，自主可靠性试验，保证产品质量的一致性，稳定性，交付及时性，从而更好适应未来行业发展，打开公司成长空间。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

1. 有限公司阶段三会建立及运行情况

有限公司期间，公司能够按照《公司法》及公司章程的有关规定组成股东会。有限公司设董事会，不设监事会，设1名监事。有限公司对于变更经营范围和住所、股权转让、增加注册资本、整体变更等事项召开了股东会并形成相关决议。但由于公司管理层对于法律法规了解不够深入，股东会的运行也存在不足，股东会决议、董事会决议及会议记录未完整保存；监事对公司的财务状况及董事、高级管理人员所起的监督作用较小；公司未制定专门的关联交易、对外担保等管理制度。

2. 股份公司阶段三会建立及运行情况

股份公司成立后，公司根据《公司法》等相关法律、法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）和高级管理层组成的治理结构。股份公司创立大会暨第一次股东大会和第一届董事会第一次会议审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露办法》和《投资者关系管理制度》。

截至本公开转让说明书签署之日，股份公司共召开股东大会2次、董事会2次、监事会1次，上述会议的召开严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，决策程序、决策内容合法有效，没有发生损害股东、债权人或第三人合法权益的情况。

3. 职工代表监事履行职责的实际情况

自公司职工代表大会选举职工代表监事以来，职工监事能够履行章程赋予的权利和义务，按时出席公司监事会的会议，依法行使表决权。

由于股份公司成立时间很短，公司及管理层对规范运作的意识有待提高，长期的规范运作效果有待考察。

二、股东大会、董事会、监事会及相关人员履行职责的情况

股份公司成立以来，公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议，相关董事、监事和高级管理人员均出席了会议。公司的“三会”相关人员均符合《公司法》规定的任职要求，能按照“三会”议事规则履行其权利和义务，执行“三会”决议。但由于股份公司成立时间很短，“三会”的规范运作及相关人员的规范意识和执行能力仍待进一步提高。

三、董事会对公司治理机制执行情况的评估

有限公司阶段，《上海南麟电子有限公司章程》已经载明了公司、股东、董事、监事、高级管理人员的权利和义务。公司实际运营过程中，股东会能够正常召开，但存在股东会决议、董事会决议及会议记录未完整保存等不规范之处。

股份制改造阶段，公司按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定制订了《上海南麟电子股份有限公司章程》、《上海南麟电子股份有限公司章程（草案）》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《信息披露办法》以及《投资者关系管理制度》等公司规章制度。《上海南麟电子股份有限公司章程》及《上海南麟电子股份有限公司章程（草案）》规定了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利，并对对纠纷解决机制、关联股东和董事的回避、投资者关系管理等制度作出了规定。公司制订了《财务管理规定》、《财务预算编制规定》、《SAPBone 系统运营流程》、《质量环境职业健康信息安全和有害物质控制管理手册》等一系列内部管理制度，基本涵盖了公司治理、财务核算、资产管理、档案管理、人力资源管理等活动各个环节，形成了较为规范的内部管理体系。

公司董事会认为，公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

四、公司及其控股股东、实际控制人最近两年的违法违规情况

公司已依法建立健全法人治理结构。自成立至今，公司及其董事、监事和高级管理人员严格按照相关法律法规及公司章程的规定开展经营活动，不存在重大违法违规行为。

公司控股股东、实际控制人刘桂芝最近两年不存在违法违规及受到相应处罚的情况。

五、公司的独立性

公司自成立以来，坚持按照法律法规规范运作，建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、机构和财务方面均与主要股东及其控制的其他企业相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）业务的独立性

公司的主营业务为“模拟与数模混合类集成电路的设计与研究，为客户提供高效，稳定的集成电路产品”，公司业务独立于主要股东及其控制的其他企业，与主要股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

公司具备完整的供、产、销和研发业务环节，配备了专职人员，拥有独立的业务流程，具备直接面向市场的独立经营能力。

（二）资产的独立性

公司对其拥有的商标、专利、集成电路布图设计专有权、办公设备均具有合法有效的权利证书或权属证明文件。公司的办公用房系通过租赁取得。公司具备独立的生产经营场所。

公司取得了主要财产合法、完整的权属凭证，不存在资产被股东非正常占用的情形。

公司在资产方面具有独立性。

（三）人员的独立性

公司建立了独立的劳动、人事、工资管理体系，对公司员工按照《人力资源和培训控制程序》、《用工、退工控制程序》等规定和制度实施管理。公司高级管理人员与核心技术人员均与公司签订了劳动合同和保密协议，均在公司专职工作，均在公司领取薪金，公司高级管理人员与核心技术人员没有在股东单位兼职。

公司高级管理人员签署了《关于独立性的书面声明》，承诺“1、在公司任职的同时不在股东单位担任除董事、监事以外的职务；2、公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理，不受股东单位影响。3、在公司领取薪酬，同时不在股东单位领取薪酬。”

公司在人员方面具有独立性。

（四）财务的独立性

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，公司实行独立核算，具有规范独立的财务会计制度。公司具有独立银行账号，不存在与股东共用账号的情况；公司依法独立核算并独立纳税。

公司财务人员均为专职人员，在公司领取薪酬并缴纳社保。

（五）机构的独立性

公司根据《公司法》、《公司章程》的要求建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作。公司机构独立于股东，办公场所与股东及其控制的关联企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

六、同业竞争情况

报告期内，南麟电子与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争。

为避免今后出现同业竞争情形，公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理办法》中明确规定了关联交易的决

策程序、关联交易的信息披露等事项。

持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺如下：

“1、除已经披露的情形外，截至本承诺函签署之日，本人/本公司未投资于任何与南麟电子从事相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，自身未经营、亦没有为他人经营与南麟电子相同或类似的业务，与南麟电子不存在同业竞争的情形。

2、本人承诺，除南麟电子外，本人/本公司自身将不从事与南麟电子生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购与南麟电子有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与南麟电子业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与南麟电子的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

3、本人/本公司不会利用南麟电子主要股东地位或其他关系进行可能损害南麟电子及其他股东合法权益的经营活动。

4、如南麟电子进一步拓展业务范围，本人/本公司承诺本人/本公司及本人/本公司控制的企业（如有）将不与南麟电子拓展后的业务相竞争；若出现可能与南麟电子拓展后的业务产生竞争的情形，本人/本公司将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入南麟电子、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护公司利益，消除潜在的同业竞争。

5、本人/本公司确认，本承诺函旨在保障全体股东之权益作出，本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人/本公司愿意承担由此给南麟电子造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人/本公司违反上述承诺所取得的收益归南麟电子所有。”

七、公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况

（一）关联方资金占用情况

截至本转让说明书签署日，公司不存在资金被股东或其控制的其它企业占用的情况。

（二）公司为关联方担保的情况

截至本转让说明书签署日，公司不存在为关联方提供担保的情况。

（三）为防止关联方资金占用采取的措施

为了防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产等行为的发生，公司股东严格依照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》、“三会”议事规则的规定，履行股东的责任和义务；持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员签署了《关于规范关联交易的承诺函》、《避免占用资金承诺函》等书面承诺。

八、公司董事、监事、高级管理人员的相关情况

（一）董事、监事、高级管理人员持股情况

公司董事、监事、高级管理人员共直接持有公司 1,003 万股股份，占公司股本总额的 89.0763%。

股东名称	职务	持股数量（股）	持股所占公司股本的比例	股份是否冻结/质押
刘桂芝	董事长	6,100,000	54.1741%	否
吴国平	董事、总经理	1,210,000	10.7460%	否
吴春达	董事、市场总监	640,000	5.6838%	否
黄年亚	董事、运营总监	400,000	3.5524%	否

何云	董事、董事会秘书、 财务负责人、行政 总监	340,000	3.0195%	否
刘检生	销售总监	600,000	5.3286%	否
蒋小强	监 事	400,000	3.5524%	否
班福奎	监 事	340,000	3.0195%	否
张丽佳	职工代表监事	-	-	否
合 计	-	10,030,000	89.0763%	-

公司董事、监事、高级管理人员中，除上述直接持有本公司股份外，不存在直接、间接持有本公司股份的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员不存在在其他单位兼职的情况。

（三）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至本公开转让说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

（四）董事、监事、高级管理人员的其他相关情况

1. 相互之间的亲属关系

除董事刘桂芝与高级管理人员刘检生系堂兄弟关系外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

2. 最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

3. 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺

公司董事、监事、高级管理人员与公司签订了《劳动合同》，除此之外，董事、监事和高级管理人员与公司不存在签订其他重要协议或做出重要承诺的情况。

4. 其它对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。

九、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成；董事会是公司的经营决策机构，由五名董事组成；监事会是公司的监督机构，由三名监事组成，其中职工代表监事一名；公司总经理、市场总监、运营总监、行政总监、销售总监、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。

报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变更情况如下：

（一）报告期内董事变动情况

2012年8月29日，有限公司召开股东会，免去王新潮董事职务，改选蒋小强为董事，其他董事、监事人员不变。

2012年9月17日，有限公司召开股东会，免去张燕芳、蒋小强董事职务，选举吴国平、吴春达为公司董事，其他董事、监事人员不变。

2014年7月3日，股份公司召开创立大会，选举刘桂芝、吴国平、吴春达、黄年亚、何云五人为股份公司第一届董事会董事。

（二）报告期内监事变动情况

2012年9月17日，有限公司召开股东会，免去吴国平监事职务，选举蒋小强为公司监事，其他董事、监事人员不变。

2014年7月3日，股份公司召开创立大会，选举蒋小强、班福奎为股份公司第一届监事会非职工代表监事；同日，股份公司召开职工代表大会，选举张丽佳为股份公司第一届监事会职工代表监事。

（三）报告期内高级管理人员变动情况

2014年7月3日，股份公司召开第一届董事会作出决议，聘任吴国平为公司总经理，聘任刘检生为公司销售总监、吴春达为公司市场总监、黄年亚为公司运营总监，聘任何云为公司行政总监、财务总监、董事会秘书。

（四）报告期内核心技术人员变动情况

目前，公司核心技术人员由4人构成，分别为刘桂芝、吴国平、黄年亚和蒋小强，报告期内一直在公司任职，未发生变动。

截至本说明书签署之日，公司董事会、监事会成员、高级管理人员、核心技术人员情况具体如下：

分类	姓名	所任职务	性别	产生方式
董事	刘桂芝	董事长	男	选举
	吴国平	董事	男	选举
	吴春达	董事	男	选举
	黄年亚	董事	男	选举
	何云	董事	男	选举
监事	蒋小强	监事	男	选举
	班福奎	监事	男	选举
	张丽佳	职工代表监事	女	选举
高级管理人员	吴国平	总经理	男	聘任
	吴春达	市场总监	男	聘任
	黄年亚	运营总监	男	聘任
	何云	董事会秘书、财务负责人、行政总监	男	聘任

	刘检生	销售总监	男	聘任
核心技术人员	刘桂芝	核心技术人员	男	-
	吴国平	核心技术人员	男	-
	黄年亚	核心技术人员	男	-
	蒋小强	核心技术人员	男	-

公司的董事、监事、高级管理人员报告期内发生变化主要是由于相关股东退出公司或股份公司设立后根据《公司法》的规定和公司实际需要增加董事、监事及高级管理人员引起的。上述董事、监事、高级管理人员的变化对公司的持续经营不会产生重大不利影响。

第四节 公司财务

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了公司最近两年一期经审计的财务报表及有关附注的重要内容，引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报表。

一、审计意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，对本公司报告期会计报表进行了审计，并出具致同审字（2014）第 310ZB226 号标准无保留意见的审计报告，认为：南麟电子财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南麟电子 2014 年 4 月 30 日、2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年 1-4 月、2013 年度和 2012 年度的经营成果和现金流量。

二、最近二年及一期财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项 目	2014 年 4 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产			
货币资金	10,953,507.43	13,804,254.00	7,962,406.55
交易性金融资产			
应收票据	1,003,800.00	1,900,000.00	742,658.50
应收账款	9,970,230.59	10,249,457.08	10,588,592.26
预付款项	2,888,282.02	3,635,680.77	3,479,673.90
应收利息			
应收股利			
其他应收款	269,367.49	498,801.40	566,037.34

存货	23,063,788.52	21,604,044.02	13,784,826.21
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,466,899.80	4,052,332.77	8,146,852.66
流动资产合计	52,615,875.85	55,744,570.04	45,271,047.42
非流动资产			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	20,330,625.75	21,633,424.66	5,601,958.99
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生物性生物资产			
油气资产			
无形资产	189,060.18	212,144.42	280,919.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	177,569.68	207,164.63	
递延所得税资产	1,457,569.40	1,687,233.74	1,344,751.10
其他非流动资产			
非流动资产合计	22,154,825.01	23,739,967.45	7,227,629.43
资产总计	74,770,700.86	79,484,537.49	52,498,676.85

合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债			
短期借款	5,000,000.00	4,000,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	15,580,080.27	20,205,446.14	
应付账款	7,496,923.81	10,274,454.04	3,846,286.94
预收款项	467,675.47	93,235.49	345,139.93
应付职工薪酬	556,305.78	861,628.12	695,809.18
应交税费	1,621,899.98	1,883,120.51	724,163.66
应付利息	10,075.00		
应付股利			
其他应付款	6,738,670.65	5,175,027.69	881,818.22
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	37,471,630.96	42,492,911.99	21,493,217.93
非流动负债			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	37,471,630.96	42,492,911.99	21,493,217.93
所有者权益(或股东权益)			

实收资本(或股本)	11,260,000.00	11,260,000.00	11,260,000.00
资本公积	232,166.67	232,166.67	124,935.80
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	3,076,872.13	3,076,872.13	3,076,872.13
未分配利润	21,324,108.03	21,021,748.25	16,188,098.25
外币报表折算差额	-346,392.58	-384,110.89	-275,199.99
归属于母公司所有者权益合计	35,546,754.25	35,206,676.16	30,374,706.19
少数股东权益	1,752,315.65	1,784,949.34	630,752.73
所有者权益合计	37,299,069.90	36,991,625.50	31,005,458.92
负债及所有者权益合计	74,770,700.86	79,484,537.49	52,498,676.85

(二) 合并利润表

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
一、营业收入	11,977,404.88	56,453,532.94	52,867,427.48
减:营业成本	6,580,272.52	33,345,874.54	34,844,319.32
营业税金及附加	31,617.91	133,838.50	259,235.19
销售费用	464,123.90	2,232,755.80	2,824,998.65
管理费用	4,117,390.42	16,447,132.28	11,503,362.13
财务费用	106,669.69	408,656.56	573,969.24
资产减值损失	61,665.51	355,127.61	1,771,925.40
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益			-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	615,664.93	3,530,147.65	1,089,617.55

加：营业外收入		1,348,052.42	1,322,353.93
减：营业外支出	1,099.30	123,662.69	144,801.46
其中：非流动资产处置损失	1,099.30	396,374.38	7,369.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	614,565.63	4,754,537.38	2,267,170.02
减：所得税费用	344,839.54	-340,540.10	-191,176.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	269,726.09	5,095,077.48	2,458,346.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润	302,359.78	4,833,650.00	2,222,566.82
少数股东损益	-32,633.69	261,427.48	235,779.94
六、每股收益			
（一）基本每股收益	0.03	0.43	0.20
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益	37,718.31	-108,910.90	-274,148.53
八、综合收益总额	307,444.40	4,986,166.58	2,184,198.23
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

（三）合并现金流量表

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	20,633,541.18	63,563,830.73	59,949,168.33
收到的税费返还	195,834.36	1,096,467.61	1,130,605.99
收到的其他与经营活动有关的现金	105,564.31	1,487,239.20	487,562.79
经营活动现金流入小计	20,934,939.85	66,147,537.55	61,567,337.11
购买商品、接受劳务支付的现金	18,411,294.82	20,890,608.91	39,902,421.93
支付给职工以及为职工支付的现金	2,938,801.50	9,202,844.73	5,655,123.09
支付的各项税费	505,169.44	2,079,140.74	1,937,901.91

支付的其他与经营活动有关的现金	1,485,990.28	14,859,692.74	18,190,633.17
经营活动现金流出小计	23,341,256.04	47,032,287.12	65,686,080.10
经营活动产生的现金流量净额	-2,406,316.19	19,115,250.43	-4,118,742.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		7,500,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	599.99	1,582,396.67	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	599.99	9,082,396.67	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,287,969.66	15,575,824.59	353,231.32
投资支付的现金			8,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	1,287,969.66	15,575,824.59	8,753,231.32
投资活动产生的现金流量净额	-1,287,369.67	-6,493,427.92	-8,753,231.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
取得借款收到的现金	1,000,000.00	4,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	1,924,252.80		-
筹资活动现金流入小计	2,924,252.80	9,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,237.52	645,620.24	2,996,361.11
其中：子公司支付给少数股东的现金股利			
支付其他与筹资活动有关的现金		10,604,998.62	
其中：子公司减资支付给少数股东的现金			
筹资活动现金流出小计	96,237.52	26,250,618.86	2,996,361.11
筹资活动产生的现金流量净额	2,828,015.28	-17,250,618.86	12,003,638.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60,823.19	-134,354.82	-663,539.42
五、现金及现金等价物净增加额	-926,493.77	-4,763,151.17	-1,531,874.84
加：期初现金及现金等价物余额	3,199,255.38	7,962,406.55	9,494,281.39
六、期末现金及现金等价物余额	2,272,761.61	3,199,255.38	7,962,406.55

(四) 合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2014年1-4月								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	11,260,000.00	232,166.67			3,076,872.13	21,021,748.25	-384,110.89	1,784,949.34	36,991,625.50
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	11,260,000.00	232,166.67			3,076,872.13	21,021,748.25	-384,110.89	1,784,949.34	36,991,625.50
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						302,359.78	37,718.31	-32,633.69	307,444.40
（一）净利润						302,359.78		-32,633.69	269,726.09
（二）其他综合收益							37,718.31		37,718.31
上述（一）和（二）小计						302,359.78	37,718.31	-32,633.69	307,444.40
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									

2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者（或股东）的分配									
3. 其他									
(五) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用（以负号填列）									
(七) 其他									
四、本年年末余额	11,260,000.00	232,166.67			3,076,872.13	21,324,108.03	-346,392.58	1,752,315.65	37,299,069.90

合并所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2013 年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	11,260,000.00	124,935.80			3,076,872.13	16,188,098.25	-275,199.99	630,752.73	31,005,458.92
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	11,260,000.00	124,935.80			3,076,872.13	16,188,098.25	-275,199.99	630,752.73	31,005,458.92
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		107,230.87				4,833,650.00	-108,910.90	1,154,196.61	5,986,166.58
（一）净利润						4,833,650.00		261,427.48	5,095,077.48
（二）其他综合收益							-108,910.90		-108,910.90
上述（一）和（二）小计						4,833,650.00	-108,910.90	261,427.48	4,986,166.58
（三）所有者投入和减少资本		107,230.87						892,769.13	1,000,000.00
1. 所有者投入资本								1,000,000.00	1,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他		107,230.87						-107,230.87	
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者（或股东）的分配									

3. 其他									
(五) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用(以负号填列)									
(七) 其他									
四、本年年末余额	11,260,000.00	232,166.67			3,076,872.13	21,021,748.25	-384,110.89	1,784,949.34	36,991,625.50

合并所有者权益变动表(续)

单位: 元

项目	2012 年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	11,260,000.00	500,000.00			2,942,644.44	16,951,759.12	-1,051.46	919,908.59	32,573,260.69

加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年年初余额	11,260,000.00	500,000.00			2,942,644.44	16,951,759.12	-1,051.46	919,908.59	32,573,260.69
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-375,064.20			134,227.69	-763,660.87	-274,148.53	-289,155.86	-1,567,801.77
（一）净利润						2,222,566.82		235,779.94	2,458,346.76
（二）其他综合收益							-274,148.53		-274,148.53
上述（一）和（二）小计						2,222,566.82	-274,148.53	235,779.94	2,184,198.23
（三）所有者投入和减少资本		-375,064.20						-524,935.80	-900,000.00
1. 所有者投入资本									-
2. 股份支付计入股东权益的金额									-
3. 其他		-375,064.20						-524,935.80	-900,000.00
（四）利润分配					134,227.69	-2,986,227.69			-2,852,000.00
1. 提取盈余公积					134,227.69	-134,227.69			
2. 对所有者（或股东）的分配						-2,852,000.00			-2,852,000.00
3. 其他									
（五）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									

4. 其他									-
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用 (以负号填列)									
(七) 其他									
四、本年年末余额	11,260,000.00	124,935.80	-	-	3,076,872.13	16,188,098.25	-275,199.99	630,752.73	31,005,458.92

(五) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产			
货币资金	9,613,413.50	11,609,061.76	3,883,184.73
交易性金融资产			
应收票据	3,800.00	900,000.00	192,658.50
应收账款	9,180,964.71	8,397,995.23	8,924,790.44
预付款项	1,774,128.68	683,863.29	5,600,810.26
应收利息			
应收股利			
其他应收款	10,635,923.91	11,601,468.79	256,001.00
存货	14,888,933.56	15,143,207.55	7,369,051.80
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	205,235.45		7,500,000.00
流动资产合计	46,302,399.81	48,335,596.62	33,726,496.73
非流动资产			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	22,018,400.00	22,018,400.00	8,018,400.00
投资性房地产			
固定资产	1,274,397.35	1,714,014.55	5,057,790.09
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生物性生物资产			

油气资产			
无形资产	188,417.44	211,392.28	279,839.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	481,779.25	899,618.36	1,138,406.70
其他非流动资产			
非流动资产合计	23,962,994.04	24,843,425.19	14,494,435.79
资产总计	70,265,393.85	73,179,021.81	48,220,932.52

母公司资产负债表（续）

单位：元

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债			
短期借款	5,000,000.00	4,000,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	17,361,475.88	20,983,853.31	
应付账款	8,040,183.08	12,045,533.74	986,720.66
预收款项	45,825.00	22,090.00	
应付职工薪酬	207,301.42	233,674.02	218,650.70
应交税费	42,292.02	328,028.11	626,831.83
应付利息	10,075.00		
应付股利			
其他应付款	6,690,590.61	5,118,753.50	863,090.57
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	37,397,743.01	42,731,932.68	17,695,293.76
			-

非流动负债			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	37,397,743.01	42,731,932.68	17,695,293.76
所有者权益(或股东权益)			
实收资本(或股本)	11,260,000.00	11,260,000.00	11,260,000.00
资本公积	500,000.00	500,000.00	500,000.00
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	3,076,872.13	3,076,872.13	3,076,872.13
未分配利润	18,030,778.71	15,610,217.00	15,688,766.63
所有者权益合计	32,867,650.84	30,447,089.13	30,525,638.76
负债及所有者权益合计	70,265,393.85	73,179,021.81	48,220,932.52

(六) 母公司利润表

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
一、营业收入	12,339,074.36	52,691,109.29	47,844,950.29
减:营业成本	8,698,829.28	46,435,190.96	38,274,083.00

营业税金及附加		60,466.80	117,103.97
销售费用	56,218.32	560,411.48	1,152,549.16
管理费用	1,907,745.38	6,699,193.24	5,904,486.09
财务费用	41,843.38	482,102.01	566,943.16
资产减值损失	-622.19	374,703.40	1,733,027.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,635,060.19	-1,920,958.60	96,757.71
加：营业外收入	1,203,340.63	2,594,595.69	1,243,191.21
减：营业外支出		513,398.38	7,369.56
其中：非流动资产处置损失		396,374.38	7,369.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,838,400.82	160,238.71	1,332,579.36
减：所得税费用	417,839.11	238,788.34	-9,697.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,420,561.71	-78,549.63	1,342,276.94
五、每股收益			
（一）基本每股收益	0.21	-0.01	0.12
（二）稀释每股收益	-	-	-
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	2,420,561.71	-78,549.63	1,342,276.94

（七）母公司现金流量表

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	14,207,538.86	60,486,104.69	50,468,972.63
收到的税费返还	195,834.36	900,236.66	1,130,605.99
收到其他与经营活动有关的现金	1,070,592.82	419,420.59	402,048.11

经营活动现金流入小计	15,473,966.04	61,805,761.94	52,001,626.73
购买商品、接受劳务支付的现金	17,292,700.86	25,432,201.15	43,220,248.47
支付给职工以及为职工支付的现金	933,704.85	3,536,179.40	3,460,745.94
支付的各项税费	178,538.63	1,373,003.36	1,236,348.63
支付其他与经营活动有关的现金	503,484.46	4,248,561.40	13,954,781.28
经营活动现金流出小计	18,908,428.80	34,589,945.31	61,872,124.32
经营活动产生的现金流量净额	-3,434,462.76	27,215,816.63	-9,870,497.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,500,000.00	5,277,600.00
取得投资收益收到的现金	-	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	572,137.95	1,851,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	572,137.95	9,351,000.00	5,277,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,092,107.00	328,654.68
投资支付的现金		10,000,000.00	8,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	-	17,092,107.00	8,728,654.68
投资活动产生的现金流量净额	572,137.95	-7,741,107.00	-3,451,054.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	1,000,000.00	4,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	1,924,252.80		

筹资活动现金流入小计	2,924,252.80	4,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,237.52	645,620.24	2,996,361.11
支付其他与筹资活动有关的现金		10,604,998.62	
筹资活动现金流出小计	96,237.52	26,250,618.86	2,996,361.11
筹资活动产生的现金流量净额	2,828,015.28	-22,250,618.86	12,003,638.89
四、汇率变动对现金的影响	-37,085.93	-103,212.36	-385,072.22
五、现金及现金等价物净增加额	-71,395.46	-2,879,121.59	-1,702,985.60
加：期初现金及现金等价物的余额	1,004,063.14	3,883,184.73	5,586,170.33
六、期末现金及现金等价物余额	932,667.68	1,004,063.14	3,883,184.73

(八) 母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2014年1-4月							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	11,260,000.00	500,000.00			3,076,872.13	15,610,217.00		30,447,089.13
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	11,260,000.00	500,000.00			3,076,872.13	15,610,217.00		30,447,089.13
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						2,420,561.71		2,420,561.71
（一）净利润						2,420,561.71		2,420,561.71
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						2,420,561.71		2,420,561.71
（三）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者(或股东)的分配								
3. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备提取和使用								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本年年末余额	11,260,000.00	500,000.00			3,076,872.13	18,030,778.71		32,867,650.84

合并所有者权益变动表(续)

单位：元

项目	2013 年度							
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计

一、上年年末余额	11,260,000.00	500,000.00			3,076,872.13	15,688,766.63		30,525,638.76
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	11,260,000.00	500,000.00			3,076,872.13	15,688,766.63		30,525,638.76
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						-78,549.63		-78,549.63
（一）净利润						-78,549.63		-78,549.63
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						-78,549.63		-78,549.63
（三）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者（或股东）的分配								
3. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备提取和使用							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本年年末余额	11,260,000.00	500,000.00			3,076,872.13	15,610,217.00	30,447,089.13

合并所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2012 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	11,260,000.00	500,000.00			2,942,644.44	17,332,717.38		32,035,361.82
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	11,260,000.00	500,000.00			2,942,644.44	17,332,717.38		32,035,361.82
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					134,227.69	-1,643,950.75		-1,509,723.06
（一）净利润						1,342,276.94		1,342,276.94

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计						1,342,276.94		1,342,276.94
(三) 股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					134,227.69	-2,986,227.69		-2,852,000.00
1. 提取盈余公积					134,227.69	-134,227.69		
2. 对所有者(或股东)的分配						-2,852,000.00		-2,852,000.00
3. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备提取和使用								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本年年末余额	11,260,000.00	500,000.00			3,076,872.13	15,688,766.63		30,525,638.76

三、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并按照证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号-新旧会计准则过渡期间比较会计信息的编制及披露的规定》，以及《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》中有关追溯调整的相关规定按照以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

四、合并财务报表范围及变化情况

（一）纳入合并财务报表范围的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	实收资本	持股比例	表决权比例
无锡矽林威电子有限公司	有限公司	无锡	电路设计	800 万元	800 万元	96.25%	96.25%
深圳市善点微电子有限公司	有限公司	深圳	集成电路销售	200 万元	200 万元	90%	90%
无锡麟力科技有限公司	有限公司	无锡	电路设计	1,000 万元	1,000 万元	90%	90%
矽林（香港）电子有限公司	有限公司	香港	集成电路销售	1 万港元	1 万港元	100%	100%

（二）合并财务报表范围变化情况

报告期公司除通过投资设立无锡麟力科技有限公司外，合并财务报表范围未发生变化。

五、主要会计政策和会计估计

（一）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

（二）合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

（三）金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

2、金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

3、金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

4、金融工具的公允价值

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

5、金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;

④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组;

⑤因发行方发生重大财务困难,导致金融资产无法在活跃市场继续交易;

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,包括:

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化;

- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况;

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值,则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值,按照该金融资产原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

6、金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产

生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（四）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元(含 100 万元)以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

2、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

3、按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
关联方应收款项	资产类型	不计提
员工借款、备用金、保证金等	资产类型	不计提

①对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	5	5

1-2 年	20	20
2-3 年	50	50
3 年以上	100	100

②对其他组合，采用其他方法计提坏账准备的说明如下：

组合名称	计提方法说明
关联方应收款项	根据资产性质和历史损失率不计提坏账准备
员工借款、备用金、保证金等	根据资产性质和历史损失率不计提坏账准备

（五）存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、半成品、低值易耗品、库存商品、发出商品及委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品及委托加工物资等发出时采用移动加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

（六）长期股权投资

1、投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见“五、主要会计政策和会计估计（十四）”。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见“五、主要会计政策和会计估计（三）5”。

（七）固定资产

1、固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

2、各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	10	4	9.60
电子设备	3-5	4	19.20-32.00
运输设备	4-8	4	12.00-24.00
工具器具	5	4	19.20
办公设备	5	4	19.20

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见“五、主要会计政策和会计估计（十四）”。

4、每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

5、大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

（八）无形资产

本公司无形资产包括软件。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的

经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
软件	5-8年	直线法	无

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日，预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见“五、主要会计政策和会计估计（十四）”。

（九）研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

（十）长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

（十一）收入

1、销售产品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

经销和直销的收入确认方法相同，发货后等对方验收合格确认后，每月末核对验收确认单后确认收入并开具发票。

2、提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

3、让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量

时，本公司确认收入。

（十二）政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（十三）递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(十四) 资产减值

本公司对子公司的长期股权投资、固定资产、无形资产、长期待摊费用等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹

象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

六、经营成果和财务状况分析

（一）营业收入及经营成果变动分析

1、营业收入构成及变动分析

单位：元

项目	2014年1-4月		2013年度		2012年度	
	收入金额	占比	收入金额	占比	收入金额	占比

主营业务收入	11,977,404.88	100.00%	56,453,532.94	100.00%	52,867,427.48	100.00%
合计	11,977,404.88	100.00%	56,453,532.94	100.00%	52,867,427.48	100.00%

报告期公司营业收入全部来自主营业务收入，主营业务突出。

2、主营业务收入构成及变动分析

(1) 按产品及服务分类

单位：元

产品	2014年1-4月		2013年度		2012年度	
	收入金额	占比	收入金额	占比	收入金额	占比
集成电路产品	11,414,206.78	95.30%	54,652,552.80	96.81%	50,913,395.56	96.30%
功率晶体管产品	563,198.10	4.70%	1,800,980.14	3.19%	1,954,031.92	3.70%
合计	11,977,404.88	100.00%	56,453,532.94	100.00%	52,867,427.48	100.00%

报告期公司主营业务收入主要来源于集成电路产品，2012年、2013年、2014年1-4月集成电路产品实现收入分别为50,913,395.56元、54,652,552.80元、11,414,206.78元，集成电路产品收入占主营业务收入的比重分别为96.30%、96.81%、95.30%。报告期公司集成电路产品2013年较2012年增长7.34%，2014年1-4月，受国家宏观经济不景气及国内外知名品牌的挤压，公司下游的中小手机、平板电脑客户采购量减少，营业收入有所下降。

功率晶体管主要应用在高电压大电流的场合，其基本功能类似电子开关，相关的集成电路作为控制器对于其开关动作进行控制，门槛相对较低，技术上已经成熟，在研发、设计环节已无太大盈利提升空间，故公司仅将其作为集成电路的配套产品。2013年上半年，随着功率晶体管产品市场价格的下降，公司功率晶体管产品业务进行收缩。2013年下半年，随着公司封装、测试生产线逐步运行，公司封装集成电路产品的同时，利用少量产能封装晶体管产品，公司同过制造环节大幅提升晶体管产品的盈利空间，公司2014年功率晶体管产品销售额将有所回升。

(2) 按地域分类

单位：元

地域	2014年1-4月		2013年度		2012年度	
	收入金额	占比	收入金额	占比	收入金额	占比
国内销售	10,891,770.60	90.94%	49,200,271.81	87.15%	43,903,157.53	83.04%
国外销售	1,085,634.28	9.06%	7,253,261.13	12.85%	8,964,269.95	16.96%
合计	11,977,404.88	100.00%	56,453,532.94	100.00%	52,867,427.48	100.00%

报告期公司主营业务以内销为主，2012年、2013年、2014年1-4月内销收入占主营业务收入的比重分别为83.04%、87.15%、90.94%。报告期公司外销受国际经济不景气等影响，营业收入有所下滑。2012年、2013年、2014年1-4月外销收入占主营业务收入的比重分别为16.96%、12.85%、9.06%，逐年下降。

3、主营业务毛利率分析

(1) 按产品及服务分类

单位：元

2014年1-4月			
产品	收入	成本	毛利率
集成电路	11,414,206.78	6,257,627.66	45.18%
功率晶体管产品	563,198.10	322,644.86	42.71%
合计	11,977,404.88	6,580,272.52	45.06%
2013年度			
产品	收入	成本	毛利率
集成电路	54,652,552.80	32,114,524.05	41.24%
功率晶体管产品	1,800,980.14	1,231,350.49	31.63%
合计	56,453,532.94	33,345,874.54	40.93%
2012年度			
产品	收入	成本	毛利率
集成电路	50,913,395.56	33,407,550.36	34.38%
功率晶体管产品	1,954,031.92	1,436,768.96	26.47%

合计	52,867,427.48	34,844,319.32	34.09%
----	---------------	---------------	--------

报告期公司销售单价及成本单价情况如下：

单位：元

2014年1-4月					
产品	销售数量 (千颗)	销售单价 (元/千颗)	营业收入	成本单价 (元/千颗)	营业成本
集成电路	52,614.24	216.94	11,414,206.78	118.93	6,257,627.66
功率晶体管产品	3,030.20	185.86	563,198.10	106.48	322,644.86
合计	55,644.44	215.25	11,977,404.88	118.26	6,580,272.52
2013年度					
产品	销售数量 (千颗)	销售单价 (元/千颗)	营业收入	成本单价 (元/千颗)	营业成本
集成电路	237,835.34	229.79	54,652,552.80	135.03	32,114,524.05
功率晶体管产品	9,466.76	190.24	1,800,980.14	130.07	1,231,350.49
合计	247,302.10	228.28	56,453,532.94	134.84	33,345,874.54
2012年度					
产品	销售数量 (千颗)	销售单价 (元/千颗)	营业收入	成本单价 (元/千颗)	营业成本
集成电路	202,949.89	250.87	50,913,395.56	164.61	33,407,550.36
功率晶体管产品	9,189.40	212.64	1,954,031.92	156.35	1,436,768.96
合计	212,139.29	249.21	52,867,427.48	164.25	34,844,319.32

报告期公司主营业务毛利率分别为 34.09%、40.93%、45.06%，逐年稳步上升。集成电路行业主要业务环节包括设计、晶圆制造、封装测试环节，中封装测试系最主要的成本构成之一，而封装测试环节重要成本系内引线。报告期行业封装内引线由金线逐步过渡到铜线，行业封装成本大幅下降，导致行业产品售价、成本均大幅下降。受此因素影响，报告期公司 2013 年集成电路产品平均售价较 2012 年下降 8.40%，2014 年 1-4 月集成电路产品平均售价较 2013 年下降 5.59%。

公司 2012 年主要系致力于设计领域，晶圆制造及封装测试主要系委外加工。

2013 年公司开始向产业链下游衍生，购入封装测试生产线，并 2013 年 6 月开始逐步投产，并逐步减少委外加工比例，公司 2013 年、2014 年 1-4 月自主封装比例分别达到 8.56%、48.28%，公司成本进一步下降。报告期 2013 年公司产品平均成本单价较 2012 年下降 17.97%，2014 年 1-4 月产品平均成本单价较 2013 年下降 11.92%。

同时公司与报告期第二大供应商无锡华润上华科技有限公司、第三大供应商无锡华润上华半导体有限公司的晶圆采购结算价格在 2013 年 10 月有所下调，对使公司 2013 年及 2014 年 1-4 月成本进一步下降。

功率晶体管主要应用在高电压大电流的场合，其基本功能类似电子开关，相关的集成电路作为控制器对于其开关动作进行控制，门槛相对较低，技术上已经成熟，在研发、设计环节已无太大盈利提升空间，故公司仅将其作为集成电路的配套产品。2013 年上半年，封装内引线由金线逐步过渡到铜线，行业封装成本大幅下降，功率晶体管产品市场价格的大幅下降，公司功率晶体管产品业务进行收缩。2013 年下半年，随着公司封装、测试生产线逐步运行，公司封装集成电路产品的同时，利用少量产能封装晶体管产品，公司同过制造环节大幅提升晶体管产品的盈利空间，公司晶体管产品毛利率逐步上升。

报告期公司与同行业毛利情况如下

产品	2013 年度		2012 年度	
	公司	芯朋微	公司	芯朋微
集成电路	41.24%	33.73%	34.38%	33.43%
功率晶体管产品	31.63%	16.74%	26.47%	17.83%
合计	40.93%	33.60%	34.09%	32.90%

芯朋微报告期主营业务系集成电路设计与销售，中间生产环节系委托加工，公司 2012 年主营业务与芯朋微类似，毛利率也较为接近。但 2013 年公司向产业链下游衍生，购入封装测试生产线，逐步减少委外封装测试后，公司毛利率逐步上升，2013 年公司毛利率为 40.93%，高于芯朋微。

(2) 按地域分类

单位：元

2014年1-4月			
地区	收入	成本	毛利率
国内销售	10,891,770.60	6,005,986.22	44.86%
国外销售	1,085,634.28	574,286.30	47.10%
合计	11,977,404.88	6,580,272.52	45.06%
2013年度			
地区	收入	成本	毛利率
国内销售	49,200,271.81	29,132,888.97	40.79%
国外销售	7,253,261.13	4,212,985.57	41.92%
合计	56,453,532.94	33,345,874.54	40.93%
2012年度			
地区	收入	成本	毛利率
国内销售	43,903,157.53	29,525,520.60	32.75%
国外销售	8,964,269.95	5,318,798.72	40.67%
合计	52,867,427.48	34,844,319.32	34.09%

报告期公司集成电路产品、晶体管产品，毛利率有一定差别，报告期公司各地区之间的主营业务毛利率差异主要系因产品结构不同导致。公司2012年外销毛利率高于内销，主要系因公司子公司香港（矽林）2012年销售部分产品系以未封装的形式销售，公司定价时相对较高。

4、报告期公司营业收入及净利润的变动趋势及原因

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
营业收入	11,977,404.88	56,453,532.94	52,867,427.48
营业成本	6,580,272.52	33,345,874.54	34,844,319.32
营业利润	615,664.93	3,530,147.65	1,089,617.55
利润总额	614,565.63	4,754,537.38	2,267,170.02

净利润	269,726.09	5,095,077.48	2,458,346.76
归属于母公司股东净利润	302,359.78	4,833,650.00	2,222,566.82

公司 2013 年营业收入较 2012 年稳步增长 6.78%，同时随着 2013 年 6 月公司封装测试生产线的投产，毛利率逐步上升。公司 2013 年研发投入逐步加大，管理费用较上年增长 42.98%，但随着毛利额的大幅提升，公司 2013 年营业利润较 2012 年增长 223.98%。公司 2012 年、2013 年营业外收入分别为 1,322,353.93 元、1,348,052.42 元。

公司 2014 年 1-4 月因受国家宏观经济不景气及国内外知名品牌的挤压，公司下游的中小手机、平板电脑客户采购量减少，营业收入较 2013 年 1-4 月同比下降 25.93%，仅相当于 2013 年营业收入的 21.22%。虽然随着公司自主封装比例的提升，毛利率进一步上升，但在公司营业收入下降和研发持续投入的情况下，营业利润及净利润有所下滑。

公司营业收入及净利润波动无明显季节性。

（二）报告期内的期间费用情况

单位：元

项目	2014 年 1-4 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	464,123.90	3.87%	2,232,755.80	3.96%	2,824,998.65	5.34%
管理费用	4,117,390.42	34.38%	16,447,132.28	29.13%	11,503,362.13	21.76%
其中：研发费用	2,495,277.51	20.83%	9,749,493.81	17.27%	4,898,330.90	9.27%
财务费用	106,669.69	0.89%	408,656.56	0.72%	573,969.24	1.09%
合计	4,688,184.01	39.14%	19,088,544.64	33.81%	14,902,330.02	28.19%

（1）报告期销售费用明细如下：

项目	2014 年 1-4 月	2013 年度	2012 年度
房租及物业费	199,219.92	692,902.98	727,192.48
工资及福利	52,863.00	601,768.30	713,221.64

招待费	39,282.00	100,219.00	92,249.30
广告及业务宣传费		3,000.00	105,450.00
差旅费及通讯费	49,487.27	241,739.53	357,723.48
运输费及汽耗费	105,840.73	361,369.80	303,370.57
折旧费	142.86	42,392.68	58,002.12
办公费		97,294.81	373,087.01
其他	17,288.12	92,068.70	94,702.05
合计	464,123.90	2,232,755.80	2,824,998.65

公司销售费用主要包括工资及福利、物业租赁费、差旅费、办公费等，公司2013年销售费用较2012年减少20.96%，占营业收入的比重由5.34%下降到3.96%，主要系因公司启用视频会议系统后，差旅费及办公费大幅下降。其中2013年差旅费较2012年下降115,983.95元，下降比例32.42%；2013年办公费较2012年下降275,792.20元，下降比例73.92%。

(2) 报告期管理费用明细如下：

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
研发费	2,495,277.51	9,749,493.81	4,898,330.90
工资及福利	962,452.02	3,705,550.37	4,622,677.42
折旧及摊销	206,096.43	577,684.89	658,956.06
房租及物业费	89,896.00	267,624.00	261,624.00
业务招待费	46,183.30	137,704.58	143,122.46
办公费	160,314.87	817,322.66	320,087.96
交通费	51,431.82	422,271.63	144,714.59
咨询费	14,609.04	272,846.98	51,234.57
其他	91,129.43	496,633.36	402,614.17
合计	4,117,390.42	16,447,132.28	11,503,362.13

公司管理费用主要包括研发费用、工资及福利、差旅费、办公费等，公司2013年管理费用较2012年增加42.98%，占营业收入的比重由21.76%上升到29.13%，主要系当年研发项目数量增加、部分项目技术难度大、工艺先进等造成

研发投入大幅增加。公司 2013 年研发费用较 2012 年增长 4,851,162.91 元，增长比例 99.04%。同时随着公司子公司无锡麟力开始运营及封装测试生产线的投产，公司 2013 年办公费较 2012 年增长 497,234.70 元，增长比例 155.34%。

公司同行业公司 2012 年、2013 年管理费用对比情况如下：

项目	2013 年度		2012 年度	
	金额	占比	金额	占比
本公司	16,447,132.28	29.13%	11,503,362.13	21.76%
其中：研发费用	9,749,493.81	17.27%	4,898,330.90	9.27%
芯朋微（430512）	33,783,431.98	21.34%	33,357,798.11	25.54%
其中：研发费用	26,116,928.90	16.50%	26,379,875.39	20.20%

公司所处的集成电路设计行业在国内尚属于成长中的新兴产业，技术创新及终端电子产品日新月异，各类技术更新换代很快，因此 IC 设计公司所需投入于新产品开发的研发费用金额较大。

公司同行业企业芯朋微 2012 年、2013 年管理费用分别为 3,335.78 万元、3,378.34 万元，其中主要系研发费用，金额较大。2013 年因营业收入增长较快，管理费用及研发费用占营业收入的比重有所下降。

(3) 报告期财务费用情况如下：

报告期公司利息支出主要系银行借款利息支出，利息收入主要系承兑保证金利息收入。公司 2012 年下半年银行借款余额开始上升，2013 年转为承兑汇票方式为主向银行融资，借款余额有所下降。公司 2013 年利息支出、利息收入均较 2012 年大幅增加。

(三) 重大投资收益

报告期公司无重大投资收益。

(四) 非经常性损益情况

1、明细情况

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
非流动性资产处置损益	-1,099.30	159,617.08	-8,245.06
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		1,185,988.10	440,105.75
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-121,215.45	745,691.78
非经常性损益合计	-1,099.30	1,224,389.73	1,177,552.47
减：所得税影响金额		25,126.32	163,980.32
扣除所得税影响后的非经常性损益	-1,099.30	1,199,263.41	1,013,572.15
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	-989.37	1,160,095.02	1,005,763.70
归属于少数股东的非经常性损益	-109.93	39,168.39	7,808.45

2、非经常性损益对当期净利润的影响

单位：元

项目	序号	2014年1-4月	2013年度	2012年度
净利润	①	269,726.09	5,095,077.48	2,458,346.76
归属于母公司股东净利润	②	302,359.78	4,833,650.00	2,222,566.82
非经常性损益	③	-1,099.30	1,199,263.41	1,013,572.15
归属于母公司股东的非经常性损益	④	-989.37	1,160,095.02	1,005,763.70
扣除非经常性损益后的净利润	⑤ = ① - ③	270,825.39	3,895,814.07	1,444,774.61
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润	⑥ = ② - ④	303,349.15	3,673,554.98	1,216,803.12
非经常性损益占净利润的比例	⑦ = ③ ÷ ①		23.54%	41.23%
归属于母公司股东的非经常性损益占归属于母公司股东净利润	⑧ = ④ ÷ ②		24.00%	45.25%

润的比例				
------	--	--	--	--

报告期公司非经常性损益分别为 101.36 万元、119.93 万元、-0.11 万元，其中 2012 年、2013 年非经常性损益占净利润的比例分别为 41.23%、23.54%，非经常性损益对公司净利润影响较大。

（五）适用的主要税种、税率及税收优惠政策

1、主要税种及税率

税种	计税基础	税率
增值税	应税收入	17%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、16.5%[注]、12.5%

注：子公司矽林（香港）按 16.5%的税率征收企业所得税。

2、税收优惠政策

本公司被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局认定为高新技术企业，认定证书编号：GF201131000351；本公司享受国家高新技术企业的优惠政策，自 2011 年 10 月 20 日至 2014 年 10 月 19 日按 15%的税率征收企业所得税。公司目前正在申报高新技术企业复审中。

子公司无锡矽林威电子有限公司于 2011 年被国家工业和信息化部认定为集成电路设计企业，从 2012 年度起享受“两免三减半”的企业所得税优惠政策，即 2012 年、2013 年免交企业所得税，2014 年至 2016 年按 12.5%的税率征收企业所得税。

公司已于 2014 年 8 月申请高新技术企业重新认定，并于 2014 年 10 月 23 日起作为 2014 上海市年第二批拟认定高新技术企业名单予以公示，预计公司享受的高新技术企业税收优惠在未来三年仍将具有一定稳定性。公司子公司无锡矽林威自 2012 年度起享受“两免三减半”的企业所得税优惠政策，2014 年及未来两年将按 12.5%的税率征收企业所得税。

公司子公司享受的税收优惠政策在未来一定期间内具有稳定性, 对公司财务状况和现金流量无重大不利影响。

(六) 主要资产情况

1、货币资金

2012 年末、2013 年末、2014 年 4 月末公司货币资金明细情况如下:

2014 年 4 月 30 日			
项目	外币金额	汇率	人民币金额
现金			1, 575. 35
其中: 人民币			1, 575. 35
银行存款			2, 271, 186. 26
其中: 人民币			1, 179, 961. 93
美元	52, 251. 88	6. 1569	321, 707. 51
港元	968, 798. 72	0. 7943	769, 516. 82
其他货币资金			8, 680, 745. 82
其中: 人民币			8, 680, 745. 82
合计			10, 953, 507. 43
2013 年 12 月 31 日			
项目	外币金额	汇率	人民币金额
现金			975. 35
其中: 人民币			975. 35
银行存款			3, 198, 280. 03
其中: 人民币			1, 972, 848. 31
美元	140, 482. 20	6. 0937	856, 056. 97
港元	469, 822. 88	0. 7862	369, 374. 75
其他货币资金			10, 604, 998. 62
其中: 人民币			10, 604, 998. 62
合计			13, 804, 254. 00

2012年12月31日			
项目	外币金额	汇率	人民币金额
现金			7,602.85
其中：人民币			7,602.85
银行存款			7,954,803.70
其中：人民币			6,078,931.64
美元	72,510.83	6.2837	455,636.30
港元	1,751,647.46	0.8108	1,420,235.76
其他货币资金			
其中：人民币			
合计			7,962,406.55

报告期公司其他货币资金大幅增长，主要系因公司2013年因与供应商的主要结算模式由现款结算转为银行承兑汇票结算，公司在银行的主要融资方式由借款转为承兑汇票，公司缴存的其他货币资金承兑保证金大幅增长。

2、应收票据

项目	2014年4月30日	2013年12月30日	2013年12月31日
银行承兑汇票	1,003,800.00	1,900,000.00	742,658.50
合计	1,003,800.00	1,900,000.00	742,658.50

(1) 期末公司无质押的应收票据。

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

① 期末无因出票人无力履约而转为应收账款的票据。

② 公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额1,710,255.63元，最大的前五名情况：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
硕颖数码科技(中国)有限公司	2014.01.16	2014.07.16	497,000.00	无

硕颖数码科技（中国）有限公司	2013. 11. 18	2014. 05. 18	313, 000. 00	无
硕颖数码科技（中国）有限公司	2013. 11. 18	2014. 05. 18	215, 000. 00	无
群升集团有限公司	2013. 11. 21	2014. 05. 21	110, 900. 00	无
深圳市喜瑞德电子有限公司	2014. 04. 14	2014. 10. 09	103, 800. 00	无
合 计			1, 239, 700. 00	

3、应收账款

2012 年末、2013 年末、2014 年 4 月末公司应收账款按账龄列示情况如下：

单位：元

2014 年 4 月 30 日				
项目	账面余额	占比	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	10, 584, 836. 17	100. 00%	614, 605. 58	5. 82%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	10, 584, 836. 17	100. 00%	614, 605. 58	5. 82%
净额	9, 970, 230. 59			
2013 年 12 月 31 日				
项目	账面余额	占比	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	10, 878, 739. 97	100. 00%	629, 282. 89	5. 80%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	10, 878, 739. 97	100. 00%	629, 282. 89	5. 80%
净额	10, 249, 457. 08			
2012 年 12 月 31 日				

项目	账面余额	占比	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	11,230,468.52	100.00%	641,876.26	5.72%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	11,230,468.52	100.00%	641,876.26	5.72%
净额	10,588,592.26			

按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

2014年4月30日				
项目	账面余额	占比	坏账准备	坏账准备比例
1年以内	10,457,872.69	98.80%	521,556.88	5.00%
1至2年	42,393.48	0.40%	8,478.70	20.00%
2至3年				50.00%
3年以上	84,570.00	0.80%	84,570.00	100.00%
合计	10,584,836.17	100.00%	614,605.58	5.82%
2013年12月31日				
项目	账面余额	占比	坏账准备	坏账准备比例
1年以内	10,751,895.66	98.83%	536,258.03	5.00%
1至2年	42,274.31	0.39%	8,454.86	20.00%
2至3年				
3年以上	84,570.00	0.78%	84,570.00	100.00%
合计	10,878,739.97	100.00%	629,282.89	5.80%
2012年12月31日				
项目	账面余额	占比	坏账准备	坏账准备比例
1年以内	11,145,822.94	99.246%	557,291.15	5.00%
1至2年	75.58	0.001%	15.12	20.00%

2014年4月30日				
项目	账面余额	占比	坏账准备	坏账准备比例
2至3年				
3年以上	84,570.00	0.753%	84,570.00	100.00%
合计	11,230,468.52	100.00%	641,876.26	5.72%

截至2014年4月末，公司应收账款前5名情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占应收账款 总额的比例	账龄	是否关 联方
深圳市汤诚科技有限公司	1,421,528.05	13.43%	1年以内	否
深圳市福光泰电子科技有限公司	735,615.00	6.95%	1年以内	否
硕颖数码科技(中国)有限公司	722,733.03	6.83%	1年以内	否
深圳新利泰电子有限公司	523,586.16	4.95%	1年以内	否
深圳市祺浩达电子有限公司	507,549.20	4.80%	1年以内	否
合计	3,911,011.44	36.96%		

截至2013年12月末，公司应收账款前5名情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占应收账款 总额的比例	账龄	是否关 联方
深圳市汤诚科技有限公司	1,746,477.45	16.05%	1年以内	否
香港立天捷运	1,224,711.54	11.26%	1年以内	否
硕颖数码科技(中国)有限公司	944,950.72	8.69%	1年以内	否
深圳市祺浩达电子有限公司	589,167.70	5.42%	1年以内	否
深圳市飙发科技有限公司	527,911.20	4.85%	1年以内	否
合计	5,033,218.61	46.27%		

截至2012年12月末，公司应收账款前5名情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占应收账款 总额的比例	账龄	是否关 联方
硕颖数码科技(中国)有限公司	1,035,278.35	9.22%	1年以内	否
深圳市友骏科技有限公司	959,321.14	8.54%	1年以内	否
深圳市汤诚科技有限公司	900,015.98	8.01%	1年以内	否
香港立天捷运	674,724.99	6.01%	1年以内	否
大亚科技股份有限公司	635,419.50	5.66%	1年以内	否
合 计	4,204,759.96	37.44%		

报告期公司营业收入略有增长，应收账款余额保持平稳，账龄主要系在1年以内，报告期无坏账核销情况。公司一般给予客户1至2个月信用期，部分长期合作客户可能会适当延长，报告期末应收账款余额较大客户均系保持长期合作客户，上述客户报告期回款正常，未出现坏账情况。公司销售以经销模式为主，客户主要系下游经销商，且客户数量较大，故应收账款余额户数较多。公司应收账款余额较大系公司业务特点决定。

4、预付账款

2012年末、2013年末、2014年4月末公司预付账款按账龄列示情况如下：

单位：元

项目	2014年4月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比
1年以内	2,884,328.02	99.86%	3,635,680.77	100.00%	3,479,673.90	100.00%
1至2年	3,954.00	0.14%				
合计	2,888,282.02	100.00%	3,635,680.77	100.00%	3,479,673.90	100.00%

2014年4月末，公司预付账款前5名情况如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	是否关联方
东莞朗诚微电子有限公司	1,056,000.00	1年以内	否

无锡华润上华科技有限公司	980,146.01	1年以内	否
北京集诚泰思特信息技术有限公司	210,000.00	1年以内	否
无锡华润上华半导体有限公司	93,795.90	1年以内	否
MIKO TECHNOLOGY CO.,LTD	80,145.27	1-2年	否
合计	2,420,087.18		否

2013年12月末，公司预付账款前5名情况如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	是否关联方
无锡华润上华科技有限公司	1,262,100.01	1年以内	否
江苏苏美达国际技术贸易有限公司	735,831.42	1年以内	否
无锡华润上华半导体有限公司	661,243.22	1年以内	否
东莞朗诚微电子设备有限公司	531,000.00	1年以内	否
MIKO TECHNOLOGY CO.,LTD	79,327.97	1年以内	否
合计	3,269,502.62		

2012年12月末，公司预付账款前5名情况如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	是否关联方
山田尖端科技（上海）有限公司	905,112.00	1年以内	否
无锡华润上华科技有限公司	700,000.01	1年以内	否
无锡华润上华半导体有限公司	678,573.80	1年以内	否
东莞朗诚微电子设备有限公司	528,000.00	1年以内	否
北京集诚泰思特信息技术有限公司	280,000.00	1年以内	
合计	3,091,685.81		

报告期公司预付款项主要系预付原材料款、设备采购款等。截至报告期末，预付东莞朗诚微电子设备有限公司系设备采购款，预付无锡华润上华科技有限公司、无锡华润上华半导体有限公司系晶圆采购款。

5、其他应收款

2012 年末、2013 年末、2014 年 4 月末公司其他应收款明细情况如下

2014 年 4 月 30 日				
项目	账面余额	占比	坏账准备	坏账准备比例
按组合计提坏账准备的其他应收款				
①保证金性质组合	269,367.49	100.00%		
小计	269,367.49	100.00%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	269,367.49	100.00%		
净额	269,367.49			
2013 年 12 月 31 日				
项目	账面余额	占比	坏账准备	坏账准备比例
按组合计提坏账准备的其他应收款				
①保证金性质组合	498,801.40	100.00%		
小计	498,801.40	100.00%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
净额	498,801.40			
2012 年 12 月 31 日				
项目	账面余额	占比	坏账准备	坏账准备比例
按组合计提坏账准备的其他应收款				
①保证金性质组合	566,037.34	100.00%		
小计	566,037.34	100.00%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	566,037.34	100.00%		
净额	566,037.34			

截至 2014 年 4 月末，公司其他应收款前 5 名情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	金额	账龄	是否关联方
付强	员工借款	115,000.00	1至2年	否
上海环绿实业有限公司	房租押金	43,604.00	1至2年	否
无锡国家集成电路设计基地有限公司	押金	37,380.00	3年以上	否
贺小祥	备用金	35,000.00	1至2年	否
游祥翠	备用金	17,500.00	1至2年	否
合计		248,484.00		

截至2013年12月末，公司其他应收款前5名情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	金额	账龄	是否关联方
上海市浦东区国税局	出口销售退税款	180,453.48	1年以内	否
付强	员工借款	100,000.00	1年以内	否
上海环绿实业有限公司	房租押金	43,604.00	1年以内	否
无锡国家集成电路设计基地有限公司	押金	37,380.00	3年以上	否
贺小祥	备用金	35,000.00	1年以内	否
合计		396,437.48		

截至2012年12月末，公司其他应收款前5名情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	金额	账龄	是否关联方
蒋小强	员工借款	96,000.00	1年以内	是
无锡国家集成电路设计基地有限公司	押金	74,760.00	2至3年	否
何云	备用金	72,000.00	1年以内	是
吴国平	备用金	60,000.00	1年以内	是
刘桂芝	备用金	60,000.00	1年以内	是

合计		362,760.00		
----	--	------------	--	--

公司其他应收款主要系备用金、员工暂借款、押金，报告期随着公司内部管理的逐步规范，上述款项的结算、归还及时性逐步加强，其他应收款余额逐步下降。

6、存货

2012年末、2013年末、2014年4月末公司存货明细情况如下：

单位：元

项目	2014年4月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	1,233,172.42		1,779,349.77		2,664,955.86	
低值易耗品	1,711,915.86		1,065,974.34		6,845.15	
委托加工物资	39,909.75		137,856.53		1,160,566.84	
在产品	2,508,306.52		2,914,836.80		1,258,368.78	
半产品	39,234.63		760,448.84		3,383,582.82	
库存商品	15,950,440.89	2,522,886.63	15,865,979.71	3,389,546.51	5,658,012.35	3,024,285.04
发出商品	4,103,695.08		2,469,144.54		2,676,779.45	
合计	25,586,675.15	2,522,886.63	24,993,590.53	3,389,546.51	16,809,111.25	3,024,285.04

报告期公司主要专注于集成电路设计，生产环节主要包括晶圆制造、中测、封装、成测、成品入库。2013年6月前公司将晶圆制造、封装委外加工，测试由南麟电子执行；2013年6月后，公司子公司无锡麟力封装测试生产线陆续投产，公司封装、测试由子公司无锡麟力执行，南麟电子仅有少量测试，晶圆制造仍委外加工。

公司半成品主要系已完成中测但尚未封装的芯片。2013年6月前，因公司封装系委托外协，半成品通常需按批集中发往封装外协，故期末通常半成品余额较大。2013年6月后，公司逐步由委外封装转为自主封装，公司已完成中测的半成品无需再集中按批发出，而是由封装车间根据生产安排直接随时从半成品库领出。故公司半成品余额在2013年6月前通常较大，2013年6月后随着自主封

装比例的提升,公司半成品余额逐步下降。公司 2013 年末半成品余额 760,448.84 元,较 2012 年末下降 77.53%

公司在产品系尚在车间进行生产加工的芯片。2013 年 6 月前,因公司封装系委托外协,故公司在产品系尚在中测或成测生产线上的芯片。2013 年 6 月,公司封装生产线投产后,除尚在中测或成测生产线上的芯片外,尚在封装生产线的芯片亦作为在产品核算。因中测及成测工艺较封装简单、生产周期较封装较短,故通常封装生产线上在产品大幅多于中测及成测生产线。故公司在产品余额在 2013 年 6 月前通常较小,2013 年 6 月后随着自主封装比例的提升,公司在产品余额逐步上升。公司 2013 年末在产品余额 2,914,836.80 元,较 2012 年末上升 131.64%。

报告期公司低值易耗品主要系封装生产所需的耗材及辅材,2013 年 6 月公司封装生产线投产后,低值易耗品大幅上升,2013 年末低值易耗品余额 1,065,974.34 元,较 2012 年上升 15472.70%。

报告期公司委托加工物资主要系委外封装的半成品,2013 年 6 月公司封装生产线投产后,原委外封装逐步转为自产封装,委托加工物资余额大幅下降,2013 年末委托加工物资 137,856.53 元,较 2012 年末下降 88.12%。

公司 2013 年 6 月封装生产线投产,为应对原封装外协商可能的抵触,公司在 2013 年大幅加大存货备库,库存商品余额大幅上升,2013 年末库存商品余额 15,865,979.71 元,较 2012 年末上升 180.42%。公司封装生产线投产后,运转正常,在自主封装比例逐步提升的同时,与长电科技等封装外协商仍保持良好的业务合作,目前公司已开始逐步下调存货备库量。

报告期末公司存货的库龄情况如下:

项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
原材料	1,233,172.42				1,233,172.42
低值易耗品	1,711,915.86				1,711,915.86
委托加工物资	39,909.75				39,909.75
在产品	2,508,306.52				2,508,306.52

半产品	39,234.63				39,234.63
库存商品	13,132,472.73	472,048.06	1,281,947.49	1,063,972.61	15,950,440.89
发出商品	4,103,695.08				4,103,695.08
合计	22,768,706.99	472,048.06	1,281,947.49	1,063,972.61	25,586,675.15

公司所属的集成电路行业，各类技术更新换代快，市场竞争激烈。若公司的研发不能及时跟上新技术变革的步伐、产品不能适应市场的变化，存货库龄较长时，存在较大减值风险。公司在2014年1-4月核销已减值存货943,683.67元，同时在报告期末，公司库存商品库龄1年以上余额2,817,968.16元，已计提减值准备2,522,886.63元。”

7、其他流动资产

2012年末、2013年末、2014年4月末公司其他流动资产明细情况如下：

单位：元

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
银行理财产品			7,500,000.00
增值税留抵税额	2,564,117.13	606,179.18	596,870.67
预交企业所得税	207,337.17	16,137.88	49,981.99
预提增值税进项税额	1,695,445.50	3,430,015.71	
合计	4,466,899.80	4,052,332.77	8,146,852.66

公司2012年末其他流动资产主要系购置以现金管理为目的的短期银行理财产品，公司2013年末、2014年4月末其他流动资产主要系增值税留抵税额及内部销售预提的进项税额。

8、固定资产

(1) 固定资产类别、折旧年限及折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。各类固定资产的使用年限、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
--------	---------	-----------	---------

机器设备	10	4	9.60
电子设备	3-5	4	19.20-32.00
运输设备	4-8	4	12.00-24.00
工具器具	5	4	19.20
办公设备	5	4	19.20

(2) 固定资产原值、累计折旧及净值

1) 固定资产原值

单位：元

2014年1-4月				
类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	11,405,420.50			11,405,420.50
电子设备	14,461,793.30	9,651.79	3,485.55	14,467,959.54
运输设备	2,813,882.29			2,813,882.29
工具器具	2,527,426.65	91,452.99		2,618,879.64
办公设备	159,821.80			159,821.80
合计	31,368,344.54	101,104.78	3,485.55	31,465,963.77
2013年度				
类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	1,274,690.25	10,130,730.25		11,405,420.50
电子设备	9,529,757.18	4,932,036.12		14,461,793.30
运输设备	2,586,411.12	227,471.17		2,813,882.29
工具器具	39,121.37	2,488,305.28		2,527,426.65
办公设备	159,821.80			159,821.80
合计	13,589,801.72	17,778,542.82		31,368,344.54
2012年度				
类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	1,274,690.25			1,274,690.25

电子设备	9,564,235.29	115,410.89	149,889.00	9,529,757.18
运输设备	2,586,411.12			2,586,411.12
工具器具	39,121.37			39,121.37
办公设备	189,733.00	6,029.80	35,941.00	159,821.80
合计	13,654,191.03	121,440.69	185,830.00	13,589,801.72

2) 累计折旧

单位：元

2014年1-4月				
类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	1,188,088.98	399,593.37		1,587,682.35
电子设备	6,186,164.64	720,095.93	1,786.25	6,904,474.32
运输设备	1,992,218.14	112,964.03		2,105,182.17
工具器具	238,171.63	163,234.26		401,405.89
办公设备	130,276.49	6,316.80		136,593.29
合计	9,734,919.88	1,402,204.39	1,786.25	11,135,338.02
2013年度				
类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	827,800.56	360,288.42		1,188,088.98
电子设备	5,433,779.53	752,385.11		6,186,164.64
运输设备	1,604,637.48	387,580.66		1,992,218.14
工具器具	13,382.13	224,789.50		238,171.63
办公设备	108,243.03	22,033.46		130,276.49
合计	7,987,842.73	1,747,077.15		9,734,919.88
2012年度				
类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	578,519.01	249,281.55		827,800.56
电子设备	3,712,707.50	1,864,965.46	143,893.44	5,433,779.53
运输设备	1,225,653.64	378,983.85		1,604,637.48

工具器具	5,870.83	7,511.30		13,382.13
办公设备	109,302.72	32,631.81	33,691.50	108,243.03
合计	5,632,053.70	2,533,373.97	177,584.94	7,987,842.73

3) 固定资产净值

单位：元

类别	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
机器设备	9,817,738.15	10,217,331.52	446,889.69
电子设备	7,563,485.22	8,275,628.66	4,095,977.66
运输设备	708,700.12	821,664.15	981,773.63
工具器具	2,217,473.75	2,289,255.02	25,739.24
办公设备	23,228.51	29,545.31	51,578.77
合计	20,330,625.75	21,633,424.66	5,601,958.99

报告期公司固定资产原值分别为1,358.98万元、3,136.83万元、3,146.60万元，其中2013年末较2012年末增长130.82%，主要系因2013年公司购置封装测试生产线，购入大量机器设备、电子设备及工具器具。

9、无形资产

(1) 无形资产原价、累计摊销及净值

1) 无形资产原价

单位：元

2014年1-4月				
类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
软件	549,022.44			549,022.44
合计	549,022.44			549,022.44
2013年度				
类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
软件	500,814.89	48,207.55		549,022.44

合计	500,814.89	48,207.55		549,022.44
2012 年度				
类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
软件	269,024.95	231,789.94		500,814.89
合计	269,024.95	231,789.94		500,814.89

2) 无形资产累计摊销

单位：元

2014 年 1-4 月				
类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
软件	336,878.02	23,084.24		359,962.26
合计	336,878.02	23,084.24		359,962.26
2013 年度				
类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
软件	219,895.55	116,982.47		336,878.02
合计	219,895.55	116,982.47		336,878.02
2012 年度				
类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
软件	156,661.30	63,234.25		219,895.55
合计	156,661.30	63,234.25		219,895.55

3) 无形资产净值

单位：元

类别	2014 年 4 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
软件	189,060.18	212,144.42	280,919.34
合计	189,060.18	212,144.42	280,919.34

公司无形资产系购入的日常办公软件。

10、资产减值准备

(1) 资产减值准备计提依据

资产减值准备计提依据详见本公开转让说明书第四节之“五、主要会计政策和会计估计”。

(2) 资产减值准备计提、转回及核销情况

单位：元

项目	2013 年末	当期计提	当期转回	当期核销	2014 年 4 月末
坏账准备	629,282.89		14,677.31		614,605.58
存货跌价准备	3,389,546.51			866,659.88	2,522,886.63
项目	2012 年末	当期计提	当期转回	当期核销	2013 年末
坏账准备	641,876.26		12,593.37		629,282.89
存货跌价准备	3,024,285.04	365,261.47			3,389,546.51
项目	2011 年末	当期计提	当期转回	当期核销	2012 年末
坏账准备		641,876.26			641,876.26
存货跌价准备	2,048,436.92	975,848.12			3,024,285.04

(七) 主要负债情况

1、短期借款

类别	2014 年 4 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
保证借款	5,000,000.00	4,000,000.00	15,000,000.00
合计	5,000,000.00	4,000,000.00	15,000,000.00

公司 2013 年因与供应商的主要结算模式由现款结算转为银行承兑汇票结算，公司在银行的主要融资方式由借款转为承兑汇票，2013 年末公司银行借款余额较 2012 年大幅下降。

2、应付票据

类别	2014 年 4 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	17,361,475.88	20,983,853.31	

合计	17,361,475.88	20,983,853.31	
----	---------------	---------------	--

公司 2013 年因与供应商的主要结算模式由现款结算转为银行承兑汇票结算，公司在银行的主要融资方式由借款转为承兑汇票，2013 年末公司应付票据余额大幅上升。

3、应付账款

单位：元

项目	2014 年 4 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比
1 年以内	7,496,923.81	100.00%	10,274,454.04	100.00%	3,846,286.94	100.00%
合计	7,496,923.81	100.00%	10,274,454.04	100.00%	3,846,286.94	100.00%

截至 2014 年 4 月末，公司应付账款前 5 名情况如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	是否关联方
江苏长电科技股份有限公司	2,585,270.51	1 年以内	否
SRM INTEGRATION(M) SDN BHD	2,127,032.27	1 年以内	否
EXIS TECH SDN BHD MALAYSIA	1,588,764.00	1 年以内	否
新藤电子(上海)有限公司	280,652.15	1 年以内	否
江阴新杰科技有限公司	119,140.96	1 年以内	否
合计	6,700,859.89	-	-

截至 2013 年 12 月末，公司应付账款前 5 名情况如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	是否关联方
江苏长电科技股份有限公司	3,751,249.49	1 年以内	否
SRM INTEGRATION(M) SDN BHD	3,320,980.96	1 年以内	否
EXIS TECH SDN BHD MALAYSIA	1,573,000.20	1 年以内	否
上海光刻电子科技有限公司	400,000.00	1 年以内	否

无锡市国腾半导体有限公司	249,803.67	1年以内	否
合计	9,295,034.32		

截至2012年12月末，公司应付账款前5名情况如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	是否关联方
江苏长电科技股份有限公司	3,499,033.93	1年以内	否
无锡红光微电子股份有限公司	224,696.82	1年以内	否
上海芯哲微电子科技有限公司	95,651.49	1年以内	否
上海盛房建筑装饰工程有限公司	16,659.33	1年以内	否
SRM INTEGRATION(M) SDN BHD	10,245.37	1年以内	否
合计	3,846,286.94		

公司2013年因自建封装生产线，融资需求大，公司与供应商的主要结算模式由现款结算转为银行承兑汇票结算，同时结算周期亦相应加长。公司2013年末应付票据、应付账款余额较2012年末大幅上升，短期借款余额较2012年末大幅下降。

4、预收账款

项目	2014年4月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比
1年以内	467,675.47	100%	93,235.49	100%	345,139.93	100%
合计	467,675.47	100%	93,235.49	100%	345,139.93	100%

截至2014年4月末，公司预收账款前5名情况如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占应预收款 总额的比例	欠款原因
香港立天捷运	267,625.48	1年以内	57.22%	货款，未结算
深圳市芯为电子技术有限公司	30,600.00	1年以内	6.54%	货款，未结算
上海缘合电子科技有限公司	28,800.00	1年以内	6.16%	货款，未结算

江苏大德重工有限公司	20,000.00	1年以内	4.28%	货款, 未结算
深圳市海芯微科技有限公司	18,360.00	1年以内	3.93%	货款, 未结算
合计	365,385.48		78.13%	

截至2013年12月末, 公司预收账款前5名情况如下:

单位: 元

单位名称	金额	账龄	占应预收款 总额的比例	欠款原因
深圳市芯为电子技术有限公司	21,300.00	1年以内	22.85%	货款, 未结算
深圳市裕昇科技有限公司	10,080.00	1年以内	10.81%	货款, 未结算
深圳市长基电子有限公司	7,680.00	1年以内	8.24%	货款, 未结算
苏州市恺乐电子有限公司	6,300.00	1年以内	6.76%	货款, 未结算
东莞市龙晶电子有限公司	5,579.99	1年以内	5.98%	货款, 未结算
合计	50,939.99		54.64%	

截至2012年12月末, 公司预收账款前5名情况如下:

单位: 元

单位名称	金额	账龄	占应预收款 总额的比例	欠款原因
骏旭科技有限公司	300,960.42	1年以内	87.20%	货款, 未结算
深圳市迅瑞创芯科技有限公司	14,316.00	1年以内	4.15%	货款, 未结算
东莞市龙晶电子有限公司	10,995.11	1年以内	3.19%	货款, 未结算
深圳市睿翔通信技术有	5,748.00	1年以内	1.67%	货款, 未结算
深圳市杰航电子有限公司	3,940.00	1年以内	1.14%	货款, 未结算
合计	335,959.53		97.34%	

报告期公司销售以赊销为主, 少量客户采用款到发货方式结算。报告期末公司预收账款均为预收货款, 账龄1年以内。

5、其他应付款

单位: 元

项目	2014年4月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比
1年以内	6,738,670.65	100.00%	5,175,027.69	100.00%	881,818.22	100.00%
合计	6,738,670.65	100.00%	5,175,027.69	100.00%	881,818.22	100.00%

截至2014年4月末，公司其他应付款前5名情况如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	是否关联方
刘桂芝	6,680,000.00	1年以内	是
代扣代缴社保	30,984.12	1年以内	否
预提房租	14,685.00	1年以内	否
保险费	7,228.00	1年以内	否
上海盛房建筑装饰工程有限公司	2,877.20	1年以内	否
合计	6,735,774.32		

截至2013年12月末，公司其他应付款前5名情况如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	是否关联方
刘桂芝	5,090,000.00	1年以内	是
代扣代缴社保	31,121.87	1年以内	否
代扣代缴个人所得税	23,278.26	1年以内	否
其他	22,000.00	1年以内	否
上海盛房建筑装饰工程有限公司	4,242.85	1年以内	否
合计	5,170,642.98		

截至2012年12月末，公司其他应付款前5名情况如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	是否关联方
上海光刻电子科技有限公司	793,195.00	1年以内	否
代扣代缴个人所得税	60,110.42	1年以内	否

代扣代缴社保	25,599.73	1年以内	否
保险费	1,550.00	1年以内	否
代扣代缴公积金	1,034.70	1年以内	否
合计	881,489.85		

公司2013年因购置封装测试生产线，资金压力大，公司以不计息往来款形式向实际控制人刘桂芝拆入资金，截至报告期末，拆入资金余额268.00万元。公司与刘桂芝未签订借款协议，未约定利息，亦未要求支付利息，若按1年期贷款基准利率计算，该资金拆借截至报告期期末利息约为4万元。根据刘桂芝2014年10月签署的情况说明，公司取得的上述借款无需支付利息，同时借款归还期限由公司根据经营情况自行决定，刘桂芝将不主动向公司提出还款要求。上述借款对公司偿债风险无重大不利影响。

公司2014年4月以400.00万元收购实际控制人刘桂芝持有的无锡麟力40%股权，截至报告期末，股权转让款尚未支付；上述款项合计668.00万元。

（八）报告期股东权益情况

单位：元

类型	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
股本	11,260,000.00	11,260,000.00	11,260,000.00
资本公积	232,166.67	232,166.67	124,935.80
盈余公积	3,076,872.13	3,076,872.13	3,076,872.13
未分配利润	21,324,108.03	21,021,748.25	16,188,098.25
外币报表折算差额	-346,392.58	-384,110.89	-275,199.99
归属于母公司股东所有者权益合计	35,546,754.25	35,206,676.16	30,374,706.19
少数股东权益	1,752,315.65	1,784,949.34	630,752.73
股东权益合计	37,299,069.90	36,991,625.50	31,005,458.92

七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

（一）关联方及关联关系

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
刘桂芝	实际控制人、董事长、高级管理人员
张燕芳	报告期内曾为公司实际控制人[注]
上海南麟实业投资有限公司	报告期内曾为公司控股股东[注]

注：公司设立至 2012 年 9 月，南麟实业为公司控股股东，张燕芳为公司实际控制人，南麟实业于 2012 年 9 月退出公司，将全部股权转让给刘桂芝等 13 名自然人并于 2012 年 12 月 20 日注销。

2、子公司情况

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	实收资本	持股比例	表决权比例
无锡矽林威电子有限公司	有限公司	无锡	电路设计	800 万元	800 万元	96.25%	96.25%
深圳市善点微电子有限公司	有限公司	深圳	集成电路销售	200 万元	200 万元	90%	90%
无锡麟力科技有限公司	有限公司	无锡	电路设计	1,000 万元	1,000 万元	90%	90%
矽林（香港）电子有限公司	有限公司	香港	集成电路销售	1 万港元	1 万港元	100%	100%

3、不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
吴国平	持有公司 5%以上股份股东、董事、高级管理人员
吴春达	持有公司 5%以上股份股东、董事、高级管理人员
刘检生	持有公司 5%以上股份股东、高级管理人员
蒋小强	股东、监事
何云	股东、董事、高级管理人员
黄年亚	股东、董事、高级管理人员

班福奎	股东、监事
张丽佳	职工代表监事
万元皎	股东、实际控制人的配偶
江苏长电科技股份有限公司	报告期内曾任董事控制的企业[注 1]
无锡新洁能功率半导体有限公司	报告期内原实际控制人控制的企业[注 2]

注 1：江苏长电科技股份有限公司实际控制人、董事长王新潮在 2009 年 6 月至 2012 年 8 月期间曾持有公司 4.44% 股份，并担任公司董事。江苏长电科技股份有限公司在 2009 年 6 月至 2012 年 8 月期间为公司关联方。

注 2：无锡新洁能功率半导体有限公司的控股股东、实际控制人张燕芳自公司成立至 2012 年 9 月为公司实际控制人。无锡新洁能功率半导体有限公司在 2009 年 12 月至 2012 年 9 月期间为公司关联方。

（二）关联往来

单位：元

项目	关联方	2014 年 4 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
		账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比
其他应付款	刘桂芝	6,680,000.00	99.13%	5,090,000.00	98.36%		
	合计	6,680,000.00	99.13%	5,090,000.00	98.36%		

（三）关联交易

1、经常性关联交易

采购商品

关联方	2014 年 1-4 月		2013 年		2012 年	
	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比
江苏长电科技股份有限公司 (关联方期间)					14,240,636.21	37.90%
江苏长电科技股份有限公司	1,937,454.06	30.18%	21,717,599.16	46.16%	5,548,199.34	14.77%

(非关联方期间)						
无锡新洁能功率半导体有限公司(关联方期间)					15,705.98	0.04%
无锡新洁能功率半导体有限公司(非关联方期间)						
合计	1,937,454.06	30.18%	21,717,599.16	46.16%	19,804,541.53	52.71%

江苏长电科技股份有限公司实际控制人、董事长王新潮在 2009 年 6 月至 2012 年 8 月期间曾持有公司 4.44% 股份，并担任公司董事。此后，王新潮未持有公司股份，亦未在公司任职，故公司报告期初至 2012 年 8 月与长电科技的交易系关联交易，2012 年 9 月至报告期末与长电科技的交易不属于关联交易。

2、偶发性关联交易

(1) 资金拆借

公司 2013 年因购置封装测试生产线，资金压力大，公司以不计息往来款形式向实际控制人刘桂芝拆入资金，截至报告期末，拆入资金余额 268.00 万元；公司 2014 年 4 月以 400.00 万元收购实际控制人刘桂芝持有的无锡麟力 40% 股权，截至报告期末，股权转让款尚未支付；上述款项合计 668.00 万元。

(2) 股权转让

根据公司 2012 年 9 月股东会决议，股东吴国平、黄年亚、班福奎将所持无锡矽林威 67 万元出资额作价 67 万元转让给南麟电子。

根据公司 2013 年 6 月股东会决议，南麟电子将持有的无锡麟力 400 万元出资额作价 400 万元转让给刘桂芝。

根据公司 2014 年 4 月股东会决议，刘桂芝将持有的无锡麟力 400 万元出资额作价 400 万元转让给南麟电子。

(3) 担保

1) 报告期公司未向关联方提供担保

2) 报告期关联方向公司提供的尚未履行完毕的担保

根据刘桂芝、万元姣与宁波银行上海静安支行 2013 年 4 月签订的最高额保证合同，刘桂芝、万元姣为上海南麟电子有限公司自 2013 年 4 月 2 日至 2014 年 9 月 20 日发生的对宁波银行上海静安支行发生的各项债务提供最高额 500 万元的连带责任保证担保。截至报告期末，上述担保合同项下借款余额 150 万元、银行承兑汇票余额 648.00 万元，公司缴存的承兑保证金余额 324.00 万元。

根据刘桂芝与南京银行上海分行 2013 年 8 月签订的最高额保证合同，刘桂芝为上海南麟电子有限公司自 2013 年 8 月 1 日至 2014 年 8 月 1 日发生的对南京银行上海分行发生的各项债务提供最高额 500 万元的连带责任保证担保。截至报告期末，上述担保合同项下借款余额 350 万元，银行承兑汇票余额 264.04 万元，公司缴存的承兑保证金余额 132.02 万元。

根据刘桂芝与上海银行浦东分行 2013 年 8 月签订的最高额保证合同，刘桂芝为上海南麟电子有限公司自 2013 年 8 月 15 日至 2014 年 8 月 14 日发生的对上海银行浦东分行发生的各项债务提供最高额 1000 万元的连带责任保证担保。截至报告期末，上述担保合同项下银行承兑汇票余额 824.11 万元，公司缴存的承兑保证金余额 412.05 万元。

（四）关联交易的必要性与合理性

报告期公司未持有房屋、土地等不动产，故公司在银行取得的借款主要依靠实际控制人刘桂芝提供的保证担保，同时公司 2013 年因购置封装测试生产线，资金压力大，公司以不计息往来款形式向实际控制人刘桂芝拆入资金。

封装测试，是将制作好的晶圆进行切割，并封装成为最终的 IC 产品。江苏长电科技股份有限公司是中国本土知名专业封装测试厂商之一，公司设立开始就与其保持业务合作关系。

（五）关联交易的定价机制与公允性

1、关联交易的定价机制

关联交易的定价机制有限公司阶段，公司关联交易定价机制为市场价，但未

执行特别审批程序，业务流程与向其他客户或供应商一致。股份公司成立后，公司通过制定《关联交易决策制度》对业务流程及审批程序予以完善。公司与长电科技定价机制为双方签订长期供应协议，长电科技根据各类产品的技术难度、采购量等因素综合考虑后，向公司提交报价单，若某类产品的市场因素发生较大变化，双方再就特定产品重新协商定价，其他产品的定价则一直予以保持。

2、关联交易定价的公允性

公司设立开始就与江苏长电科技股份有限公司保持业务合作关系，公司与定价机制在其成为公司关联方之前、成为公司关联方期间及成为公司关联方之后未发生变化，双方系按市场价定价，价格公允。

（六）关联交易审批程序及执行情况

1、关联交易审批程序

有限公司阶段，公司关联交易未执行特别审批程序，关联交易审批程序与公司同类交易审批程序一致。股份公司成立后，公司已通过制定《关联交易管理办法》对关联交易审批程序予以规范。公司《关联交易管理办法》规定：

公司与关联人发生的日常关联交易金额在人民币一百万元以上，或占公司最近经审计净资产值的百分之五以上的关联交易协议（公司获赠现金资产和提供担保除外），经董事会批准后，应当由董事会向股东大会提交议案，经股东大会批准后生效。公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

除上述关联交易之外的其他关联交易，经董事会批准后生效。

2、关联交易审批程序执行情况

股份公司成立后至本转让说明书签署日，公司无新达成的关联交易事项。

（七）关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

报告公司因部分生产工序由委托加工变更为自行生产，固定资产投资较大，

融资需求较大。但公司属于研发驱动型公司，无房产、土地等抵押物，公司股东为公司借款提供担保、向公司拆出资金等关联交易有助于解决公司的融资需求。

公司自设立起即向江苏长电科技股份有限公司采购封装测试服务，双方系市场化合作，报告期双方的交易模式及定价未发生变化，报告期初至 2012 年 10 月期间，公司向江苏长电科技股份有限公司的关联交易未对公司的财务状况及经营成果产生特定影响。

（八）规范和减少关联交易的措施

本公司已在《公司章程》及《关联交易决策制度》中对关联交易决策程序进行规定，以确保关联交易的公开、公允、合理，从而保护本公司全体股东及本公司利益。同时持有公司 5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员已承诺将尽可能的避免和减少其本人及与关系密切的家庭成员及其控制或担任董事、高级管理人员的其他企业、组织、机构与南麟电子之间的关联交易。

八、期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

根据公司股东会决议，上海南麟电子有限公司整体变更为上海南麟电子股份有限公司，南麟电子全体出资者以其拥有的经审计净资产 32,867,650.84 元认缴，折合 11,260,000 股普通股股份，每股面值 1 元，剩余净资产计入资本公积。此次整体变更事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具致同验字（2014）第 310FC0016 号验资报告。公司已于 2014 年 7 月 15 日在上海市工商行政管理局完成工商变更登记手续。

（二）或有事项

无

（三）其他重要事项

本报告期无需要披露的其他重要事项。

九、报告期内的资产评估情况

（一）股份公司成立时资产评估情况

根据公司 2014 年 5 月 14 日股东会决议，公司拟整体变更为股份有限公司，委托上海东洲资产评估有限公司以 2014 年 4 月 30 日为基准日的全部净资产进行评估，评估方法主要为资产基础法，出具沪东洲资评报字【2014】第 0471257 号评估报告，评估值 60,082,606.24 元，增值额 27,214,955.40 元，增值率 82.80%。

评估增值主要系长期股权投资评估增值 1,620.02 万元、固定资产评估增值 165.93 万元、无形资产净额评估增值 890.74 万元。

（二）子公司股东以非专利技术出资时资产评估情况

根据公司子公司无锡矽林威 2013 年 8 月 31 日股东会决议，刘桂芝等 12 人以“新型锁相环及其自动频率校准电路技术”、“新型消除直流偏差的电路技术”两项非专利技术对无锡矽林威增资。北京中金浩资产评估有限责任公司于 2013 年 7 月 31 日为基准日对该两项非专利技术进行评估，评估方法为收益法，出具中金浩评报字【2013】第 629 号评估报告，评估值 1200 万元。

十、股利分配政策及最近两年的分配情况

（一）股利分配政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- （1）弥补以前年度亏损；
- （2）提取法定公积金 10%；
- （3）提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；

(4) 按照股东持有的股份比例分配。

有限公司章程规定股东按实缴出资的比例分取红利,但报告期公司经股东会以全体股东审议通过后,曾以股东会确定的比例分红。股份公司成立后,公司章程及章程(草案)规定按照股东持有的股份比例分配。

(二) 最近两年股利分配情况

1、最近两年股利分配情况

根据公司 2012 年 9 月股东会决议,公司以 2012 年度以实收资本 1,126 万元为基数,每股分配现金股利 0.4 元。当时上海南麟实业投资有限公司出资额 713 万元,应分配股利 285.20 万元;其他小股东持股 413 万元,应分配股利 165.20 万元。但由于 2010 年度大股东上海南麟实业投资有限公司放弃分红,其他小股东自愿放弃此次分红。故此次分红实际分配股利 285.20 万元,公司于 2012 年 9 月 3 日实际支付给上海南麟实业投资有限公司。

2、2010 年股利分配情况

根据 2010 年 2 月股东会决议,公司以 2009 年度以实收资本 1,126 万元为基数,每股分配现金股利 0.5 元。当时上海南麟实业投资有限公司出资额 713 万元,应分配股利 356.50 万元;其他小股东持股 413 万元,应分配股利 206.50 万元。上海南麟实业投资有限公司为利让其他小股东,自愿放弃此次分红。故此次分红实际支付股利 206.50 万元,公司于 2010 年 2 月 5 日向各小股东账户支付 165.20 万元,代扣代缴个税 41.30 万元。

(三) 公开转让后的股利分配政策

公司股份公开转让后执行的股利分配政策为现行的股利分配政策。

十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

(一) 无锡矽林威电子有限公司

1、基本情况

无锡矽林威电子有限公司成立于 2010 年 10 月，住所为无锡新区长江路 21 号信息产业科技园 F 座一楼，法定代表人刘桂芝，注册资本为 800 万元，实收资本为 800 万元，经营范围包括“集成电路、机械设备的设计、制造（限分支机构）、销售、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（上述经营范围涉及行政许可的，经许可后方可经营；涉及专项审批的，经批准后方可经营）”。

公司目前的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例	出资方式
1	南麟电子	770 万元	770 万元	96.25%	货币
2	刘桂芝	30 万元	30 万元	3.75%	货币
	合计	800 万元	800 万元	100%	

2、无锡矽林威设立及历次股权变更情况

(1) 2010 年 10 月 20 日，无锡矽林威电子有限公司设立

2010 年 10 月，南麟电子、刘桂芝、吴国平等七名股东共同投资设立了无锡矽林威，注册资本 300 万元；住所地为无锡新区长江路 21 号信息产业科技园 F 座二楼；经营范围为“集成电路及其应用产品的设计、制造（限分支机构）、销售、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）”。本次出资业经江苏无锡长江会计师事务所与 2010 年 10 月 19 日出具的苏锡长所内验设字（2010）第 06239 号《验资报告》验证。公司于 2010 年 10 月 20 日取得了无锡工商行政管理局新区分局颁发的《企业法人营业执照》。

公司设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例
1	上海南麟电子有限公司	180.00	60.00%
2	刘桂芝	30.00	10.00%
3	吴国平	29.00	9.66%
4	黄年亚	20.00	6.67%
5	王冬峰	20.00	6.67%
6	班福奎	18.00	6.00%
7	周小燕	3.00	1.00%
合计		300.00	100.00%

（2）2012年10月，第一次股权转让

2012年9月28日，股东吴国平、黄年亚、王冬峰、周小燕和班福奎将所持无锡矽林威的全部股权转让给南麟电子，转让价格为每1元出资额作价1元。公司于2012年10月19日取得了无锡工商行政管理局新区分局换发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例
1	南麟电子	270.00	90.00%
2	刘桂芝	30.00	10.00%
合计		300.00	100.00%

（3）2013年3月，第一次增资至800万元

2013年3月16日，无锡矽林威召开股东会，同意公司注册资本、实收资本增加至800万元，增资部分由股东南麟电子以货币出资500万元。本次增资业经无锡银河联合会计师事务所（普通合伙）于2013年3月18日出具的银河内验字（2013）第078号《验资报告》验证。公司于2013年3月20日取得了无锡工商行政管理局新区分局换发的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例
1	南麟电子	770.00	96.25%
2	刘桂芝	30.00	3.75%
	合计	800.00	100.00%

(4) 2013年11月，第二次增资至2,000万元

2013年8月31日，无锡矽林威召开股东会，同意公司注册资本、实收资本由800万元增至2,000万元，增资部分1,200万元由刘桂芝、吴国平等12名自然人以非专利技术“新型锁相环及其自动频率校准电路技术”和“新型消除直流偏差的电路技术”出资。根据北京中金浩资产评估有限责任公司于2013年8月25日出具的金浩评报字【2013】第629号评估报告书，上述非专利技术的评估价值为1,200万元。本次增资业经北京中福华会计师事务所有限责任公司于2013年11月6日出具了中福华验字（2013）第207号《验资报告》验证。公司于2013年11月29日取得了无锡工商行政管理局新区分局换发的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后的股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴出资额（万元）			实缴出资额占 注册资本比例
		货币	知识产权	合计	
南麟电子	770.00	770.00	-	770.00	38.500%
刘桂芝	757.68	30.00	727.68	757.68	37.884%
吴国平	120.96	-	120.96	120.96	6.048%
黄年亚	40.08	-	40.08	40.08	2.004%
王冬峰	29.04	-	29.04	29.04	1.452%
班福奎	40.08	-	40.08	40.08	2.004%
崔凤敏	14.04	-	14.04	14.04	0.702%
何云	33.96	-	33.96	33.96	1.698%
蒋小强	40.08	-	40.08	40.08	2.004%
刘检生	60.00	-	60.00	60.00	3.000%

王 艳	10.08	-	10.08	10.08	0.504%
吴春达	63.96	-	63.96	63.96	3.198%
周 尧	20.04	-	20.04	20.04	1.002%
合 计	2,000.00	800.00	1,200.00	2000.00	100.000%

(5) 2014年7月，减资至800万元

2014年4月9日，无锡矽林威召开股东会，同意将公司注册资本和实收资本减至800万元，本次减少的注册资本部分为2013年11月增资过程中非专利技术出资部分，减资后股东出资不存在以无形资产出资的情况，公司注册资本全部由货币资金缴纳且足额到位。

2014年4月30日，公司在上海《江苏商报》刊登了减资公告。公司于2014年7月2日取得了无锡工商行政管理局新区分局换发的《企业法人营业执照》。

本次减资后，无锡矽林威的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例
1	南麟电子	770.00	96.25%
2	刘桂芝	30.00	3.75%
合计		800.00	100.00%

2014年8月15日，无锡矽林威召开股东会，同意刘桂芝将其持有的无锡矽林威3.75%股权转让给南麟电子，股权转让的价格为每1元出资额作价1元，目前工商变更登记正在办理中。

此次股权转让完成后，无锡矽林威的股权结构：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例
1	南麟电子	800.00	100.00%
合计		800.00	100.00%

3、公司主要财务数据：

项目	2014年4月30日	2013年12月31日

总资产	36,525,030.28	35,952,059.40
总负债	13,690,767.11	13,708,998.17
净资产	22,834,263.17	22,243,061.23
项目	2014年1-4月	2013年度
营业收入	5,065,000.03	54,067,784.81
净利润	591,201.94	12,527,367.35

(二) 深圳市善点微电子有限公司

1、基本情况

深圳市善点微电子有限公司成立于2010年7月，住所为深圳市南山区科兴路11号深南花园裙楼B区五层512室，法定代表人刘桂芝，注册资本为200万元，实收资本为200万元，经营范围包括“集成电路及其应用产品的设计、制造、销售以及相关技术咨询”。

公司目前的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例	出资方式
1	南麟电子	180万元	180万元	90%	货币
2	吴国平	10万元	10万元	5%	货币
3	刘桂芝	10万元	10万元	5%	货币
合计		200万元	200万元	100%	

2、深圳善点设立及历次股权变更情况

(1) 2010年7月15日，深圳市善点微电子有限公司设立

2010年7月，南麟电子、刘桂芝和吴国平共同投资设立了深圳善点，注册资本200万元，其中，南麟电子以货币出资180万元，刘桂芝以货币出资10万元，吴国平以货币出资10万元；公司住所为深圳市南山区科苑路5号科苑西24栋东段3层A304；法定代表人为刘桂芝；经营范围为“集成电路及其应用产品的设计、制造、销售以及相关技术咨询”。本次出资业经深圳中联岳华会计师事务所于2010年6月2日出具的深中岳验字（2010）第075号《验资报告》验

证。公司于 2010 年 7 月 15 日取得了深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》。

公司设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例
1	南麟电子	180.00	90.00%
2	刘桂芝	10.00	5.00%
3	吴国平	10.00	5.00%
合计		200.00	100.00%

(2) 2014 年 8 月 15 日，深圳善点召开股东会，同意刘桂芝将其持有的深圳善点 5%股权转让给南麟电子，同意吴国平将其持有的深圳善点 5%股权转让给南麟电子，股权转让的价格为每 1 元出资额作价 1 元，目前工商变更登记正在办理中。

此次股权转让完成后，深圳善点股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例
1	南麟电子	200.00	100.00%
合计		200.00	100.00%

3、公司主要财务数据：

项目	2014 年 4 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
总资产	4,863,294.92	4,264,744.61
总负债	3,263,189.17	2,696,192.82
净资产	1,600,105.75	1,568,551.79
项目	2014 年 1-4 月	2013 年度
营业收入	3,681,988.80	12,340,945.87
净利润	31,553.96	-23,281.57

（三）无锡麟力科技有限公司

1、基本情况

无锡麟力科技有限公司成立于 2013 年 3 月，住所为无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中三路 99 号瑞云 3 座，法定代表人刘桂芝，注册资本为 1,000 万元，实收资本为 1,000 万元，经营范围包括“集成电路及机电产品的设计、制造、销售、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

公司目前的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例	出资方式
1	南麟电子	900 万元	900 万元	90%	货币
2	吴国平	100 万元	100 万元	10%	货币
合计		1,000 万元	1,000 万元	100%	

2、无锡麟力设立及历次股权变更情况

（1）2013 年 3 月，无锡麟力科技有限公司设立

2013 年 3 月，无锡麟力由南麟电子和无锡矽林威共同投资设立，注册资本 500 万元，其中南麟电子出资 400 万元，无锡矽林威出资 100 万元；法定代表人为刘桂芝；住所地为无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中三路 99 号瑞云 3 座；经营范围为“集成电路及机电产品的设计、制造、销售、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）”。本次出资业经上海诚汇会计师事务所有限公司于 2013 年 3 月 1 日出具的诚汇会验字（2013）第 0046 号《验资报告》验证。公司于 2013 年 3 月 12 日取得了无锡市锡山工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

无锡麟力设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例
1	南麟电子	400.00	80.00%

2	无锡矽林威	100.00	20.00%
合计		500.00	100.00%

(2) 2013年4月，第一次增资至1,000万元

2013年3月27日，无锡麟力召开股东会，同意公司注册资本、实收资本增加至1,000万元，增资部分由股东南麟电子以货币出资500万元。此次增资业经无锡银河联合会计师事务所（普通合伙）于2013年3月28日出具的银河内验字（2013）第095号《验资报告》验证。公司于2013年4月10日取得了无锡市锡山工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例
1	南麟电子	900.00	90.00%
2	无锡矽林威	100.00	10.00%
合计		1,000.00	100.00%

(3) 2013年6月，第一次股权转让

2013年6月8日，无锡麟力召开股东会，同意股东南麟电子和无锡矽林威分别将其持有无锡麟力40%和10%股权转让给刘桂芝，股权转让的价格为每1元出资额作价1元。公司于2013年6月19日取得了无锡市锡山工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例
1	南麟电子	500.00	50.00%
2	刘桂芝	500.00	50.00%
合计		1,000.00	100.00%

(4) 2013年10月，第二次股权转让

2013年9月27日，无锡麟力召开股东会，同意股东刘桂芝将其持有无锡麟

力 10%的股权转让给吴国平，股权转让的价格为每 1 元出资额作价 1 元。公司于 2013 年 10 月 15 日取得了无锡市锡山工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例
1	南麟电子	500.00	50.00%
2	刘桂芝	400.00	40.00%
3	吴国平	100.00	10.00%
合计		1,000.00	100.00%

（5）2014 年 6 月，第三次股权转让

2014 年 4 月 18 日，无锡麟力召开股东会，同意股东刘桂芝将其持有无锡麟力的全部股权转让给南麟电子，股权转让的价格为每 1 元出资额作价 1 元。公司于 2014 年 6 月 16 日取得了无锡市锡山工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例
1	南麟电子	900.00	90.00%
2	吴国平	100.00	10.00%
合计		1,000.00	100.00%

（6）2014 年 8 月 15 日，无锡麟力召开股东会，同意吴国平将其持有的无锡麟力 10%股权转让给南麟电子，股权转让的价格为每 1 元出资额作价 1 元，目前工商变更登记正在办理中。

此次股权转让后，无锡麟力股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例
1	南麟电子	1,000.00	100.00%

合计	1,000.00	100.00%
----	----------	---------

3、公司主要财务数据

项目	2014年4月30日	2013年12月31日
总资产	38,685,201.97	39,244,922.97
总负债	31,325,000.04	31,305,129.40
净资产	7,360,201.93	7,939,793.57
项目	2014年1-4月	2013年度
营业收入	8,818,114.10	44,805,981.27
净利润	-579,591.64	-2,060,206.43

（四）矽林（香港）电子有限公司

矽林（香港）电子有限公司成立于2009年11月，系南麟电子在香港设立的有限公司，取得了1390915号《公司注册证书》，注册资本为1万港元。南麟电子和无锡麟力向矽林（香港）出口销售部分产品，再由矽林（香港）对外销售。公司目前的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例	出资方式
1	南麟电子	1万港元	1万港元	100%	货币
合计		1万港元	1万港元	100%	

公司主要财务数据如下：

项目	2014年4月30日	2013年12月31日
总资产	4,090,240.50	3,558,205.73
总负债	267,625.48	
净资产	3,822,615.02	3,558,205.73
项目	2014年1-4月	2013年度
营业收入	1,085,634.28	7,253,261.13
净利润	227,009.39	149,342.38

十二、风险因素

（一）技术研发风险

集成电路设计在国内尚属于成长中的新兴产业，技术创新及终端电子产品日新月异，各类技术更新换代很快，因此 IC 设计公司所需投入于新产品开发的研发费用金额较大。公司新产品的开发风险主要来自以下几个方面：（1）由于新产品的开发周期长，可能耗时半年至数年，在产品规划阶段，存在对市场需求判断失误的风险，可能导致公司产品定位错误；（2）存在对企业自身实力判断失误的风险，主要是技术开发能力的判断错误引起的，可能引发公司项目的突然中断；（3）在新产品上市销售阶段，存在因产品方案不够成熟等引起的市场开拓风险，这种风险可能导致产品销售迟滞，无法有效的回收成本，影响公司的后续开发。

由于电子产品行业的新市场格局变动较大，而公司对新技术新产品的预期又往往着眼于未来两到三年乃至更长期的市场目标，因此对未来市场的准确预测存在一定的局限性，如果公司对相关技术和市场发展趋势判断失误，或新技术的市场接受度未如预期，将让公司面临收益无法达到预期的风险。

（二）行业周期性风险

半导体行业本身有较大的周期性波动态势，公司的经营业绩及营业效益，可能会因为半导体行业本身周期性波动较大的特性，而产生较大的波动。2008 年至 2013 年我国集成电路行业增长情况如下图。

2008-2013 年我国集成电路行业增长情况



如上图所示,2009年,集成电路行业经历了大幅下滑,下滑幅度11.1%,2010年,行业快速反弹,同比增长32.7%,2011年到2012年,行业出现周期性回落,增速放缓,2013年行业温和增长,同比增长7.9%。

公司的经营业绩及营业效益,可能会因为半导体行业本身周期性波动较大的特性,而产生较大的波动。

(三) 供应商风险

公司专注于IC设计并自建封装测试线,将芯片制造、部分封装测试工序外包,符合IC产业垂直分工的特点,也符合近年来IC设计市场规模占IC整体产业价值比例逐渐增长的趋势,有利于公司提高IC设计水平、降低产品生产成本和扩大市场占有规模。

无晶圆厂运营模式,有利于公司提高IC设计水平、降低产品生产成本和扩大市场占有规模,但是无晶圆厂运营模式中,芯片制造、封装和测试必须依托晶圆代工厂和封装测试厂。同时,晶圆是公司产品的主要原材料,由于晶圆加工对技术及资金规模的要求极高,合适的晶圆代工厂商选择范围有限,导致公司的晶圆代工厂较为集中。在IC生产旺季,可能会存在晶圆代工厂和封装测试厂产能饱和,不能保证公司产品及时供应的风险。此外,晶圆价格的变动对公司利润有一定影响,未来若晶圆代工和封装、测试费用的价格出现上涨,将对公司的经营业绩造成不利影响。

（四）存货跌价风险

公司所属的集成电路行业，各类技术更新换代快，市场竞争激烈，存货存在跌价风险，公司 2012 年末、2013 年末、2014 年 4 月末存货跌价准备余额分别为 302.43 万元、338.95 万元、252.29 万元。若公司的研发不能及时跟上新技术变革的步伐、产品不能适应市场的变化，公司存货将面临跌价风险。

（五）短期偿债风险

报告期公司因购置封装测试生产线等大额资本性支出，导致资产负债率上升，流动比率及速动比率下降，短期偿债风险加大。报告期公司资产负债率分别为 36.70%、58.39%、53.22%，流动比率分别为 2.11、1.31、1.40，速动比率分别为 1.09、0.71、0.67，若公司主要债权人同时主张债权，公司难以在短时间内筹集资金，将面临短期偿债风险。

（六）非经常性损益占比较大风险

报告期公司非经常性损益分别为 101.36 万元、119.93 万元、-0.11 万元，其中 2012 年、2013 年非经常性损益占净利润的比例分别为 41.23%、23.54%，非经常性损益对公司净利润影响较大。报告期公司非经常性损益主要包括政府补助等，若公司享受的政府补助项目政策等发生重大变化，将对公司盈利能力产生不利影响。

第五节 定向发行

2014年8月1日，公司第一次临时股东大会审议通过《关于上海南麟电子股份有限公司定向发行股票的议案》，并授权董事会全权办理公司申请挂牌公开转让及定向发行的有关事宜。

一、拟发行股数

本次拟定向发行股份1,415,900股。

二、拟发行对象范围

本次定向发行的对象为公司12名在册股东及2名新增认购对象。其中，两名新增认购对象马丙乾、付强系公司员工。本次定向发行后公司的股东不超过200人。

拟发行对象的姓名、出资额、出资方式如下：

序号	姓名	认购数量 (股)	认购后的持股数 (股)	认购方式
1	吴国平	394,400	1,604,400	货币
2	吴春达	127,100	767,100	货币
3	刘检生	112,300	712,300	货币
4	万元姣	58,400	558,400	货币
5	蒋小强	114,100	514,100	货币
6	黄年亚	110,000	510,000	货币
7	班福奎	106,700	446,700	货币
8	何云	71,400	411,400	货币
9	王冬峰	65,500	355,500	货币
10	周尧	65,500	265,500	货币
11	崔凤敏	58,500	198,500	货币
12	王艳	32,000	132,000	货币
13	马丙乾	50,000	50,000	货币

14	付 强	50,000	50,000	货币
合计		1,415,900	6,575,900	-

三、拟发行价格区间

本次定向发行的每股价格为人民币1.00元。

四、预计募集资金金额

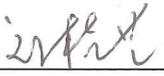
本次定向发行的预计募集资金金额为人民币1,415,900元。

第六节 有关声明

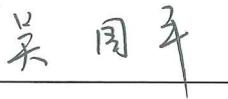
公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：



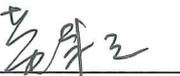
刘桂芝



吴国平



吴春达

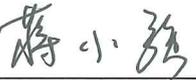


黄年亚



何云

全体监事签名：



蒋小强



班福奎



张丽佳

全体高级管理人员签名：



吴国平



吴春达



黄年亚



何云



刘检生



上海南麟电子股份有限公司

2014年11月17日

主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人签名：

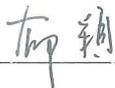


颜礼银

项目小组成员签名：



颜礼银



郁颖



李国毅



张飞



陈昕

法定代表人签名：



孙树明



律师事务所声明

本机构及经办人员已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的专业报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字律师：



林 兢

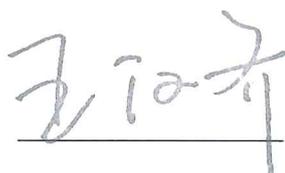


汪海飞



何玉平

律师事务所负责人：



王汉齐

北京大成(上海)律师事务所

2014年11月17日



承担审计业务的会计师事务所声明

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任

签字注册会计师签名：

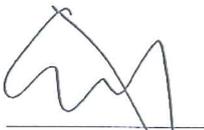


王龙旷



黄蓉

会计师事务所负责人签名：



徐华

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

2014年11月17日



资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任

签字注册资产评估师签名：



中国注册
资产评估师
朱卫明
31000915

朱卫明



中国注册
资产评估师
朱淋云
31130020

朱淋云

机构负责人签名：



王小敏

王小敏



上海东洲资产评估有限公司
2015年11月17日

第七节 附件

本转让说明书附件包括：

- (一) 主办券商推荐报告；
- (二) 财务报表及审计报告；
- (三) 法律意见书；
- (四) 公司章程；
- (五) 全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见；
- (六) 其他与公开转让有关的重要文件。